昭和 51 年度サンシャイン計画 委 託 研 究 開 発 成 果 報 告 書

太陽光発電システムの研究開発

(Ⅱ−Ⅵ族化合物半導体太陽電池の研究開発)

昭和 52 年 3 月 31 日

松下電器産業株式会社



5 工技院

「Ⅱ-Ⅵ族化合物半導体太陽電池の研究開発」												
松下電器產業株式会社												
	昭和 52 年 3 月 195 頁											
研 究 目 的 Ⅱ - Ⅵ 族化合物半導体を用いた高性 公害で製造する技術を開発することに 約百分の一となる太陽光発電システム とを目的とした。	:能太陽電池を、低価格、無 こより、価格が実質で現在の 、を構成する目途をつけるこ											

I	概	要要	1
	1.	研究実施責任者	3.
	2.	受託研究テーマ	3
	3.	研究の実施場所	3
	4	研究実施期間	ٽ ع
	5.	研究目標	2
	6		с ч
	о. 6.	 Ⅱ - Ⅲ 佐化合物半導体および接合の製造法の研究	у Э
		6.1.2 焼 結 注 (1)	4
		6.1.2 成 相 伝 (山)	6
			6
		0.1.4 × 1 1 以 支 法	7
			7
	c		8
	6.	.2 太陽電池素子構成法の研究	9
	6.	 .3 为化機構の解明と対策の確立 	9
	6.	.4 公告対束り唯立	0

Π	研究内	3 容 12
	1. Ⅱ— VI 尨	医化合物半導体および接合の製造法の研究
	1.1 概	要
	1.2 焼	結 法 (I) 15
	1. 2. 1	CdS 焼結膜の焼成 15
	(1)	はじめに
	(2)	CdS焼結膜の必要条件15
	(3)	CdS焼結膜の特性試験法 16
	(4)	実験用主要材料および器具
	(5)	実験および結果 18
	٤	a. 共通的実験条件 18

	k	口带刘	(灶羊)	別の検討…						18
	D.	小胶門		きの影響						 21
	C.	焼成谷:	奋の状	思の影響		• • • • • • • • • • • • • • • • • •		••••••		<i>2</i> I
	d.	焼成温	度の影	習		••••••••			•••••	22
	е.	異種生活	粉と相	互作用						23
	f.	Cd S 沮	1合生物	}の効果						24
	g.	埋込焼	成法の	検討					••••••	25
	h.	Cd S,	Cd O	昆合物共存烤	低効果…		•••••••••••••••••			28
	i.	酸素含	有雰囲	気中焼成効り	₹			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		33
(6)	結	論およ	び問題	点		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••••••			37
(7)	引	用	文 献			·			••••••	38
1. 2. 2	С	d S 焼結	膜の征	处理効果…			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••••••	39
(1)	Ŧ	\$_	がき	۰. 	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					39
(2)	実	験およ	び結果							39
	a.	Cd 雰囲	日一一一	での熱処理	• • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	••••••	••••••	41
	b.	空気中	での熱	処理				••••••••	•••••	41
	C.	H 2 雰囲	王 気中 ⁻	での熱処理…	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••••		•••••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	44
(3)	考	Ť	蔡		••		•••••			45
(4)	結	Â	シー				····			4 6
(5)	弓	1 用 ·	な 献					•••••••		46
123	Į.		形成							17
(1)	云	. ц <i>,</i> : - ф	がず				,,			- -
(1)	ہ ج	· ~	ارد الله							41
(2)	ĘЦ	• ^^↑ +∎•		- 1 57						47
	а.	本	late set	似		,				47
	Ь.	Cd S	焼 枯	展			••••••••••••••••	•••••		47
	C.	Cd Te	焼 結		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	50
	d.	Cu ₂ Te	e 層 形	成		•••••		•••••		53
	е.	電極、	リート	線付け、樹	指モール	۴	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		53
(3)	実	ミ験およ	び結果				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<i></i>	54
	a.	焼結薄	膜形C	d Te 太陽電	池の特性					54
	イ	. I	V特性	(変換効率の	の評価)…		••••••		•••••	54

	口. 分光咸度曲線	5.5
	ト 教天秤///ドンCdS CdTo 時成過程の解析	5.6
	J. ポスイロによる Juby Jule MAM 四住 V所有 ···································	57
		51
	▶ UQ D U 時別 結末	09
	C, 按台構造の解例	01
(4)	大田積素子 (4cm×4cm)の 説作····································	74
	a. 性 能	74
	b; 構 造	74
(5)	ま と め	75
(6)	引 用 文 献	76
1.3 焼	結法(11)	78
1.3.1	はじめ に	78
1. 3. 2	試作検討用素子の構造および製造方法	78
1. 3. 3	検討結果および考察	79
(1)	Cd Te の焼成条件の検討結果	79
(2)	▶ 忝 加 の 効 果	81
(3)	Cd S への Ga 添加の効果	83
1. 3. 4	試作 n・Cd S-p・Cd Te ヘテロ 接合素子の特性	84
1. 3. 5	大面積化の検討	84
1. 3. 6	結果のまとめ	85
1.4 化学	学的析出法	86
1. 4. 1	連続析出法による Cd S 析出 膜の 作成	86
(1)	まえがき	86
(2)	析出条件の検討	87
(3)	検 討 結 果	88
	a. 連続析出法で析出させた結果	89
	b. 繰り返しバッチ法で析出させた結果	90
(4)	濃 の 性 質	91
(5)	大面積基板への析出	93
1.4.2	CdS-CdTe ヘテロ接合太陽電池の検討	93

(1)	まえがき	93
(2)	基板温度480℃で作成した素子の特性	9.4
	a. CdS析出膜の性質	94
	b. Cd Te 蒸着基板温度の検討	96
	c. 太陽電池の特性(A素子)	100
	d. 接合構造の考察	103
(3)	素子特性の改善	106
	a. Cd Te 層の低抵抗化	106
	b. 蒸着法により Cu _{2-x} Te 層を形成した素子の特性(B素子)	107
	c. 浸漬法によりCu _{2-x} Te 層を形成した素子の特性	
	d. 考 察	114
	1. Rs、Rsh、Rdの評価	115
	 n. 短絡電流と光生成電流 	116
	ハ 開 放 端 電 圧	116
	二. 曲 線 因 子	117
	ホ. 収 集 効 率	118
	へ. 効 率	120
(4)	大面積素子の試作	121
(5)	寿 命 将 性	122
1.4.3	ま と め	124
1.4.4	引用文献	125
1.5 気	1 相 成 長 法	126
1. 5. 1	まえが き	126
1.5.2	接 合 形 成	127
1. 5. 3	Cd S 膜の低抵抗化処理	. 131
1. 5. 4	キァリアーの拡散長の測定	. 132
1. 5. 5	C - V 特 性	$\cdot 134$
1. 5.6	光起電力特性	135
1. 5. 7	寿 命 特 性	138
1. 5. 8	考 察	140

目次一4

1. 5. 9	ま と め	
1. 5. 10	引用文献	
1.6 蒸	着 法	
1.6.1	まえがき	
1.6.2	Cd S-Cd Te 系薄膜太陽電	· 『池の予備検討······145
(1)	p・Cd Te 単結晶上への Co	S 蒸着 14 6
	a. 電流 — 電圧(I – V)	寺性147
	b. 容量 — 電圧 (C – V) ⁴	专性 149
	c. 分光感度特性	
(2)	素子構造と基板の検討	
	a. Front Wall Type	
	b. Back Wall Type	
1. 6. 3	CdSおよびCdTe 蒸着	漠の特性 153
(1)	Cd S 蒸 着 膜	1.5.3
	a. 膜 表 面	
	b. 蒸着膜の光学特性	
	c. X 線 回 折	156
	d. 膜の低抵抗化	
(2)	Cd Te 蒸着膜	
	a. 膜 表 面	156
	b . 膜の透過特性	158
	c. X 線 回 折	
	d. 膜の低抵抗化	160
1. 6. 4	Cd S-Cd Te 蒸着薄膜;	に陽電池160
(1)	素 子 の 作 成	
(2)	試作素子の特性	
1.6.5	CdS蒸着膜の再検討…	
(1)	作成法に基づく膜特性の差	異164
(2)	EDAX による Cd S 蒸着膜	の組成検討166
1.6.6	まとめ	

		(1)	•	蒸着	膏膜₅	秦子()予備検討	171
		(2))	Ba	ck V	Va 1 1	Type 蒸着膜素子	
		(3)	1	蒸羗	F Cd	S膜	の再検討	
		(4))	結			論	
2.	太	:陽	電池	素子	·構质	戊法(つ研究	
2	. 1		概			要	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	173
2	2. 2		吏	ź.	が	き		
2	. 3		実験	およ	び糸	吉果		
3.	劣	化	機構	の解	明。	と対分	きの検討	
3	. 1		概			要		
3	. 2		李	充	が	ð.		
3	. 3		焼結	形C	d S	– Cu	◦S太陽電池の寿命特性	
	3.	. 3.	1	実			<u></u> 驗	178
	3	3	2	本	J		×	
9	2 1		山林	よない		- ת הר	**	
	±•••	4	1 1	读及	:///	Jui	2 入る 电心 シガ 中村 に	
	Э.	. 4.	1	夫	,		<i>周</i> 央	100
	3.	. 4.	2	Ŧ	ξ	-	Ø	103
			ist fort					
4.	公	書	对策	の確	<u>v</u>			1.8.4
4	. 1		概			要	······	
4	. 2		ま	乞	が	ð.		184
4	. 3		火災	の際	の温	且度·		185
4	. 4		定気	中で	Cd	S-0	Cd Te 焼結膜を加熱した場合の重量変化	185
4	. 5		窒素	中で	Cđ	S -0	ld Te 焼結膜を加熱した場合の重量変化	187
4	. 6		考			察		189
4	. 7		Ŧ	٤		め		191
4	. 8		引	用	文	献		

目次一6

III	今	↑後の研究開発計画 1	92
1		Ⅱ-Ⅵ族化合物半導体製造法および接合形成法の研究	94
2	2.	劣化対策の確立 1	94
50	3.	太陽電池素子構成法の研究 1	94

I 概

要

1. 研究実施責任者

松下電器產業株式会社 無線研究所長 飯 田 義 男

2. 受託研究テーマ

「太陽光発電システムの研究開発

(Ⅱ – Ⅵ 族化 合物半導体太陽 電池の研究 開発)」

3. 研究の実施場所

大阪府守口市八雲町3丁目15番地

松下電器產業株式会社 中央研究所

大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器產業株式会社 無線研究所

(再委託先) 神奈川県川崎市多摩区生田 4896 番地

· .

松下技研株式会社

4. 研究実施期間

昭和51年5月10日~昭和52年3月31日

5. 研究目標

現在の技術で太陽光発電システムを構成した場合に比し、価格が実質で百分の一以下となる太陽光発電システムを製造可能な技術を開発する目途をつけることを目標にして、II – VI 族化合物半導体の無公害製造技術の確立をはかり、あわせてそれを用いた革新的な太陽光発電システムの研究開発を行う。

6. 研究成果の概要

6.1 II - Ⅵ族化合物半導体および接合の製造法の研究

前年度までの研究で有望とされた Cd Te 系について、主として焼結法、 化学的析出法、気相成長法、蒸着法の4種の製法により半導体および接 合の試作を行い、変換効率、寿命、価格の3点から評価を行った。それぞれの結果について述べる。

6.1.1 焼 結 法 (I)

ガラス基板の上にスクリーン印刷法により Cd S ベーストを塗布し、こ れを窒素ガス中において焼結し、 Cd S 焼結膜を作る。さらにこの上に同 様の方法で Cd Te 焼結膜を作り、 Cd Te 膜の表面を浸漬法により Cu2 Te層 に変え、その後200℃で熱処理し、 Cd S、 Cu2 Te 層にオーミック電極を もうけリード線を引出す。このようにして構成された図 6.1 のような焼 結薄膜形 Cd Te 太陽電池は1 cm 以下の小面積の素子では効率8%(AMO) を示した。この方法はスクリーン印刷、ベルト炉という量産性のある工 程のみによって製造でき、低コストの太陽電池の製法として期待できる。 そのため、Cd S 膜の製造法、接合の形成法について詳細な検討を行った。



図 6.1 焼結薄膜形 Cd Te 太陽電池の構造

焼結薄膜形 CdTe 太陽電池の高性能化と低コスト化のためには、 透明 電極兼窓材として使われる CdS 焼結膜の導電性と光透過性 が高いことが 重要であるので、スクリーン印刷によりこのような CdS 焼結膜を作製す るための検討を行った。まず原料 CdS 中の硫酸根の量について検討し、 量の多いものを使うと透過率が良く、量の少ないものを使うと低抵抗の 焼結膜が得やすいことが判明した。次に CdS 膜の焼結過程において雰囲 気中に微量の Cd 蒸気を含ませる方法 (たとえば CdS 塗布基板と同一容器中に CdSとCdOの混合粉末を置き焼成する方法)により、極めて低抵抗のCdS 焼結膜が得られることもわかった。上記焼成方法において焼成の前半を O2を含有する雰囲気中で行い、後半を不活性雰囲気 で行うことにより透 過率の改良ができる。

CdS焼結膜の後処理による影響についても検討した。CdS焼結膜をH2 雰囲気中で、またはCd金属とともにN2雰囲気中で320℃で熱処理する ことにより膜の低抵抗化が可能である。これらの方法を組合わせること により現在面抵抗5~10Ω/ロ、透過率80~85%、膜厚10~20μm程度 の特性をもつCdS焼結膜の作製が可能になっている。

次に焼結薄膜形 Cd Te 太陽電池の構成要素各層の役割を明確化するため の検討を行った。この検討のための素子の作製条件としては、CdSペー ストには必要に応じてGaCl2を添加したものを使用し、CdTeペーストに はCdTe原料中にIn添加有および無しの2種を使用した。素子の作製過程 は、 ガラス 基 板 上の Cd S ペーストの 塗 布 ・ 焼 成 、 Cd Te ペースト の 塗 布・ 700 ° での焼成、 Cu2 Te または Sb 化 合物層の形成と熱処理の後、電極付 とリード線の取付けを行うものである。これらの太陽電池素子について 解析を行うと、まず Cd Te 焼結の際蒸気圧の差から Cd Te 膜の表面層はTe 過剰の p・Cd Te 層となっている。この現象は Cd Te への In 添加の有無に かかわらず観察される。また Cd Te 膜内部の Cd S 境界近傍は Cd Te への In 添加の無い場合でも、基体の CdS 膜内に存在する過剰の Cd や Gaが拡 散してきて n・Cd Te となる。 このため Cd Te への In 添加の有 無にかかわ らず Cd Te 膜内に p・n 接合が形成されると考えられる。 また Cd Te 膜表面 に Cu2 Te または Sb 化 合物 層を形成 したの ち熱処理 するの は、アクセプタ - としての Cu や Sb を 熱拡散 させ 接合の 深 さを 最 適 位 置 に 制 御 す る 過 程 と考えられる。これらの推察を確かめるため、X線マイクロアナライザ ー に よ り 、 素 子 の 接 合 断 面 近 傍 の S 、 Te 元 素 分 布 状 態 と 同 一 視 野 内 の 電 子線起電力分布状態を重畳させて観測した。その結果、CdTeのホモ接合 の 表 面 に Cd S 層 を 窓 材 と し て 付 け た 構 造 の ヘ テ ロ 表 面 形 接 合 と 見 なし て

- 5 -

も差支えないとの結果を得た。ただしこの場合の素子は、研摩の都合上 ガラス基板をCdS単結晶に代えたものである。

これらの解析結果にもとづき、製造法の改善を進めている。
 6.1.2 焼 結 法 (II)

スクリーン印刷―焼結方式において、浸漬法による Cu₂ Te 層の形成工 程を省略した、いわゆる n・Cd S-p・Cd Te のヘテロ接合形の素子の試作検 討を行った。

CdS焼結膜上に形成するCdTe焼結膜のp形化およびp⁺化をはかるた めに、燐などのアクセプタ不純物の添加方法の検討および焼結条件の検 討を行った結果、受光面積1 cm の素子で変換効率 8.7% (50mW/cm) のも のが得られるようになった。さらにこの方式の素子の大面積化の検討を 行った。

6.1.3 化学的析出法

前年度試作した連続析出装置を用いて、CdS析出膜の析出条件の検討 を行い、約2μmの膜厚のCdS析出膜を2cm角ガラス基板172枚上、また は5cm角ガラス基板80枚上に同時に均一に再現性よく析出させる条件を 確立した。

この析出膜と p・Cd Te 蒸着膜とのヘテロ接合においては、Cd Te 膜の蒸 着条件の改善を行い、蒸着基板温度の上昇につれて良好な接合が形成さ れることを確認した。また、このヘテロ接合は、階段形であり、空乏層 は Cd Te 側に拡がっていることが明らかとなった。 さらに変換効率を向 上させるためには、飽和電流の減少、Cd Te 層の低抵抗化および電極のコン タクト抵抗の改善が必要であり、Cd Te 層の膜厚の増大、アクセプタ不純 物と Cd Te 粉末との同時二源蒸着や、 Cd Te 層への不純物の熱拡散などを 試みた。

その結果、CdTe層上に、Cu2Te膜を蒸着し、250℃の温度で熱拡散させることにより、CdTe層の抵抗を下げることができるとともに、CdTe表面層にp⁺層ができ、コンタクト抵抗を減少させることができた。このよ

うにして作成した Cd S−Cd Te 薄膜太陽電池で 70 mW/cn 太陽光下で、変換効率 8.7%の性能の素子を得た。また同様の効果を得るために、 Cu⁺ 水溶液浸漬置換法と熱処理拡散法の併用で Cu をドープした素子でも効率 8.0%のものを得ている。

なお、素子の大面積化にも取り組み、5 cm角ガラス基板上に素子面積約13 cmの太陽電池を試作し、効率6%のものを得た。

6.1.4 気相成長法

CdTe結晶上に低抵抗CdS膜を成長させることによって、太陽光下 (AM1.2,68 mW/cm)で効率10%以上の結晶形素子が得られたことは前年 度に報告した。本年度は素子の結晶学的、半導体的な解析及び寿命特性 についての測定、検討を行った。X線ラウエ回折の結果、CdS(0001) 面が Cd Te の(111)面上にエピタキシャルに成長していることが確認された。 光 起電力(短絡光電流)のスペクトルレスポンスは、波長0.51~0.86 μmの 間で観察され、特に0.58~0.81 μmの範囲ではレスポンスは一様であっ た。またレーザー光(0.63 µm)を使って絶対量子効率を測定し、 87 % の値を得た。この高い値はCdS-CdTe界面での光励起キャリアーの再結 合損失が少ないことを示している。 C - V 特性の測定の結果、 C⁻³-Vは 直線関係にあり、リニアークレイデッドジャンクションが形成されてい ると考えられる。また、表面に保護膜をコートしたい素子でも、室温放 置 テスト 及び室 温 ・ 80 % 相対 湿 度中 テスト におい て安定 で あっ た。順方 向バイアス印加テストでも、劣化が見られなかった。従って、この CdTe - CdS素子は少なくとも CdS-Cu2S 又は CdTe-Cu2 Te 接合素子よ り安 定であると考えられる。これらの結果は Cd Te 系太陽電池が変換効率、 寿命の両面から期待できることを示すものである。

6.1.5 蒸 着 法

蒸着法による p・Cd Te-n・Cd S 系高効率薄膜太陽電池の形成をめざし、 予備実験として、 p・Cd Te 単結晶上への Cd S の蒸着を行い、変換効率 3.0 %を得た。さらに、薄膜系に移行するにあたり、基板決定の為に Mo板、 Au 蒸着を行った Mo 板、ネサガラス、カリガラス、石英ガラス等の薄膜太 陽電 池基板としての 通性、及び素子構造等の検討を行った。その結果、 ネサガラス 基板上に Cd S- Cd Te を順次蒸着する バック・ウォール形素子 構造が良好という結論を得た。上記のバック・ウォール形素子構造によ る p・Cd Te-n・Cd S 薄膜太陽電池の高効率化をめざし、Cd S 蒸着時にお ける In、Cd Te 蒸着時における P、Au、Sb 等のドーブによる膜の低抵抗 化、及び Cd S、Cd Te 連続蒸着等、各種方法による効率向上の試みを行っ たが、変換効率は 2.2%程度しか得られなかった。その原因究明のため、 気相成長膜、化学析出膜、真空蒸着膜の特性比較及び EDAX (Energy Dispersive Analysis of Xray) による蒸着膜 Cd Sの組成検討を行い、Cd S 蒸着薄膜組成の stoichiometry からの大巾なズレが変換効率の 向上を妨 げている要因の一つであることが明白となった。従って、このズレ防止 即ち stoichiometry を保ち得る様な作製条件把握に努めているが、現在十 分な解決はみられていない。

6.1.6 まとめ

以上4種の方法で試作された素子のうち、蒸着法では高効率のものは得 られなかった。気相成長法では Cd Te 単結晶太陽電池の有望性を明らかに したものの、高効率薄膜形素子の試作には成功していない。化学的析出 法、焼結法の2者では量産性のある過程のみによって、いずれも高効率 素子の試作に成功しており、性能的には優劣はみられない。しかし化学 的析出法の場合には、CdS膜が薄く直列抵抗が高くなるため、ガラス基 板上に In2O3 の補助透明電極が必要であることと、Cd Te 膜がCdS と同 じ化学的析出法によって形成されるのではなく、全く別の蒸着過程を用 いて形成されねばならないこと、の2点で焼結法にくらべ価格的に不利 と判断される。このように、効率、寿命、価格の観点から総合的に検討 を加えた結果、スクリーン印刷方式・焼結法を採用した焼結薄膜形CdTe 太陽電池がもっとも期待できる素子であるとの結論に達した。 6.2 太陽電池素子構成法の研究

太陽電池の構造は安価で、かつ使用時ならびに不慮の事故に際して、Cd、 Te等の溶出・飛散を防止でき、しかも回収や補修が容易な構造にする必要 がある。これらの問題点を想定して構成法の検討を行った。

現在、実用的な観点から大面積素子(4 cm×4 cm)の試作を行っているが、 大面積化に伴う素子のシリーズ抵抗の増加による性能低下を防止する目的 で、素子の太陽電池層を数個の細胞素子に分割し、且つ全受光面積に対す る有効光発電層の面積比率を高めるための構造を検討した。

また、太陽電池は屋外暴露状態で使用するため、昼夜ならびに四季の変 化に伴う温度サイクルにさらされることになるから、ガラス基板と太陽電 池層およびモールド樹脂層間の熱膨脹係数の差によって太陽電池層にスト レスが加わるためにひびやはがれ現象が発生し易い。これを防止する目的 で同一熱膨脹係数をもった2枚のガラス(このうち1枚は太陽電池層を付け た基板ガラス)の間に太陽電池層およびその保護用樹脂を狭んだサンドイ ッチ構造の素子を試作した。この構造は樹脂硬化時のストレスによる太陽 電池層やベッケージの破損を防止する目的も含まれている。この構造を採 用することにより、CdS、CdTe 膜からなる太陽電池層はガラス板で覆われ ることになり、耐湿性、耐候性および機械的強度のすぐれた太陽電池を形 成することができる。

公害対策の項で述べるように低融点ガラスは火災時のCdの飛散を防止す る効果がある。上記構造のガラスの一方に低融点ガラスを使用することの 検討も進めている。

6.3 劣化機構の解明と対策の確立

前年度までは主として Cd S(磁器) - Cu₂ S系太陽電池を 対象として研究 を行ってきた。その結果 Cu₂ S層を内部まで均一にすることが、この系の安 定な太陽電池を得るための一つの要因であること、従来の製法でつくった

- 9 -

CdS-Cu₂S接合を長時間水中に浸漬し、 その後さらに電気化学的処理を繰 繰返すという新しい後処理工程を採用することによって上記の要因を満足 させうることを明らかにした。

本年度は前記の後処理工程を採用した Cd S-Cu₂S太陽電池の寿命試験を前 年度にひきつづいて行うと共に、新らしくスクリーン印刷方式によってつくった 焼結薄膜形 Cd Te 太陽電池についてもその安定性を検討した。 Cd S-Cu₂S系に ついては、タングステン光照射加速寿命試験1ヶ月の平均劣化率は2%であっ た。又50 mW/cdの光照射時の最適負荷を出力端に接続し、太陽電池を屋外に暴 露しておいた場合の1年の平均劣化率は2%であり、実用化にかなり期待 のもてることが明らかとなった。

一方焼結形 Cd Te 太陽電池については、まず Cd S-Cd Te-Cu2 Te 系の検討 を行った。この系の太陽電池の接合部は Cd Te 膜内に存在している。したが って Cu2 Te 層の主な役割はアクセブター源であり、二次的に電極としても 役立っていると考えられる。 Cu2 Te 層の変質が直接には接合の劣化に結び つかないため、劣化対策は比較的容易と考えられる。タングステン光照射 加速寿命試験 2 ヶ月後の効率の劣化率は 7 %程度である。この系の太陽電 池の効率は 8 %と高く、劣化も比較的小さいので有望であるが、さらに安 定な太陽電池を得る目的で、Cd Te 中の拡散係数が Cu より小さいと考えら れる Sb およびその化合物を、 Cu2 Te の代りにスクリーン印刷方式で形成 させた Cd S-Cd Te-Sb 系についても検討を進めた。この系の太陽電池の効 率は現状では 3 %と低いが、上記の加速寿命試験では 2 ヶ月で 3 %の劣化 率を示すにすぎず、初期の試料としては安定であることが分った。これよ り、 Cd Te 系素子についての劣化対策の樹立も可能と考えられる。

6.4 公害対策の確立

Cd は人体に対して有害であると言われている。したがって Cd を含んでいる II – VI 族化合物半導体を太陽電池素材として使用する場合には、製造、

-10-

使用時における公害防止対策を確立しておく必要がある。

49年度には製造時における公害防止対策を、又50年度には太陽電池使用中に雨などがかかることによって生じるCd 溶出の防止対策を検討し、それぞれ公害を防ぐ見透しを得ることができた。

本年度においては、不測の事故、特に火災が発生した場合の使用時の公 害対策について検討を加えた。一般の火災の場合、温度は700℃~900℃ にまで上昇すると言われている。そこで CdS-CdTe 焼結膜をアルミナ基板 上につけ、空気中で900℃まで加熱した場合の重量変化を熱天びんによっ て 測定し、 この 測定値 からどれ だけの Cd 等の化 合物 が蒸発し たかを推定し た。さらに低融点ガラスをCdS-CdTe焼結模上にかぶせ、Cd等の化合物 の蒸発をおさえることを試みた。まずCdS-CdTe 焼結膜を空気中で加熱し た場合、600℃位から重量がふえはじめ、800℃で約30%ふえる。その後 重量は減少しはじめ900℃で2時間保持すると最初の重量にまで戻る。と れは800℃近辺までは CdS および CdTe が空気中の酸素と反応し CdSO4、 CdO、TeO2等の化合物ができて、重量が増加するが、800℃をこえるとこ れらの化合物が分解又は蒸発をはじめ重量が減少するものと考えられる。 Cd S-Cd Te 焼結膜上の低融点ガラスをかぶせた場合は、約800℃から重量 が増加しはじめ900℃で約30%増加するが、その後900℃で2時間保持し ても殆んど重量は変化せず、分解蒸発等がおさえられていることが分った。 - これは低融点ガラス中に Cd SO4、 Cd O、 Te O2 等がとけこんで蒸発がおさえ られ た も の と 考 え ら れ る 。 以 上 の 結 果 か ら 、 焼 結 型 Cd Te 太 陽 電 池上 に 低 融 点ガラスをかぶせることにより火災の際の公害発生を少なくできることが 明らかとなった。初年度以降検討してきた製造時の公害防止策に加え、使 用時および事故(特に火災)発生時の対策を総合的に考慮しつつ素子構成法 の研究を進める必要がある。

-11-

Ⅱ 研 究 内 容

突形の 去 登 奥 Ω 合 第 び よ α 本 尊 半 耐 合 外 葱 Ⅵ - Ⅱ .1

畏

恐

1.1

。オー、依衣も至れの油がの千素顕鬱脂哲高、な

。大野を論誘のう

主、ンへこン茶。TPO 5 4 点盤の5 2 命候、季校、7 採在の7 4 海中街 半 6 1 2 光線の 4 体の 5 体 2 日本 2 日本 4 年の 4 種の 9 年の 4 種の 5 年 7 1 5 当 2 日本 5 日本 5 の 第 作 6 行 2 、交換 数 率、 寿命、 価格 0 3 点 から 製造 法 1 に ころいての評価を行った。

本の冬、そか応知力と感慨心能震闘大類教へよの率校、力で必需素でを を PO 一晶結単のFO 、力で必要法の保険、 の本の原因の解明にとどまった。 今和成長法では、 Cd Te 単結音 個体を確か 気相成長膜系太陽電池を説作し、 この系の不不ら高が率。高信頼性を確か なるでき、 Cd Te 太陽電池の研究を進める上での強い支持を与えた

-11-

1.2 焼 結 法 (I)

1.2.1 CdS 焼結膜の焼成

(1) はじめに

光起電力素子において、基体となる半導体の表面に、禁止帯幅がより広いとともに光透過性の良い異種半導体層を形成することにより、いわゆる「窓効果」により変換効率が向上することが知られている。

昨年度より検討をはじめたスクリーン印刷方式による Cd Te 焼結 薄 膜型太陽電池素子¹⁾ に おいては、窓材として Cd S 焼結膜を使用して来 たが、従来の Cd S 焼結膜は面抵抗が十分低くなかったため、透明電極と して酸化インジウム膜をつけた ガラス基板を使用せざるを得なかった。 しかしながら、このようなガラス基板は通常の ガラス基板にくらべて 光透過性が劣るばかりでなく、非常に高価なために、低コストの太陽 電池の開発という目的を達成するための大きな障害になっていた。し たがって、もし光透過性が良好でしかも面抵抗が酸化インジウム膜付 ガラス基板と同程度の Cd S 焼結膜の製造法が開発されれば、透明電極 を兼ねた窓材となりうるわけであり、太陽電池の性能およびコストの 大幅引下げが可能になる筈である。

このような理由で上記の目的に適用しうるすぐれた特性をもつCdS 焼結膜を目指して検討をすすめることにした。なおCdS原料としては、 市販のCdS高純度微粉末(生粉)を仮焼せず直接使用し、またCdSペ ーストの塗布もコスト的に有利なスクリーン印刷を用いることにした。 (2) CdS 焼結膜の必要条件

- - a. 面抵抗が小さいこと:透明電極を兼ねるので特に素子が大型化す るにつれ十分低抵抗でないと変換効率に悪影響を及ぼす。
 - b. 光透過性の良いこと:入射光線の利用率を低下させないためには Cd Te 太陽電池が感度を持つ 500~850 nmの波長範囲での吸収が少 ないことが必要である。
 - e. 膜の均一性が良いこと: 巨視的、微視的に均一性が良く、緻密で

ピンホールなどの欠陥の少ないこと。

- d 膜の安定性が良いこと: Cd Te 層の作成などの後工程中に導電性 や透過率の低下などがないこと、経時的な変化の少ないこと、基板 との密着性が良く、剝離などが生じないこと。
- e. 製造コストが安いこと:材料費が安く、工数が少なく、再現性の 良い製造方法があること。

上記の条件の中には面抵抗と透過率のように相反する傾向を持つものがあり、両者を共存させる難しさがある。

- (3) CdS 焼結膜の特性試験法
 - a. 面抵抗: CdS焼結膜とオーミックな 接触をする In-Ga の合金(液状)を図
 1.1に示すように、3mの間隔を置い て3mの長さに塗布し、その間の抵抗 をテスターで測定する。



図 1.1 面抵抗測定法

相対する 2 辺での 測定値を平均してその焼結膜の面抵抗とする。 b. 膜 厚:ガラス基板の重量を Wo(g)、 Cd S 膜形成後のガラス基板 の重量を W1(g) とするとき 膜厚 t (μm) は次式で算出される。

$$\mathbf{t} = \frac{\mathbf{W}_{1} - \mathbf{W}_{0}}{4.82 \times \mathrm{S}} \times 10^{4} \qquad \mathrm{S} : \pm \, \mathrm{k} \, \mathrm{m} \, \mathrm{fr} \, (\mathrm{cr})$$
$$4.82 : \mathrm{Cd} \, \mathrm{S} \, \mathrm{er} \, \mathrm{g/cr})$$

c. 透過率:図1.2 に示すように、タングステンランプを光源とし、 照度50mW/cn の位置に受光素子としてCdS-Cu2S系太陽電池「サ ンセラム」⁴⁾を置き、短絡電流 Io を測定する。

次に透過率を測定すべき基板の Cd S 焼結膜側を水で濡し、気泡の 入らぬように太陽電池の上に重ね、密着した状態での短絡電流 I1を 測し、次式により透過率 T (%)を算出する。

$$\mathbf{T} = \frac{\mathbf{I}_1}{\mathbf{I}_0} \times \mathbf{100}$$





図1.2 透過率測定法

- (4) 実験用主要材料および器具
 - a. CdS粉末

表 1 Cd S 原 料 粉 末

品番	製造元	Cd (%)	SO4-(%)	粒径(µm)
#20151	堺 化 学	77.6	0.05	0.09
#S - 53	11	75.5	8.5	0.23
(#S - 55)	(")	(75.3)	(3.4)	(0.08)

融 剤 $CdC\ell_2\frac{5}{2}H_2O(++)$ 并化学特级)

ガラス基板 硼硅酸ガラス 20×20×0.8 mm (ダウ・コーニング社製 #7059)

d. 焼成用容器

b.

c.

アルミナ磁器製(図 1.3)

e. 石英ボート: 焼成容器塔載用

f. 焼成用電気炉

加熱長 600 mm 3回路分割式 PID制御 炉心管 不透明石英 外径90×1,500 mm 雰囲気ガス調製機構付

ボート移動機構付

(5) 実験および結果

- a. 共通的実験条件
 - イ. Cd S ペーストの試作

高純度 Cd S 微粉末(生粉) 7.2g、 Cd C $\ell_2 \cdot \frac{5}{2}$ H₂O 0.9g、ブロ ピレングリコール 4 g を乳鉢により十分混練してベースト状にする。

n. CdSペーストの塗布・乾燥

325 メッシュステンレススクリーンを用い、 硼硅酸ガラス基板 上全面にスクリーン印刷した基板を、約50℃の温湯を用いてレベ リングしたのち、120℃で2時間乾燥する。

ハ. 焼 成

図1.3の焼成容器に試料基板1~4枚入れ、炉心管左端に石英 ボートとともにセットし、真空に排気したのちN2ガスを導入し、 さらに2ℓ/minの流量で1時間N2を流してから、ボートを移動し、 最高温度で20分間焼成したのち再びボートを移動し冷却する。

二. 第2次塗布·焼成

膜厚を厚くし、面抵抗を下げるため、必要により上記焼成基板の上に再度 Cd S ペーストを塗布し、乾燥、焼成を行う。

b. 分散剤(結着剤)の検討

従来CdSペースト用分散剤(結着剤)としてはプロピレングリコ ールが使われて来たが、吸湿性が大きいためペーストの粘度などの 状態が変りやすいという問題があった。このため、より安定性がよ く、印刷性の良いペースト用に適した分散剤がないか検討するとと にした。分散剤選択に際しては、吸湿性、粘度、使い易さを考慮し た。

1. 測定条件と測定結果

吸湿率:試料約1gを30ダガラス秤量瓶に入れ、R.H.80%の 調湿槽に入れて、20℃にて放置後重量増加から算出。

粘 度:振動粘度計により20℃で測定(**印のみ、他は便覧³⁾ による)

分	散	剤	沸点(℃)	吸湿率* (%)	粘度(CP)	備	考
プロピ	ィングリ	コール	188.2	19.9	56		
トリエチ	レングリ)コール	278.3	21.1	48		
シクロ	ヘキサ	ノール	161.1	4.7	50		
2メチル	ノクロヘキ	サノール	174	1.2	23 **		
ベンジ	ルアル	コール	205.3	5.5	5.6		
ブチル	カルビ	トール	230.4	4.1	6.5		
ブチルカ	ルビト - ア +	ール マテート	246.8	2.0	3.6		
エチル	セルリ	ローズ		1.9	140 **	ブチルカルビト・ 4%溶液	ールアセテート
ポリビュ	ニルアル	ュール		-5.2	33**	10 %水溶液	友
ポリエチ	レングリ)コール		14.3	110**	分子量約420((#400)

表 1.2 各種分散剤の性質

*20日 放置後の重量増加率



(島津製作所製 Thermano Balance による) 試料量 200 %、昇温速度 180℃/H、空気送入 200 ml/min

n. まとめ

各種分散剤の吸湿性、粘度、揮発・熱分解特性および各種分散 剤によるCdSペーストの性質の測定結果を表1.2、表1.3、図1. 4、図1.5に示す。

代表的な例としてプロピレングリコールおよびエチルセルロー ズ(プチルカルビトールアセテート4%溶液)について、長・短を 比較すると表1.4に示すようになり、いずれも十分なものではな い。したがって、当面は取扱いやすいプロピレングリコールを使 用し、他の検討が終了した時点で印刷性と安定性のすぐれたエチ ルセルローズ系をとり上げることにする。

表 1. 8	3 谷	·種分	散剤に	よる	Cd	\mathbf{S}	ペー	ス	ト
--------	-----	-----	-----	----	----	--------------	----	---	---

分 散 剤	吸湿率* (%)	印	刷	性	備	考
ブロピレングルコール	8.5		0			
シクロヘキサノール	0. 5		0		摇変性有	
ベンジルアルコール	0. 9		\bigtriangleup		"	
エチルセルローズ(プチルカルビ トールアセテート4 S溶液)	0. 4		0		曳糸性有	
ポリビニルアルコール (10%水溶液)	- 1.4		0		"	

*20日後

表1.4 代表的分散剤の比較

$\left[\right]$		プロピレングリコール	エチセルロ <i>ーズープチルカルビ</i> トールアセテート
長月	受	比較的低温の加熱で揮発する。	吸湿性小さく、状態変化が少ない。
	所	水に溶け、毒性もなく取扱いやすい。	曳糸性を持ち、印刷性が非常に良い。
矢	豆	吸湿性が大きく、ペーストの状態が使用中に	酸素の存在下で400℃程度に加熱し、有機質
序		変りやすい。	を完全に分解する必要がある。

c. 焼成容器の状態の影響

図1.3 に示す焼成容器の効果を確認するために、蓋をした場合と はずした状態で焼成した場合に焼結膜の特性がどのように変化する か調べた。CdS原料生粉は#20151と#S-53、CdSペースト塗布 焼成回数は1回と2回、焼成温度は650℃一定とし、その他は(a)項条件によった。

塗布	焼 成	CdS生粉	焼 成	容器	面抵抗(KΩ/口)	透過率 (%)	膜厚(μm)
1 🖂	(J)	#20151	蓋開	付 放	700 2.7	78.5 63.0	11.5 8.8
	Ш	· #S - 53	蓋 開	付 放	700 1.2	80.9 68.6	9. 1 8. 6
2 🗉	#20151	蓋 開	付放	7. 0 1. 6	58.1 50.1	22.8 18.6	
	Ъ	#S − 53	蓋 開	付 放	40 0. 2	65. 1 55. 4	18.5 18.8

表1.5 焼成容器の状態と焼結膜の特性

表1.5より蓋付焼結容器による焼成では、CdS生粉の種類にかかわらず焼結膜の面抵抗、透過率とも高くなるのに対し、開放状態での焼成では面抵抗、透過率とも著しく低くなる傾向が見られる。

この原因は、融剤として添加されている Cd Cl₂の挙動に関係する と考えられる。即ち、蓋付焼成容器では Cd Cl₂の揮発が少ないため、 融剤として有効に利用し、 Cd S 結晶が成長しやすく、焼 結膜の透過 率は高くなるが、 Cd Cl₂ が Cd S 結晶粒界などに残留するため面抵抗 が高くなりやすい。

これに対し、開放状態での焼成では、 Cd Cl2 の揮発が早いため、 Cd S 結晶の成長が十分でなく透過率が低いが、 Cd Cl2の残留が少な いため面抵抗は低くなりやすいと考えられる。

CdS焼結膜の透過率を高めることは重要であり、面抵抗を引下げる方法は他にもあると思われるので焼成容器は蓋付の状態で使用する。

d. 焼成温度の影響

焼成温度を590~700℃の範囲でかえその影響を調べた。 CdS 生粉は#20151と#S-53、塗布焼成回数は1回と2回とし、他は (a)項の条件によった。

塗布	焼成	CdS 生粉	焼成温度(C)	面抵抗(KQ/口)	透過率 (%)	膜厚(μm)
1 🗉		#20151	590 650 700	3000 700 0.2	70.2 78.5 78.0	10.0 12.5 10.5
	Ш	[#] S - 53	590 650 700	2000 700 0.3	76.7 80.9 81.4	9.0 9.1 9.8
2 回	പ	#20151	650 700	7 0. 0 2	58.1 66.6	22.8 20.3
	ш	[#] S − 53	650 700	40 0.05	65.1 70.9	18.5 19. 3

表1.6 焼成温度と焼結膜の特性

表1.6より、焼成温度が高くなると、面抵抗は著しく小となり、 透過率は高くなる。塗布焼成回数2回のものは透過率はやや低くな るが、面抵抗は20~50Ω/ロにまで低下し、塗布焼成回数1回のも のにくらべ、膜厚の相違以上に面抵抗が低下することがわかった。

CdS生粉については、硫酸根含有率の少ない #20151 生粉では、 面抵抗がやや小さく、硫酸根含有率の多い #S-53 生粉では透過率 がやや高くなる傾向が認められる。焼成温度による焼結膜の特性の 変化の原因はやはり Cd Cl2 の効果と考えられる。即ち高温焼成は Cd Cl2 の融剤作用を高め、 Cd S の焼結を促進し透過率を向上すると 同時に、 Cd Cl2 の残留量を少なくし、面抵抗を低下させるとして説 明される。

e. 異種生粉と相互作用

前項までの実験において、硫酸根含有率の異なるCdS生粉による ベーストを塗布した基板を同一の焼成容器に入れて同時焼成すると、 隣接部分と他の部分の特性が異なることが観察された。これは異種 生粉間において相互作用が起っていると考えられるので確認した。

-23-

図 1.3の焼成容器に #20151 生粉(硫酸根 0.05%含有)によるペーストを塗布した基板 3 枚と、 #S-55 生粉(硫酸根 3.4%含有)によるペーストを塗布した基板 1 枚を入れ、 N2 中 590℃ 25 分焼成した。

図 1.6 に焼成後の状態を示す。 #20151 生粉による Cd S焼結膜は 黒ずんだ黄色であるのに対し、 #S-55 生粉によるものは本来明 かるい黄色というように色調が相 違する。

しかし両方の基板を同一焼成容 器に入れて焼成した場合は、図 1. 6 (a) に示すように #S-55 に隣接 ^{0.7M} する部分は #20151 の色調が明か るい黄色に変化していることが観 1.5M 察された。さらに面抵抗を測定した ところ、図 1.6 (b) に示すように、

上記隣接部分においては、他部分





図1.6 異種生粉相互作用の状態

と著しく異なっていることがわかった。この現象は焼成温度が低い 場合に特に顕著に見られた。この原因としては #S-55 生粉中に含 まれる硫酸根が関係した下記のような化学反応により生成した SO₂ や Cd の作用が考えられる。²⁾

 $Cd SO_4 + Cd S = 2 Cd + 2 SO_2$

熱天秤により硫酸根を含有する Cd S 生粉の N2 雰囲気中の加熱減量を測定した結果、図 1.7 に示すように 550℃附近から上記反応によると思われる重量減少が認められた。

f. Cd S 混合生粉の効果

硫酸根含有率を異にする2種のCdS生粉を混合したペーストを作り、混合比率と焼結膜の特性との関係を調べた。

-24-



有率が増すにつれ、わずかではあるが高まる傾向を示している。

硫酸根含有率の異なる生粉を混合する方法によっては、焼結膜の 特性を大幅に改良することは難しいと思われる。

#S 53	硫酸根(%)	色調	面抵抗(Ω∕□)	透過率 (%)	膜厚(μm)
0	0.05	黒ずんだ黄色	195	78.0	10.5
5	0.4	"	200	77.4	11.3
25	1. 8	明かるい黄色	360	81.6	9. 9
100	3, 5	"	340	81.4	9. 8
	#S - 53 0 5 25 100	#S-53 硫酸根(%) 0 0.05 5 0.4 25 1.8 100 3.5	#S-58 硫酸根(%) 色 調 0 0.05 黒ずんだ黄色 5 0.4 " 25 1.8 明かるい黄色 100 3.5 "	#S-53 硫酸根(%) 色調 面抵抗(Ω/口) 0 0.05 黒ずんだ黄色 195 5 0.4 " 200 25 1.8 明かるい黄色 360 100 3.5 " 340	#S-53 硫酸根(%)色調 面抵抗(Ω/□) 透過率(%) 0 0.05 黒ずんだ黄色 195 78.0 5 0.4 " 200 77.4 25 1.8 明かるい黄色 360 81.6 100 3.5 " 340 81.4

表 1.7 原料生粉混合率と焼結膜の特性

g. 埋込焼成法の検討

異種生粉間の相互作用を積極的に利用するために、CdSペースト

-25-

を塗布した基板をCdS生粉中に埋込んだ状態で焼成し、効果を調べた。

ベースト用生粉は #20151 および #S-53、 埋込用生粉は硫酸根 を多く含む #S-53を使用し、比較のために #20151 についても試 験した。塗布焼成は2回とし、第2次焼成の時のみ埋込焼成を行う こととした。埋込に使用したCdS生粉の量は1回当り約1gである。 なお埋込用生粉に含まれる硫酸根の作用をしらべる目的の実験も行 った。

埋込用生粉	硫酸根 (%)	ペースト用 生 粉	焼 成 温 一次焼成	度 (℃) 二次焼成	面 抵 抗 (Ω/口)	透過率 (%)	膜厚 (μm)
なし	-	#20151 #S – 53	70.0 . //	700 ″	70 83	70 66	17.8 18.6
	3. 5	#20151	620 700 620 700 ″	620 <i>"</i> 700 <i>"</i> 750	106 270 13 10 30	66 70 69 70 68	22.5 21.5 21.0 23.6 21.2
" 5 - 53		#S - 53	620 700 620 700 ″	620 <i>"</i> 700 <i>"</i> 750	150 270 20 20 40	68 70 71 70 72	21. 4 24. 8 20. 8 23. 8 21. 3
#S-53 (水洗)	?	#20151 #S - 53	" "	700	63 42	68 72	19.9 17.4
[#] S- 53 (硫酸根追加)	10	#S - 53	"	"	64	54	20. 7
#20151	0.05	#20151 #S - 53	"	"	4100 2600	47 44	22.5 18.2
# 20151 (硫酸根追加)	8.5	#20151 #S - 53	"	11 11	88 44	67 65	19. 9 19. 3
な し (Cd SO4単独)	4 6. 0	[#] S − 53	"	"	80	67	20.4

表1.8 埋込焼成条件と焼結膜の特性

表1.8に示した実験結果の内容をまとめると次のようになる。

-26-

- CdSペーストを塗布した基板を、硫酸根含有率の大きい生粉 (#S-53)に埋込み、700℃程度の高温で焼成すると、面抵抗10 Ω/口台の低抵抗の焼結膜が得られる。
- ・ 上記の場合面抵抗が小さくなるだけでなく、色調もペースト用
 生粉の種類にかかわらずいずれも明かるい黄色を呈し、透過率が
 比較的良い。
- ハ 硫酸根含有率の大きい生粉を水洗し、含まれる硫酸根の量を減 したものに埋込み、焼成する場合は、面抵抗の低下が少なくなる。
- 二 硫酸根の多い生粉にさらに Cd SO4 を添加し、硫酸根含有率を高めたものを埋込焼成に使用すると、焼結膜は黄色のチョーク状を呈するようになり、面抵抗、透過率とも悪化するところから、適当な硫酸根含有率が存在する。
- ホ 埋込用生粉に硫酸根含有率の小さいもの(#20151)を使用する と、面抵抗が著しく高くなると同時に、黒ずんだ色調となり透過 率は低下する。
- ヘ 硫酸根含有率の小さい生粉にCd SO4 を添加したものを使用する と、上記のような面抵抗が上昇し色調が変化するという現象は起 らなくなる。
- ト 埋込用生粉を使用せず、Cd SO4を単独で焼成容器中に置いても、 特別の効果は起らない。
- チ ペースト用生粉としてはいずれを用いても大差はないが、*20 151生粉は面抵抗に*S-53生粉は透過率に関してやや有利と思われる。
- リ、焼成温度は1次焼成は620°、700℃のいずれでも良いが、2次焼成温度は700℃が適当であり、それ以上でもそれ以下でも良くない。

上記の結果を総合的にみると、埋込焼成効果が得られる原因は(e) 項にも記載したような、CdSと適量の硫酸根とが共存した状態にお いて、高温焼成する際、両者の化学反応により生成する Cd 蒸気およ び SO2 にあると考えられる。即ち、上記反応により発生する Cd 蒸 気が焼成容器内にたちこめ、 Cd S 焼 結膜内部に拡散してゆく結果、 Cd S が Cd 1+x S のように化学量論的組成からずれを生ずるようにな り、これが焼結膜の面抵抗を大幅に引下げる原因と考えられる。

(付記)高抵抗のCdS焼結基板を硫酸根含有率の高いCdS生粉中に 埋込焼成することにより、面抵抗を引き下げることができ る。

CdSペーストを塗布した基板の周囲にCdS 生粉を堆積した 状態で焼成しても、埋込焼成と同様の効果が得られる。

h. Cd S、Cd O 混 合物 共 存 焼 成 効 果

イ. CdS、CdOの化学反応

前項において、CdSとCdSO4との高温における化学反応により、 Cd蒸気などを発生することがわかったが、これと類似のものとし て、CdSとCdOとの間で起る下記の反応があり、より低温からよ り強力に作用する可能性がある。²⁾

 $CdS + 2CdO = 3Cd + SO_2$

このため、上記混合物の熱天秤による重量変化の状態を、まず 最初にしらべてみた。また比較のために各成分単独についても測 定した。



量频点式(00b0, Sb0 8.1 图

-52-
図1.8 に島津製作所製サーマノバランスによ昇温過程とCdS、 CdOおよび両者の等量混合物の重量変化の状態を示した。CdS、 CdOの各単独成分が、900℃附近まで大きな重量変化を示さない のに対し、両者の等量混合物は600℃附近から重量減少がはじま り、700℃附近からはかなり急速な重量減少が見られる。このこ とは前記のようなCdSとCdOとの間の固相反応の進行を示してい るものと考えられる。

n. CdS、CdO混合物共存条件におけるCdS基板の焼成

Cd S ペーストを塗布した 基板を図 1.9 に示すように 焼成容器中に2枚、対角線 上に置き、空いている部分 に Cd S と CdOの混合粉末を 置き、蓋をして焼成を行う。 焼成温度は図 1.8 の熱天秤 による解折結果により700 ℃とした。



図 1.9 焼成容器の状態

表 1.9 に Cd S、 Cd O の混合比率や、混合物の使用量をかえた条件と Cd S 焼結膜の特性とをまとめて示した。なお塗布焼成回数 2回のものは、 2回目の焼成の時にのみ Cd S、 Cd O 混合粉末を添加するのを原則とした。また、ペースト用 Cd S は # 20151、Cd O との混合用 Cd S は # 8 - 53 を使用した。

塗布	焼 成	Cd S	5:0	Cd O	混合物使用量 (g)	面 抵 抗 (Ω/口)	透過率 (%)	膜 厚 (µ ^m)
1	E	4	:	1	1.0	21.5	83.9	9. 2
		2	•	1	0.5	16.5	80. 7	9. 3
					0.7	12.0	80.2	7.4
					1.0	16.0	81.2	6. 8
		1	•	1	0.4	18.5	83.5	8.5
					0.4	9. 0	76.4	10.7
					0.4	14.6*	7 9, 5*	9. 2*
					0. 7	14.0	81. 8	10.9
		1	•	2	0. 3	21.0	82.1	8.7
					1.5	17.0	81.0	9. 8
	D	4	:	1	1.0	4. 5	66.6	20. 7
		2	•	1	0. 6	4. 0	68.1	20.4
2					1.5	5.0	66.8	19.7
		1	:	2	1.5	9.5	57.8	18.8
		0	:	1	0. 3	20.0	· 63.2	19.3
	⊡ * *	3	:	1	1. 2	1 4. 0	85.4	10.1
2		2	•	1	1.5	1 0. 5	86. 6	10.8
		0	:	1	0.4	<u>1</u> 2. 5	84.2	11.6

表1.9 Cd S、Cd O 混合物共存による Cd S 焼結膜の特性

*10個の試料の平均値を示す。

** 第2次塗布はスクリーン印刷後、直ちにスキージでとすり、焼 結膜表面の凹凸を埋めるに必要とする以外のCdSベーストを取 除く方法によった。

図1.9 に示した状態での焼成において、CdS、CdO混合物の繰 返し使用による影響をしらべるため、焼成の都度CdSペースト塗 布基板のみを取換え、CdS、CdO混合物はそのままの状態にして 焼成し、CdS、CdO混合物の繰返し使用回数とその重量変化およ びCdS焼結膜の特性をしらべた。実験条件は、CdS基板の塗布、 焼成回数1回、CdS、CdO混合物の混合比は2:1、添加量は1 gとし、最高温度700℃20分焼成した。

-31-

結果は表 1.10 に示した。

Cd S 基标涂布牌成	Cd S, Cd C) 混合物	面抵抗	透過率	膜 厚
ed e server noor	使用回数	重量減少			
	1 (回)	0. 89 (%)	25(①/口)	80.6(%)	6.3 (μm)
	2	0. 58	20	81.2	6.8
1 🗆	3	0.53	28	77.7	7. 3
	4	0.60	18	79.5	7. 1
	5	0.51	17	80.2	7. 5

表 1.10 Cd S、Cd O 混合物繰返し使用による影響

表 1.9 ~表 1.10 に示した実験結果および関連した追加実験結果 をまとめると次のようになる。

- CdSベーストを塗布した基板をCdSとCdOの混合物を共存させた状態で焼成すると、1回塗りで面抵抗10Ω/口台、透過率 80%、2回塗りで面抵抗4Ω/ロ、透過率68%程度の特性が得られる。また第2次塗布を薄くする方法により、面抵抗10Ω/ ロ、透過率85%という特性の得られる見込みがある。
- CdS、CdOの混合比率は4:1~1:2の実験範囲では影響 は少ない。
- III. CdS、CdOの混合物の添加量は0.3~1.5gの範囲では影響 は少ない。
- iv. CdO単独で添加しても面抵抗が下がるがCdS、CdO混合物に は及ばない。
- V. CdOと混合するCdSは硫酸根の多いものでも少ないものでも 使用できる。ペースト用CdSとしては面抵抗に関しては #20151 が有利である。
- Vi. CdS、CdO混合物を繰返し使用しても焼結膜の特性への影響 は少ない。
- VII. 通常の条件での焼成ではCdS、CdO混合物の減量は非常に少ない。

-32-

- vⅢ. 石英ポートを焼成容器として使用し、多数の Cd S 塗布基板を 同時に焼成することが出来る。
- ハまとめ

上記の結果を総合すると、CdS、CdOの混合物を共存させる焼 成方法は、硫酸根の多いCdS生粉に埋込焼成する方法にくらべ、 面抵抗の低い焼結膜が得やすく、またCdS、CdO混合物は繰返し 使用することができること。石英ボートにより多数の試料を同時 に焼成できることなど、実用性の高い焼成方法と云うことができ る。

i. 酸素含有雰囲気中焼成効果

CdS焼結膜の量産の際には、ベルト炉を使用することが多いが、 そのような場合には、雰囲気ガス中に酸素が混入しやすく、また焼 成容器内部まで完全に窒素置換することは難しく、少なくとも焼成 の初期段階は微量の酸素を含有した雰囲気になると考えられる。し たがって、このような雰囲気中で焼成した場合の効果を確認するこ とにした。

1. 全焼成過程を酸素含有雰囲気とした場合

実験条件はペースト用CdSは#20151、塗布焼成回数1回、焼成温度700℃、焼成雰囲気は酸素0~5%含有する窒素静止雰囲気とした。

実験結果は図1.10 に示すように、酸素含有雰囲気中の焼成により面抵抗は大幅に増加するが、透過率が向上することがわかる。 また焼結膜はつやが出て来るように思われ、ピンホールができに くくなる。



図1.10 酸素含有雰囲気焼成と焼結膜の特性-1

酸素含有雰囲気焼成により上記のような結果があらわれる原因 としては、面抵抗はアクセプターとして作用する酸素の吸着によ り増加すると考えられ、また透過率はCdS塗膜表面にないてCdS と酸素との反応により生成するCdSO4が融剤として添加されてい るCdCl2との相互作用により、効果的な融剤作用をするために改 良されると考えられる。

n. 焼成の初期段階のみ酸素含有雰囲気とした場合

前項の実験にないて、酸素含有雰囲気焼成が透過率の改良に有 効なことがわかったので、これを生かすとともに面抵抗を引き下 げるために、焼成の後半は酸素を含有しない雰囲気に置換し、同 時に Cd S、 Cd O 混合物を共存させる実験を行った。 混合粉末は Cd S: Cd O = 2:1 のもの 0.7g使用。 焼成雰囲気は最初酸素を 2.5 ~ 20%含有する窒素とし、最高温度700℃に到達した後5分 後に酸素を含まない窒素雰囲気に置換し、さらに 15分間700℃ に保持したのち冷却するという焼成方法にしたがった。

図 1.11 に塗布焼成 1 回の焼結膜の初期焼成雰囲気中の酸素含有率と特性の関係を、また表 1.11 に塗布焼成の多いものを 含めた Cd S 焼結膜の特性例を示した。

-34-



図1.11 酸素含有雰囲気焼成と焼結膜の特性-2

塗布焼成		ベースト用 Cd S	02含有率(初期) (%)	面 抵 抗 (Ω/口)	透過率 (%)	膜 厚 (µ ^m)
1		# 20151 # S - 53	20 ″	1 1. 0 1 2. 0	85.5 84.5	11.3 11.4
2		# 2 0 1 5 1 # S - 5 3	" "	5. 5 8. 2	81.3 81.5	2 0. 9 17. 0
3		(*20151) (*S-53)	"	3. 0	69.4	36.2

表1.11 酸素含有雰囲気焼成による焼結膜特性例

上記のように新しい焼成法により、すぐれた特性の焼結膜が得られる。表 1.11の特性を表 1.9 (酸素含有しない雰囲気で焼成した場合)の特性と比較すると、前者の透過率がかなりすぐれている ことがわかる。

酸素含有雰囲気焼成において、酸素が最後まで残留するような 条件のときは、図1.10のように面抵抗が著しく増加するのに対し、 焼成の後半部分を酸素を含まない雰囲気に置換すると、面抵抗の 低いものが得られるのは、高温においては、一旦吸着した酸素の 脱着が起るとともに共存する Cd S、Cd O 混合物の反応により供給

-35-



-36-

される微量のCd 蒸気の拡散によるものと考えられる。

図1.12に試作した焼結膜の面抵抗と透過率の関係を示した。な お比較のため、これ迄に述べた他の方法ならびにネサガラス基板 の上にCdS焼結膜を形成したものも同時に記載した。図1.12よ りこの項の条件によるCdS焼結膜は他の条件によるものにくらべ 面抵抗、透過率とも優位にあり、ネサガラス基板を使用したもの にくらべても遜色ないと見られる。

(6) 結論 および 問題 点

Cd Te 薄膜太陽電池の窓材兼透明電極として使用する Cd S 焼結膜の 製造条件について種々の検討を行った。その結果 Cd S ペーストを塗布 した基板の焼成に際し、 Cd S、 Cd Oの混合物を共存させ、この混合物 の高温になける反応を利用して焼成雰囲気中に 微量の Cd 蒸気を含有さ せる方法が面抵抗の低い Cd S 焼結膜の形成に有効なことがわかった。 即ち Cd S 塗膜の焼結と同時に雰囲気ガス中に含まれた Cd 蒸気の Cd S 焼結膜への拡散が起る結果 Cd S の化学量論 的組成からのずれが生じ、 Cd_{1+x} S となるために、このような効果が得られると考えられる。また このような方法にないて、焼成の前半のみ酸素を含む雰囲気を用いる ことにより透過率の改良が可能となる。

上記の製造法により、現在面抵抗5~10Q/ロ、透過率80~85%、 膜厚10~20μm程度の特性をもつCdS焼結膜が得られており、初期特 性に関しては一応当初の目標を達成することが出来た。

しかし、この焼結模は単独で高温長時間の再加熱を受けると、面抵抗の増加を起す傾向があることがわかった。このため再加熱を必要とする場合にはCdS、CdO混合物を共存させるか、あるいは、あとにつづく工程を面抵抗の増加の起らぬような条件となるよう検討する必要があるなどの問題点が残されており、ひきつづき検討する予定である。

再加熱による面抵抗の増加の少ないCdS焼結膜を得るために、In、 Gaなどドナーとなる不純物を添加する方法が有効であり、今後の方向

-37-

のひとつになると考えられる。

(7) 引用文献

1) N. Nakayama et, al. : Japan. J. appl. Phys. 15 (1976) 2281.

2) D, M, Chiznikov : Cadmium (Pergamon Press, 1966), P. 26~31

3) 有機合成化学協会編:溶剤ボケットブック(オーム社 1967)

4) 中山他: National Technical Report 15 (1969) 154.

1.2.2 CdS 焼結 膜の後処理効果

(1) まえがき

CdS焼結膜の抵抗値はどの様な因子によって影響を受けるのかを調べるために、管状炉で窒素ガス中で焼結して得られたCdS焼結膜を、 色々な雰囲気中で再加熱し、その前後における抵抗変化を調べた。

(2) 実験および結果

a. Cd 雰囲気中での熱処理

1.2.1 で述べた様に微量のCd 雰囲気の存在下でCdS 膜を焼結すれ ば低抵抗の焼結膜が得られる。そこでCd 雰囲気の少ないところで焼 結した抵抗の高い焼結膜でも、もう一度Cd 金属と共に熱処理すれば 低抵抗化できると思われる。ここではまず面抵抗が5KΩ/ロの2回 塗布焼成CdS焼結膜をCd 金属と共にアルミナケースの中に入れ、窒 素ガス中で200℃~630℃の各温度で20分間保持した場合の抵抗変 化について調べた。





-40-

図1.13は、その結果であり、320℃以上で熱処理すれば面抵抗を ~10Q/口迄低くすることができる。 しかし熱処理温度が500℃を 越えると焼結膜の色が黒っぽくなってくる。これはCd が過剰になっ たためだと考えられる。したがって熱処理温度としては300℃~ 400℃が適当である。

次に 1.2.1 (5) h.で述べた方法 (CdS膜をCdSとCdOの混合粉とと もに焼成する方法)によってつくった面抵抗 8Ω/口の低抵抗 CdS 膜 を 330℃で 20分間 Cd 雰囲気中で熱処理し、 更に低抵抗化すること を試みた。しかしこの場合は、これ以上面抵抗を下げることができ ず、 8Ω/口のままであった。

b. 空気中での熱処理

CdS薄膜を酸素のある雰囲気中で熱処理すると一般に抵抗が高く なる。これは酸素がCdS膜の硫黄空孔の中に入り込んだり¹⁾、 CdS 膜表面に吸着しアクセプター準位をつくる²⁾ため高抵抗化すると説 明されている。

ここではCd 雰囲気の少ないところで焼結した高抵抗の焼結膜①および微量のCd 雰囲気の存在下で焼結した低抵抗の焼結膜②を空気中で熱処理した場合、その抵抗値がどの様に変化するかをまず調べ、 次に抵抗変化の大きい焼結膜①についてさらに詳しく抵抗変化の模様を調べた。

図1.14は面抵抗が5KQ/ロの焼結膜①および50Q/ロの焼結膜② を空気中で熱処理した場合の面抵抗の変化を示したものである(焼 結膜①、②共1回塗布焼結膜)。焼結膜①は125℃の処理度でも抵 抗が徐々に高くなるが、焼結膜②は125℃では約30分間経過しても 抵抗は変化しない。しかし250℃に加熱すると30分間で5KQ/ロと 100倍にまで面抵抗は高くなる。

-41-



図 1.14 空気中での熱処理による Cd S 焼 結膜の抵抗変化

真力了 邸室 灯 顕 誘 熟 かった り 茂 赴 高 丁 っ よ 3) 野 処 熱 の 丁 中 浸 空 。 6

● ひちおう
 ● ひまおう
 ● ひまおう
 ● ひまかう
 ● ひょ
 ● ひょ
 ● ひょ
 ● ひょ
 <l

内型型式

内型型域

内型型域

内型型域

中型型式

</l

外変抗速の合影なし置対態室を鄭諾親 8 bO

オノ外放进高て。より理処焼のて中灵空 d1.1図



(間毎)間 部 置 放 盛 室



およびその後の各種処理による抵抗変化

空にしても初期の抵抗値にまでは戻らないが、窒素ガス中で最初の 空気中での熱処理温度以上の温度に加熱すれば初期の抵抗値(5KΩ /ロ)にまで戻ることが分る。

c. H₂ 雰囲気での熱処理

前述した様に空気中での熱処理はCdS焼結膜の抵抗値を上昇させる。それでは還元性雰囲気であるH2中での熱処理はCdS焼結膜の抵抗値に対しどの様な影響をおよぼすであろうか。ここではまず面抵

-44 -

抗が2.5KQ/ロの2回塗布焼結膜をH2中で熱処理した場合の抵抗変化を調べた。結果は下記の様に、H2中での熱処理はCdS膜の抵抗を低くすることができる。

 $2.5 \text{ KO} \square \xrightarrow{\text{H}_2 \oplus 320^{\circ} C 20 \text{ }} 13 \Omega \square$

2.5 KQ/ $\square \xrightarrow{H_2 \oplus 440^{\circ} C 20 \mathcal{F}} 16 \Omega/\square$

ここで440℃で熱処理した Cd S 膜は色が黒っぽくなっている。した がって熱処理温度は320℃で充分である。次に面抵抗が80/口の2 回塗布焼成膜を320℃で20分間 H2 中で熱処理し、 更に低抵抗化す ることを試みたが、この場合は面抵抗が80/口のままで変化しなか った。

(3) 考 察

Cd 雰囲気中、H₂中、真空中でCdS単結晶を熱処理すれば硫黄空孔が 結晶表面にできて低抵抗化し^{1,3)}、酸素中でCdS焼結膜を熱処理すれば 硫黄空孔をつぶして高抵抗となると一般に言われている¹⁾。ここで得ら れた結果もこの雰囲気の効果を裏書きしたものであるが、ただ予想以 上に低い熱処理温度で抵抗値が変化する点が異なっている。例えば空 気中では125℃で抵抗が変化するものもある。これに対して文献1)の 焼結膜では300℃までは殆んど変化しないと記されている。太陽電池 をつくる場合には、このCdS膜の上にCdTeを塗布しもう一度 600 ~ 700℃で焼結するが、この過程でCdS膜の抵抗が変化しない方が望ま しい。抵抗が余り変化しないCdS焼結膜を得るためには、例え表面状 態が変化しても内部までは変化しない様に膜厚を厚くするとか(現在 は2回塗布焼成膜で~20μmの厚さ)、あるいは欠陥の少ない、単結 晶に近い膜をつくる方法等を検討しなければならない。

また Cd 雰囲気中、H2 中での熱処理は高抵抗の Cd S 焼結膜を面抵抗 ~10Ω/ロ に 迄下げることが できるが、低抵抗の Cd S 焼結膜(8Ω/ロ) をなお一層低抵抗化することはむつかしい。硫黄空孔で低抵抗化する

-45-

方法では、数Ω/口の面抵抗が一応の限界の様に思われる。

(4) 結 論

- a. CdS焼結膜をCd雰囲気中またはH2中で熱処理することによって 面抵抗~10Ω/ロに迄低抵抗化することができる。処理温度は300 ~400℃が適当で、あまり高温で処理するとCdS焼結膜の色が黒っ ぼくなり、光透過率が悪くなる。
- b. Cd 雰囲気中またはH2 中での熱処理は面抵抗 10Ω/口以下の Cd S 焼結膜の低抵抗化には効果がない。
- c. CdS 焼結膜を空気中で熱処理すると高抵抗化する。この高抵抗化した焼結膜を、もう一度窒素中で空気中での熱処理温度より高い温度で処理すると最初の抵抗値に戻る。
- (5) 引 用 文 献
 - 1) S. Kitamura : J. Phys. Soc. Japan 15 (1960) 2343.
 - J. I. Pankove : "Optical processes in semiconductors", (Prentice-Hall, Inc., 1971) P.353.
 - 3) J. S. Skarman : Solid-State Electronics 8 (1965) 17.

1.2.3 接合形式

(1) まえがき

50 年度の研究で、スクリーン印刷方式による焼結薄膜形 Cd S、 Cd Te 太陽電池素子の検討を行い、前者で4%、後者で5%台の素子が得 られた。ここでは両者ともに Front-Wall 形であった^{1~3)}

本年度は In2O3 膜のついたガラス基板上に順次CdS、CdTe 焼結膜 をスクリーン印刷法で形成させたのち、CdTe 膜上に浸漬法でCu2Te 層を形成させた Back-Wall 形の素子で変換効率8%台のものが得られ た。さらに最近ではCdS焼結膜の低抵抗化と光透過率の向上により、 高価な In2O3 膜をつけない裸のガラス板を基板として使用し、上記と ほぼ同等な素子を得ている。

さらに実用的な観点から大面積素子の試作も開始しているが、大面 積化に伴うシリーズ抵抗の増加による性能の低下を防止し、且つ有効 面積率を向上させる構造等についても検討している。

(2) 試料作成

a. 基 板

基板として厚さ 0.8 mmの 硼硅酸系ガラス板(商品名:ダウ-7059) を使用している。使用する際にはこのガラス基板を充分に洗浄、乾 燥させておくことが必要である。

b. CdS 焼 結 膜

市販の高純度CdS原料(純度:4N、粒度:10⁻²~10⁻¹μm)を石 英ポートに入れてN2中、700℃、2時間、仮焼を行う。この工程に よってCdS生粉中に吸着、含有している揮発性成分を除去すること によりCdS原料の製造ロット間のばらつきを少なくすると同時に、 あらかじめ粒成長させておくことにより、CdS焼結膜形成過程での 収縮率を小さくし、より均質なCdS焼結膜を作成することを目的と している。このようにして得たCdS仮焼粉を純水とともにらいかい 機中で粉砕する。粉砕時間はらいかい機内に充填するCdS粉末の量 はともに 6 N である。これを電気炉内に設置して約 1,100 °C に加熱し て熔融後約 - 50 °C / hr の冷却速度で徐冷して Cd Te 多結晶塊を作成す る。このようにして得られた Cd Te 多結晶の抵抗率は $10^6 \Omega$ - cm 程度 である。これに対して Cd Te 中に不純物として 0.15 mol %の In また は Al を 添加して作成した n 形 Cd Te 多結晶の抵抗率は $10^{-1} \sim 10^{\circ} \Omega$ cm 程度である。 Cd Te 合成の際、冷却速度を遅くすると抵抗率が低 くなる傾向にある。

上記の方法で作成した Cd Te 多結晶塊をあらかじめ直径 2~3 m以下に粗く粉砕しておき、これに融剤および結着剤として Cd Cl2とプロピレングリコールを添加してらいかい機中で粉砕混合し、スクリーン印刷用 Cd Te ベーストを作成する。 このようにして得られた Cd Te ベーストの粘度は 1,030 CP であった。 但し、粘度測定は振動 法による。

次に、このようにして得られた Cd Te ベーストを 325 メッシュの ステンレス製スクリーンをつけた印刷機を用いて b 項で作成した Cd S 焼結膜上にスクリーン印刷したのち、真空中で 120℃、1時間乾 燥する。これをアルミナ製の焼成用ケースに入れ N2 雰囲気の電気炉 中で焼成して Cd Te 焼結膜を形成させる。焼成条件は通常 650° ~ 700℃、30~60 分間程度である。焼成温度の設定は後述の Cd Te 焼成過程の熱天秤による解析結果を参考にしている。

図1.20 に Cd Te ペーストの電子顕微鏡写真を示す。 これよりペーストを構成している Cd Te 粒径は 1 μm 以下と評価される。

-51-

図 1.21 に上記条件で作図した Cd Te 焼結膜表面の電子顕微鏡写真 を示す。これより Cd Te 焼結膜の粒径は10~15 μm と評価される。 膜厚は10~15 μm 程度である。

CdTe膜の厚さと粒径の関係から、 ここで得られている CdTe 焼結膜は近似的には CdTe 粒子の単層から構成されているもの と考えられる。

d. Cu₂ Te 層形成

c項で作成した Cd Te 焼結膜を塩化第 1 銅 Cu Cℓ の飽和熱水溶液 (90°±5℃)中に短時間浸漬することにより、Cd Te の焼結膜の表面 部分に Cu 2 Te 層が形成される。

これは次の反応式で示されるようにCd Te 中の Cd が液中の Cu⁺1オ ンによって置換されることにより Cd Te の表面部分に Cu₂ Te 層が 形式されるからである²⁾。

 $Cd Te + 2 Cu^+ = Cu_2 Te + Cd^{++}$

これを十分水洗したのち乾燥する。

e. 電極、リード線付け、樹脂モールド

b項で形成された Cd S 焼結膜の一端に In − Ga 電極を付けて陰極、d 項で形成された Cu₂ Te 層上に Ag ペイントを塗布して陽極とし、それ ぞれの電極からリード線を引き出したのち裏側のガラス板との間に 樹脂層を狭んでサンドイッチ構造の素子を完成させる。素子構成の 詳細は後述する。

図1.22 に完成素子の模式断面図を示す。

図 1.23 に最近の改良された完成素子の模式断面図を示す。ここでは Cd S 焼結膜の低抵抗化と光透過率の向上により、高価な In2O3 膜を付けない裸のガラス基板を採用している。

S他であるで総曲V-Iの千素加完オン示了88.1図108.1図
 MAU:獎㈱総雷セッセ} - モーッシェシーモーマ、フリム源光用

(
副 ての 率 依 強 変) 封 持 V - I ホ

8. 應結薄膜形 Odf • 大陽電池の特性.

果諾ひよな競美 (5)

Od S 膀胱膜の低抵抗化と光透過率の向上により In2O3 膜を付けたい秤のボラス基板を使用

図面 湖 法 鄭 の 千 素 如 宗 六 パ ち 貞 迩 8 5.1 図





1型}を使用し、AMO 140 mW/cdの条件で測定した。測定中の素子の表面温度を直接測定していないが室温20℃の恒温室内で測定中の素子の温度上昇を空冷方式で防止した。このI-V曲線より同素子の変換効率は8.1%と評価される。



図 1.24 素子の I - V 特性(素子面積: 0.36 cml)
 光源:ウシオ電機㈱製ソーラーシュミレーター
 UAM-1(AM=0, 140 mW/cml)

D. 分光感度曲線

図 1.25 は同上素子(図 1.23)の分光感度曲線を示す。測定に使用 した分光光度計は JARRELL-ASH, Type JE-25 Eである。

図中、短波長端および長波長端はそれぞれ ÇdS、CdTeの吸収端 にほぼ対応している。

この図から同素子のCdS焼結膜は窓材として作用しているものと 考えられる。したがってCdS膜の透過率を向上させると同時に抵抗 率を低くすることが太陽電池素子の変換効率の向上に寄与するものと考えられる。



b. 熱天秤による Cd S、Cd Te 焼成過程の解析

この実験の目的はCdTe、CdSの焼結機構を解明し、それに基いて 最適焼成条件の確立を図ることである。この実験装置の原理は上皿 天秤の一方に分銅をのせ、他方に測定用試料を入れた白金製容器を 吊してバランスをとりながら、試料部分を小型電気炉で一定速度で 加熱し、そのときの試料の重量変化分を測定することによって焼成 過程中の反応を推定出来るようになっている。

CdS、CdTe焼結膜の性質は、焼成温度、 雰囲気、融剤の添加量 等によって大きく左右される。例えば、平均粒度が 0.03~0.05 μm の CdS原料に融剤を添加しないで不活性雰囲気中で焼成した場合、 600℃、120分間で 0.3~0.5 μm 程度にしか粒成長しないが、同一焼 成条件下で融剤として Cd Cℓ2 を 5Wt・%、 10Wt・%添加した場合に はそれぞれ 5~10 μm、 7~15 μmと粒成長が著しい。 CdTe の場合 にも同様な効果が認められる。このように融剤を使用することは粒

-56-

を使用する場合には素子形成後、残存した塩素が素子の寿命特性に 悪影響を与える可能性があるので Cd S、 Cd Te 膜の焼成条件を決定 する際にはこれらの点も含めて考慮する必要があろう。ここでは以 上の主旨に沿って Cd S、 Cd Te 膜の焼成条件を決定するための参考 資料を得る目的で熱天秤による Cd S、 Cd Te 焼結過程の解析を行っ た。

以下、順次CdTe、CdSについての解析結果を示す。

1. Cd Te の解析結果

non dope Cd Te にそれぞれ(A) 10 Wt・%、(B) 4 Wt・%、(C) 1Wt・%、(D) 0 の Cd Cℓ₂ を添加した Cd Te ペーストを真空中で 120℃、1時間乾燥したのち1gを秤量して測定用白金容器内に 入れ、熱天秤装置内に挿入して、N₂ 雰囲気中で実験を行った。実 験条件はN₂流量25 cc/mi、昇温速度は約200℃/hr である。

この装置の原理は天秤をN2雰囲気中に閉じ込め、試料部分を一 定速度で加熱しながら試料の重量変化を測定するもので、図1.26 に示されるような焼成過程中の試料の重量変化曲線が得られる。

図中(A)、(B)、(C)、(D)の曲線はそれぞれ Cd Te 中の Cd Cl₂ 添加量が 10Wt・%、4Wt・%、1Wt・%、0Wt・%の場合である。 これらの曲線の全体的な傾向として、Cd Cl₂の添加量が増加するにつれて、より低温側から重量変化が観測されている。特に Cd Cl₂無添加の曲線(D)では約750℃以上ではじめてCd Te の昇華による重量変化が観測される。曲線(A)、(B)、(C)は図中に示すように、(I)、(II)の2つの領域に大別され、(I)の領域における重量変化は融剤としての Cd Cl₂が周囲の Cd Te と反応し、粒成長と焼結反応を促進させると同時に主として Cd Cl₂の蒸発によるものとして、また、(II)の領域における重量変化は Cd Te の昇華によるものとして説明されよう。

したがって、(II)の領域に入る前に融剤としてのCdCl2は飛散

-57-





-58-

しつくし、(II)の領域では Cd Te の昇華のみが起っているものと考 えられる。(2) c で述べた、 Cd Te 焼結膜の焼成温度の決定は、 こ れらの曲線にもとづいて行ったものである。例えば Cd Te 中の Cd Cℓ2 添加量を 1Wt・%とした場合の Cd Te の焼成温度を 700℃ と決 定した理由は次の通りである。図 1.26 中の(C)の曲線から(I)の 領域における反応の完了温度は約 690℃であり、この温度に達す ると試料中の Cd Cℓ2 は飛散しつくすものと考えられる。したがっ てここで採用している Cd Te の焼成温度 700℃ の場合には試料中 の Cd Cℓ2 は飛散しつくしているものと考えられ、実際に Cd Te の 昇華が一部発生していることが観測されている。

n. CdSの解析結果

(2) b で作成した Cd S ペースト(Cd Cℓ2 添加量 5 Wt.%)を真空中 で120℃、1時間乾燥し、そのうちの1gを秤量して白金容器中 に入れ、熱天秤内に設置して実験を行った。実験条件は前記 Cd Te の場合と同じである。

この場合には、図 1.27 に示すように 500 ℃ 近傍から顕著な重量 変化が観測されるが、これは重量変化分から考えて Cd Cl2 の蒸発 と Cd S の昇華が同時に起っている領域と考えられ、同時にこの近 傍で Cd S 焼結膜の粒成長が著しく促進されはじめる温度帯でもあ る。



図 1.27 熱天秤による Cd Sの重量変化 {Cd S + Cd C l₂ (5 Wt ·%)} = 1g

近 (2) 미 \mathbf{N} 5 鼦 A ł \mathbb{X} μm Od 旕 Э بسر 掖 圅 \sim 齨 Te e Э 承 芩 A Cd Te Э \cap XMA 署 岽 寐 Чų :04 20 芶 寂 ลิ Ã $\boldsymbol{\sigma}$ Э R ᢞ 犵 ¥ 摵 \mathbf{EV} Š 0 es. 췯 σι Cd 0 安 猑 цm Ø 佉 剰 1 ₽ P% Cd Te Cd 瀫 쉐 Te Pg1 ۰ł 쉐 遠 湭 0 Ц, 崔 4 γ 0 Ц ∄ ť, \mathbb{X} 密 丧 σ 中(1) Э Э 嚉 ₽ S Э Ā . 掖 瀫 Cd Te Å ۵Þ Te Э თ H Cd Te 寐 -#-罴 124 步 安 A 鸮 衒 佑 怸 1 王 \sim



× ÷ N 9 XMAIC 安布 (1) Cd Te \sim 피 ᢞ᠇ᡟ の粒子中央部 94 視野内の Cd Te Cd S 1 Cd Te (2) Cd Te 粒界近傍 境界近傍の 粒内EV分布曲線 \mathcal{O} 1 Te YI 紊

Cd Te 璬 VI. Ŕ ล V 兹 1 N 9-1 芳 Od Te Ç. ₿¢ Å ∄ er v ${\bf v}$ 0 ⊁ 芩 怸 턦 匋 4 \sim 9 Э μm Ł 摵 \sim 9 ₩ $\widetilde{\mathbf{m}}_{\mathbf{m}}^{\mathrm{n}}$ ₽ 掖 副 Э 9 ΩÞ 褓 瀫 ų 9 Ã 遫 124 彩 革 4 Pg4 124 t, $\overline{}$ 읫 Э 4 ふ た 安 Ľ 鄀 佑 嵳 剰 ¥ Ş, \$ 影 J X PH た اسما • co Cd 0 7. Te Э 3 쁼 Ш 芯 노 걩 4 팝 4 Э Э . 芲 堆 \vdash 띩 繱 폡

Ц

ಕ್ರ

0

4

ก 衒 Э A Ś 0 4 衒 $\mathbf{C}\mathbf{d}$ N R 4 毛 Э Te 3 et the 挝 87 擌 演 $\mathbf{C}_{\mathbf{u}}$ 撄 \mathcal{C} S ₽⊳ 羐 ล 54 $\widehat{}$ ş, E . . 袨 4 Э Cd Te K $\mathbf{C}\mathbf{d}$ \$ 冹 Cu_2 挝 l Te \mathbf{h} 14 费 Y, \mathbf{Te} Э 酩 (格子拡散) Ŕ 첞 e v 畨 圜 1 圣 嬱 Å \cap Э Ť თ \subset 羐 密 $C_{\mathbf{u}}$ A 讹 斑 5 围 Э ÿ 撄 5 ⊕ 至 Y 夹 4 潂 a 5 퍦 Ś 灾 9-4 ()NA A 3 V, \cap ť, 瘷 æ ก 1 た Э 9-1 Ou₂ Э \cap Ş 深 \cap $\overline{}$ A Te 04 Cd Te A h 冕 ŗÇ, 遇 斑 $\hat{\Delta}$ 嵳 岊 萝 თ 衒 the 124 af Q +Ľ, ev Š Ţe K 豯 9-Э

-62--

25

р

び

渔

4

ø.

Θ

 \sim

20

 \mathcal{S}^{2}

t,

e)

0



図1.30 Cd Te粒子内になける接合の深さの分布状態。 黒丸・実線は粒界から2 μm間隔で解析した結果を示し、他の2本 はそれぞれ異なった Cd Te 粒子の粒界近傍および中央部の解析結 果を示す。 さらに詳しく接合構造を調べる目的で2次元的な解析を試みたの であるが、多量の電子線照射による局所的な発熱のため測定中に EV像が変化し明確な解析結果が得られなかった。これはCdTe中の Cuの拡散係数が大きいので発熱によりCu拡散状態、 すなわち接合 状態が変化したためと考えられる。

このため、解析試料の Cd Te 表面に Cu₂ Te 層の代りに Cu よりも拡 散係数が低いと考えられる Sb 層を形成させたのち、 N₂ 中 500℃ で 熱処理をすることにより Cd Te 中に Sb をアクセプター として拡散さ せた素子について上記 2 次元的な解析を行った。

この解析に先立ち、Sbの拡散温度と得られた素子の電流・電圧特性との関係を検討した。

図1.31にSbの熱拡散温度と得られた素子の電流・電圧特性との関係を示す。熱処理時間は各試料とも30分間に統一してある。この図から、CdTe中へのSb拡散は400℃以上で顕著に行われ、この最適温度は500℃近傍に存在するものと考えられる。400℃の点では電圧は最適温度の93.2%に達しているのに光電流値は7.5%に過ぎない。処理温度が200℃、120℃の場合にはこの差がさらに拡がっている。400℃以下ではSb拡散層が浅いために接合の位置がCdTe 焼結膜表面部分に形成されており、入射光が接合まで殆んど到達していないことを意味している。



図 1.31 Sb 拡散温度と素子の電流・電圧特性 (熱処理時間は各素子とも30 分間)

以上の結果にもとづいて、Sb 層形成後の熱拡散条件を500℃、5 分間と500℃、30分間に分けて解析を行った。前者については、図 1.32と1.33で、後者については図1.34と1.35でその詳細を説明す る。

図 1.32 は 0.15 mol・%の In を添加した Cd Te 焼結模上に、Sb 層を形 成させたのち、N2 中 500 ℃、5 分間熱処埋を施した素子の接合近傍 断面の (A) 電子顕微鏡写真であり、(B) 同一視野内の電子線起電力 像である。(A) から Cd Te 焼結膜を形成している Cd Te の粒径は 15 ~20 μm 程度であり、この視野内では Cd Te 膜は単層になっている。 (B) は同一視野の電子線起電力像であり、(A) と(B) の位置関係を 対応させてみると、電子線起電力の発生個所は Cd Te 膜の表面部分に 当る。この詳細を調べるために同視野内の Cd Te 粒子の中央部を一次 元的に XMA による S、Te 元素分布と同一場所の EV 分布を重量させ て解析したのが図 1.33 である。この図からも電子線起電力が発生し ているのは Cd Te 膜の表面部分であることが分る。これらの結果から Sb は Cd Te 膜のごく表面部分にのみ拡散していることが分る。



(図1.32と同一視野内)

EV (arbitrary unit)

-68-

次に図1.34はN2中、500,℃、30分間熱処理した素子の接合近傍 断面の (A) 電子 顕 微 鏡 写 真 と (B) 同 一 視 野 の 電 子 線 起 電 力 像 を 示 す。 (A)と(B)の位置関係を対応させてみると、電子線起電力の発生個所 はCdS層とCdTe層の境界近傍にあることが分る。この詳細を調べる 目的で 同 視野 内 の Cd Te 粒 子 の 中 央 部 を 一 次 元 的 に XMA に よ る S 、 Te元素分布と同一場所のEV分布を重畳させて解析したのが図1.35 である。この図から、電子線起電力のピークの位置はCdS層とCdTe 層の境界からCdTe内約0.5 µmのところに認められる。 この結果か ら上記熱処理条件ではSbがCdTe内にこの深さまで拡散しているも。 のと考えられる。図1.34 (B) 中、Cd Te の粒界に対応している部分が くびれているのは Cd Te 中への Sb の格子 拡散と粒界 拡散の 差に よる ものと考えられる。一般に粒界拡散係数と格子拡散係数の差は大き いため、接合形成がアクセプターとしてのSbの拡散によるものであ れば、接合の形状は可成り複雑なものになるであろうという予想を 裏切ってとの写真で見られるような比較的平坦な形状を示している。 この現象は次のように説明されよう。

すなわち、CdTe焼結膜形成時にCdS焼結膜内の過剰なCdがCdTe 膜内にドナーとして拡散する際、特にCdTe粒界に高濃度に拡散し ているものと考えられる。これはCdTe膜内へのCdの格子拡散係数 と粒界拡散係数の差によるものである。

次にCdTe 焼結膜の表面にSb層を形成させたのち、熱処理するこ とによって、SbがCdTe 模中、特に粒界に沿ってアクセプターとし て高濃度に拡散するが、この際あらかじめCdTe 膜内にドナーとし て拡散しているCdとの間にCross dopingが行われ、ドナー濃度とア クセプター濃度の差が0になる部分に接合が形成されるわけである が、このCross dopingがCdTe 膜の粒内ならびに粒界を通じて行われ た結果、前述のような予想外に平坦な形状の接合が形成されるもの と考えられる。

-69-



XMAによるS、Te元素分布と同一場所のEV分布曲線

(図1.34と同一視野内)

-71-

(arbitrary ΕV unit) 図1.36は以上の結果にもとづいた、焼結薄膜形CdTe太陽電池の 接合構造の模式図である。この図から分るように、CdS焼結膜側か ら光を照射した場合には、n・CdTe-p・CdTeのホモ接合の表面に n・CdS層を付けた構造の、n・CdS-n・CdTe-p・CdTe系へテロ表面 形接合が形成されているものと考えられる。



図1.36 焼結薄膜形Cd Te 太陽電池の接合構造の模式断面図

また、図1.36からSbを過剰拡散させることにより、素子の電流・電 圧特性が低下することが分るが、この拡散条件に対応した、600℃、30分 間熱処理した素子の接合近傍断面の解析結果を図1.37に示す。この場合 はEV分布のビークの位置はCdS層とCdTe層の境界に存在し、両層 側に可成りブロードな分布を示している。

この場合はCdSとCdTeのヘテロ接合と考えられるが、前述のヘテロ表面形接合に比べて性能が低下しているのはCdS層とCdTe層の境界における結晶格子間の不整合や表面準位の存在によるものと考えられるが、これらの詳細に関しては今後の課題である。
XMACLSS. 30分間熱処理した素子) (Cd Te 焼結膜表面に Sb 層を形成させたのち、N2中、600℃ Te元素分布と同一場所のEV分布曲線



EV (arbitrary unit)

-73-

(4) 大面積素子 (4 cm × 4 cm)の 試作

a. 性 能

図1.38は浸漬法で接合を形成させた素子のI-V曲線であり、変換効率 6.3% (50mW/cf W光)と評価される。 この場合、浸漬面ならびに電極形成を手塗りで行っているため有効面積率は約50%である。 CdS 焼結膜の面抵抗はCdTe 膜形成後で 15Ω/口程度のものを使用。



図 1.38 I-V曲線

b. 構 造

前回にも述べたように、大面積化に伴う素子のシリーズ抵抗の増加による矩形率の低下を防止する目的で図1.39に示すような、4ケの細胞素子に分割した構造にしてある。図中、斜線部分がCdTe 膜

で、この上に有効面積率約50%のCu2Te層を浸漬法で形成させている。ここで採用している有効面積率の定義は次のようである。



有効面積率 = 接合面積(Cu₂ Te 層の面積)/全面積(4cm×4cm)

図 1.39 素子構造図

白い部分がCdS焼結膜 斜線部分がCdTe焼結膜 黒い部分がCu2Te層 有効面積はCu2Te層面積と一致する 有効面積率約50%

(5) ま と め

前述のように、CdS焼結膜の粒径は10~15 μm程度であり、CdS膜 の厚さが20~30 μm程度であるからCdS焼結膜はCdS粒子が精々2~ 3層から構成されていると考えられる。また、CdS膜の主な役割は接 合構造の解析結果から窓材として作用している。この効果を十分に活 用するには、CdS膜の光の透過率を向上させることと抵抗率を下げる ことが必要である。CdS焼結板の透過率に関する検討結果によれば⁹⁾ 透過率と気孔率との間に密接な関係が認められ、これよりちみつなCdS膜をつく る必要があると考えられる。

また、ドナーとなる不純物元素を添加しないCdSの抵抗率はSの格子欠陥濃度と結晶格子間隙に入ったCdイオン濃度に依存すると考えら

-75-

れている。(2) b で述べた方法で作成した Cd S 焼結 膜の抵抗は主として 前者に依るものと考えられるが、この方法で現在得られている Cd S 焼 結膜の面抵抗は Cd Te 膜形成後で 15 ~ 30 Ω/口程度である。

Cd Te 焼結膜の粒径は10~15 μm 程度であり、膜の厚さが10~15 μm であることから、Cd Te 焼結 模はCd Te 粒子が精々1~2 層から構 成されていると考えられる。Cd Te の焼成温度をCd Te が昇華する温領 域まで上げた場合には、Cd 蒸気圧とTe 蒸気の差によりCd Te 膜表面部 分はTe 過剰となり、弱いP型Cd Te 層が形成される。

接合構造の解析結果によれば Cd Te 焼結膜上に形成された Cu2Te 層 や Sb層は主としてアクセプター源として作用し、2次的に電極の役割 を果している。また、同上の結果によれば、ここで得られている焼結 薄膜形 CdTe 太陽電池は n・CdS-n・CdTe-p・CdTe 系のヘテロ表面形 接合であると考えられ、接合の形成ならびに接合の最適位置の制御は アクセプターとしての Cuまたは Sbの CdTe中への拡散によると説明さ れる。太陽電池素子の大面積化に伴う素子のシリーズ抵抗の増加によ る変換効率の低下を防止するため CdS 焼結膜の抵抗率を下げることと CdTe 膜をいくつかの細胞素子に分割した構造にする2つの方法を併用 している。この方法で、現在有効面積 7.8 cd の素子で変換効率6.3%を 得ている(50 mW/cd・太陽光相当タングステン光下)。

(6) 引用文献

- S. Vojdoni, M. Doroudian, A. Parrizi : International Conference on Photovoltaic Power Generation; Hamburg, Sept. 25-27 (1974) 217.
- 2) D. A. Cusano : Solid-State Electron. 6 (1963) 217.
- 3) D. A. Cusano : Revue de Physiquee Appliquee 1(1968) 195.
- D. Bonnet and H. Rabenhorst : Record 9th. IEEE Pnotovoltaic Specialists Conference (IEEE, New York, 1972) 129.
- 5) A. L. Fahrenbruch, V. Vasilchenko, F. Buch, K. Mitchell and

-76-

R. H. Bube : Appl. Phys. Lett. 25 (1974) 605.

- 6) A. G. Milnes and D. L. Feucht: "Heterojunctions and Metal-Semiconductor junctions" (Academic Press, 1972), 128.
- 7) K. Yamaguchi, N. Nakayama, H. Matsumoto, Y. Hioki and S. Ikegami
 : Japan. J. Appl. Phys. <u>14</u> (1975) 1397.
- 8) N. Nakayama, H. Matsumoto. K. Yamaguchi, S. Ikegami and Y. Hioki
 : Japan. J. Appl. Phys. <u>15</u> (1976) 2281.
- 9) 中山信男、松本仁:エレクトロニク・セラミクス 1976 年春号,9.

1.3.1 はじめに

スクリーン印刷、焼結方式による太陽電池の製造法は、厚膜集積回路 の技術がそのまま使え、量産性の点で優れた方式であり、太陽電池の低 コスト化の方式としては最も有望と考えられるが、前記焼結法(I)の方 式では、 n・Cd Te 層の表面に水溶液置換法で Cu2-xTe 層を形成し、熱処 理することによって Cd Te 層内にホモ接合を形成しており、 比較的不安 定と考えられる水溶液置換法による Cu2-xTe 層を含んでいるために、 再 現性と劣化の点で問題が生ずる恐れがある。

そこで、Cu_{2-x}Te層を必要としないいわゆる n・CdS/p・CdTe ヘテロ接 合方式の太陽電池のスクリーン印刷、焼結法による試作検討を行った。 実験は主に、 n・CdS焼結膜上に印刷した CdTe 膜を焼成と同時に p型に するための焼結条件や燐などの不純物添加の検討、CdS焼結膜の低抵抗 化のためのGa添加の検討などを行い、特性の向上をはかった。これらの 結果について述べる。

1.3.2 試作検討用素子の構造および製造方法

試作検討した素子の構造は、図1.40 に示す様に、CdS 側を受光面とする後面照射形とした。また、試作した裸素子およびエボキシ樹脂で包埋した素子の外観写真を図1.41 (a).(b) に示す。



-78-

抗に関係する比抵抗は、主に焼成条件とCdSに添加する。CdCl2の量 によって決まる。ここではCdSに対して10Wt・%添加した印刷用ペース トを上述の条件で印刷、焼成を2回繰り返し行ったもので、透過率 80%以上、比抵抗0.5Ω-cmの膜を用いた。

アクセプター不純物をドープしない Cd Te 膜を焼成条件だけで p 形 化する方法として Cd Te と Cd Cℓ2 の共晶温度は約500℃であるが、 あ まり低い温度で焼成すると Cd Cℓ2 中の Cℓ が Cd Teに対してドナー不純 物として作用し、 n 形になる可能性があるのではじめから比較的高い 温度で焼成を行った。



図 1.42 無添加 Cd Te 膜の焼成温度と Voc, Isc の関係

図1.42は、5Wt・%のCdCℓ2を加えたCdTe印刷膜を625℃以上の 温度で30分間焼成した時の焼成温度と素子のVoe, Iscの関係を示した。 Vocは、温度を上げても余り増大しないが、Iscは温度の上昇にともな い大きく増大してゆく傾向がみられた。Voc, Isc 共、最も大きい値を 示した焼成温度は750℃であった。



図 1.43 CdS中のCdC ℓ_2 の添加量とベルトスピードの関係

2 Θ 凝 12 5 Gt 闵 5 焼成時間 \mathbf{x} ა 牾 \sim PS' \mathbb{X} ο 5 ž 124 • >. 0 5 DO Å \$ \sim 7 ω 密 1 \mathfrak{D} な 業 ~~' A 成時間が長 æ 2 ж er V 4 ĸ . CdSの 窯 統加 θ 函 の特性 Ц, Q 妥 卫 $C\ell_2$ -副 Ş. 7, Ś 谻. ¥ . ลิ \sim Θ $\mathbf{O}\mathbf{d}$ 成時間 σ 3 4 どの様に影響す ette H Cl2 ť, ، رو 3 24 P\$ た \cap £ \sim 変 θ \cap ¢ Cd Te 27 5 围 回茶う 20 ა $\mathbf{\hat{n}}$ 酩 , A たね 成時間 た 焼成 10 θ た 採 λ. Cd S % Ð бV 汊 \subset $\vec{\gamma}$ みな 8-4 \sim を変 2 た 7 淅 5 酩 愚識 $\mathbf{C}\mathbf{d}$ ĸ 14 챀 γv Yé. ູກ ß \mathcal{S} 瀻 7. A % 伯 1 演 ድ ล Cd S θ Θ た Θ 7, ψ. 㳘 漎 æ æ 30厚/ \vdash 0 4 Θ 盟미 θ ก 1 が特に 衒 y O Cd C ℓ_2 「四層つ 茶 nin 谻 134 30 る。CdTe が悪 に膨い Isc Ø 9-た CdTe 第3 5 \sim \mathbf{x} 〗 \$ 2

(2) P 添加の効果

Ľ \$ gri ち Ÿ, **pp** 5 5 齑 5 р 1º , 0 Å 浽 m; \mathcal{S}^{*} Y 资 ¥ A \$ +2 Θ 題 革 歶 革 5 Ś 電極 ลิ 樹 θ 樹 掖 Ч 축 名祭 ลิ et the Ş. 斑 すら 죆 Ť ম $\widehat{}$ \mathcal{S} \$ Ч θ 坮 $\overline{}$ 5 -1- \dot{Q} 5 $\overline{}$ A Å æ ۶. . 裘 ş ลิ Э \$ ٢ 5 ম Cd Te H Ş, Ý X 争 $\overline{}$ J J. 国 ۲. 1 A \mathcal{S} \$ 讀 P\$ 転工 5 124 ť, 疧 搟 пþ 置度 75 бл 成 政 2 蔹 0 滾 栥 樹支 4 P%+ 弃 ล 2 \sim δ Æ 3 第成 \$ だ P\$t 工 程 5 倕 \$ J ∩\$ Ś 誈 $\overline{}$ 7 2 た 3 \mathbf{r} Cd Te 寅 ş A -Ŧ 14 1 Θ æ Ó, **体**の \mathfrak{r} 슷 覾 +Θ Θ $\overline{\Omega}$ 国 妜 夺 $\widehat{}$ đ 凝を回時に入れ 讹 সি 鑟 氲 \$ 形化 が可能 \mathcal{A} 5 θ 菮 착 \mathcal{S} ᇔ が氏 剤の Ş, Ľ, ¥ ۵þ e v 大学 (19) F ¢. 12 0 N Θ 3 \sim

-81-

er o

Y

斑

or,

淅

20

 \mathcal{S}

ź,

ξ

 \hat{S}

 (\mathbf{n})

θ

Ч

丧

3

松

1

ลิ

ズ

ł

V

2

12

3

限界は約 0.

. سىر

.

mol·%程度で、それ以上になると偏析が起ってあまり好ましくない。

ここでは Cd Te に添加する燐の量を広範囲に変えて実験するために、 燐の化合物の形で Cd Te の印刷と同時に添加する方法を試みた。燐の 5 価のもの、たとえば五酸化燐、燐酸、その他加熱した際に燐または酸 化燐以外の残渣を残さない化合物が考えられるが、五酸化燐は吸湿性 や酸性を示すので Cd Te と同時に印刷するのは、あまり好ましくないと 考え、中性の燐酸アンモニウムを使用した。

実験には、市販の燐酸アンモニウム (NH₃)₃ PO₄・2H₂Oを150 °C で 5時間以上脱水した無水の燐酸アンモニウムを Cd C ℓ_2 や Cd Te と一諸 に混合して印刷ベーストを調整する際に Cd Te に対して燐が 0.1 ~ 5 mol・%になる様に添加した。



図 1.44 P 添加量と焼成温度の関係

図1.44は燐の添加量をパラメーターとして Cd Te の焼成温度と素子 特性の関係を示したもので、燐の添加量が少ない場合ほとんど効果は 表われないが、1mol・%の場合700℃で、無添加のときに750℃で得られた特性とほとんど変らないものが得られ、また基板の反りもほとんど認められなかった。

(3) CdS への Ga 添加の効果

Cd Sの低抵抗化およびn性の増大をはかり、さらに特性の向上をは かるために、Cd S中にドナー不純物であるGaをGa Cl3の形でCd Sの 焼成と同時にドープする方法を検討したが、結果は図1.45 に示す様に Cd S 膜の抵抗はGaの添加量が増えるにしたがって低くなるが、特性は かえって悪くなった。これはCd Te の焼成過程でCd S中のGaがCd Te へ拡散してゆき、Cd Te の p 性をコンベンセイトするために起るもの と推測される。



図 1.45 Cd S中の Ga 量と特性の関係

-83-

ယ 4 試作 n・Cd S-p・Cd Te ۶ ΥI П 接合素子の特性

A/cnix、 た Isc ø. 0 Θ X 11 2 94 ب 11.2 50 mW/cn 太陽光相 46 は今回の試作検討で得られた代表的な素子の出力特性を示 た n 1 H mA∕cn∜t, 〕 1.5 方向電流 \cap the H.H 5 . P\$t ł * 胀 **i** 53.5 ム 11 \$ 4 $\mathbf{I}_{\mathbf{0}}$ % ۲ 1 exp Ý 1 ド特性も非常に優れた素子 メチ 変 $\left(\frac{e \, V}{n \ k \, T}\right)$ 換效率 ۲ VI $\widehat{}$ $(\eta) =$ ンプ照射下で Voc = 0.72 দ্বি 別 8.7% 4 Зv \cap , θ or. Io 2 θ H £₽ が得った σι ა imes 10⁻¹⁰ た。 V, $\overline{}$ た



図 1.46 n・CdS- p・CdTe ヘテロ接合素子の出力特性

1.3.5 大面積化の検討

4L ล 94 R VI 行 ろ , 资 お К F 茟 삡 . ₩, (γ) . Θ 1 衒 の検討結果 124 特許の向 P\$ \mathcal{J}^{n} Þ ~ . θ ล よく出 Cd S ずなる ¥ 1 1 . P\$4 \vdash ~ $\mathbf{p} \boldsymbol{\cdot} \mathbf{C} \mathbf{d} \, \mathbf{T} \mathbf{e}$ の安良 後討 P\$ も問題が æ はか \cap -₽-ก 送 }, 2 . ა 4 B+ Q4 \mathbb{X} Ч ۶-4 は十分 Ś び 大 Ś 面積素 ა Ч まから。 が現在の 回 Cd Te の 網 成 が 均 一 に 行 わた な い た め おな 積基 4 PX+ 渐 の 衒 踋 \cap क्ति ñ (\mathbf{v}) æ 運 ろ甕成炉 4 θ $\overline{}$ бV や谷 た た焼成条件の再検討 F られていない。 5 の容量が小さ . 🆌 4 Cm 甶 θ \sim Ŗ

-84-

1.3.6 結果のまとめ

スクリーン印刷—焼成方式による Cd S-Cd Te 系太陽電池の製造工程を さらに改善するために、Cu₂Te 形成工程を省略した n・Cd S-p・Cd Te ヘテ ロ接合形において Cd Te 焼結膜の p 形化焼成条件や燐添加の検討などを行 い、小面積基板(受光面積 1 cm)の素子で変換効率 8.7%のものが得られ る様になった。しかし、この方式で大面積基板を用いた場合はまだ十分 なものが得られていないので、さらに小面積基板と大面積基板との製造 条件の違いや原因を明確にして特性の向上をはかってゆく予定である。 この連続析出装置を使用した場合、前者の濃度の低い溶液を使用した 方が良質の膜が得られた。

後者の濃度の高い反応溶液を使用すると膜厚が厚くなるにしたがって 超音波洗浄でも簡単に取れにくい粒径の大きい沈澱が付着し、透明度 が悪くなるばかりか、後の素子製造工程で Cd Te にピンホールができ、不 良を出す原因にもなった。

表1.12は、今回検討して得られた原液秤量系の原液容器に充填する 各溶液の濃度、自動ビューレットで秤量する溶液の量および混合溶液 中の濃度である。

反応溶液の組成	濃	度	自動秤量	量液量	混合液	の濃度
$\operatorname{Cd}\operatorname{C}\!\ell_2$	0.18M	1	147	ml	0.042	2 M
NH4 OH	5.3 N	1(10%)	159	ml	1. 3	Μ
NH₄Cℓ	0.5 N	1	165	ml	0.13	М
$(\mathrm{NH}_2)_2\mathrm{CS}$	1.7 N	ſ	156	ml	0.42	М

表1.12 連続析出装置による Cd S 析出膜の析出溶液組成

a. 連続析出法で析出させた結果

前述の操作方法で表 1.12 に示した反応溶液を析出容器に入れ、恒 温槽を 150℃に設定して析出反応を開始してから 30 分後に新たに混 合攪拌した溶液を 22 ml/maの速度で注入、排出を行い析出反応を続 けた結果、図 1.51 に示すような反応液量と Cd S 析出膜厚の関係が得 られた。 Cd S 析出膜の膜厚は、約 1.5 μm 附近まで反応液添加量に低 ぼ比例して増大してゆくが、それ以上では膜厚の増大があまりみら れず、かえって極部的に Cd S の沈澱粒子が付着して粗雑な透明度の 悪い膜となった。これは、溶液の注入速度や基板の回転速度を変え ても、ほとんど変らなかった。この連絡析出法で太陽電池用として 十分使用できる良質な膜の膜厚の限界は 1.5 μm 程度でそれ以上の膜 厚で良質の膜を得ることは困難であった。



図 1.51 連続法における析出時間、析出溶液量と膜厚の関係

b. 繰り返しバッチ法で析出させた結果

図1.52は、くり返しバッチ方式で析出させた時の反応溶液量と CdS析出膜厚との関係を示したもので、2回析出させた後に超音波 洗浄を行ったものであり、4回くり返すことによって約2μmの良質 な膜が得られた。

このように試作した連続装置を連続析出法で使用する場合は、操



図1.52 繰り返し法における析出回数と膜厚の関係

作も簡単で作業が行いやすく、1.5 μm以下の良質の膜をうるには適して いるが、後で述べる特性の優れた太陽電池素子を作るために必要な Cd S 膜の膜厚は2 μm程度が要求され、この方法では良質な Cd S膜を得ること ができなかった。一方繰返しバッチ方式では2 μm程度の膜を得るために は、途中に一度洗浄工程が入るが、このような装置で行うと作業も比較的 簡単となり、また反応溶液の使用量や析出時間も連続法と余り変らないこ と、および良質の膜が確実に得られる点で非常に有利であることがわかった。

(4) 膜の性質

図1.53 a)は、本装置を用いてくり返しバッチ法で2回析出させて得た約1,4mのCdS膜の表面の電子顕微鏡写真(レプリカ法)である。b)は従来の小型バッチ方式で2回析出した膜の同じく表面写真である。表面状態の比較では、従来の膜の方が比較的緻密で結晶粒形がわずかに小さく全体になめらかである。

X線回折による結晶性の比較では、 eubic と hex. との混晶の割合および配向性に関してほとんど差異は認められなかった。比抵抗も1×10⁴Ω cm 程度でほとんど変らなかった。

真空蒸着法でCdTe層を形成した薄膜太陽電池の開発で、主にCdTe層の形成条件について検討した。その結果、CdTe層の膜厚および蒸着基板温度が素子特性に大きな影響を与えることがわかり、η = 3.6%の素子を得た。

本年度はこの素子の特性改善をはかるため接合構造の解析を行うと ともに、素子の直列抵抗を減少させるため、 Cd Te 層 およびコンタクト の低抵抗化に取り組み、 70 mW/cnt 太陽光下で Voc = 0.75 V、Isc = 14.0 mA/cnt、 F. F. = 58.0%、 η = 8.7%の素子を得た。また、素子の大面積 化にも取り組み、 5 cm × 5 cm ガラス基板上に試作した太陽電池につい ても報告する。

(2) 基板温度480℃で作成した素子の特性

a. CdS析出膜の性質

CdS析出膜の形成は、49年度、50年度成果報告書で報告した方法により行った。このCdS析出膜は約0.3 μmの微細な結晶粒よりなり、配向性のある cubiec と hexagonalの混晶の膜である。
図1.55 にこの膜のX線回折パターンを示す。



図 1.55 Cd S 析出膜の X線回折パターン

-94-

南 3 この膜の横方向の比抵抗(Pu)は、 2 Ķ メ雰囲気あるいは真空中にて熱処理す n\$⊧ 3 0 $10^4\Omega-$ cm 程度であ 5 と比抵抗を Ś di. 04 \sim Ĵ, Ľ, èν R^t 不足 \sim \sim

 \subset た趨 × هستر م 56に各温度 合の比抵抗変化 2 Ar 雰 囲 P\$ 쉐 -洳 Q ∄ 20分 8∱ 9-τ Ç. 資 究 -Ð 10 分間熱処理



図1.56 CdS 漠の熱処理による抵抗変化

芃 ガ 3 熱処理温度300℃ 3 4 格 さ c íç ている。 ~ 500℃ また、 で 10 汐 この熱処理に ~ 20分熟処理し ᠀᠇ 6 た CdS腹は、 願は、 比街

hexagonal の配向性 R ۶7 り強 \sim 개 ᢞ᠇ うになる。

羐 F. 熱処理後の Cd S 析出膜の ホ 13亿示す。 ル係数の測定を行 J た。 その結果を

表 1.13
熱処理後の
D Cd S 析
「出膜の電
気的特性

Ar 雰囲気中 480℃20分	真空中(2×10 ⁻⁶ Torr)480°C 10分	<u>熟</u> 20. 强 余 作
r	n	伝導形
3 3	01 00	比 抵 抗 pn(い、cm)
7.6	3. G	移 動 度 ルH (c航/V・sec)
$4.5 imes10^{16}$	$3.5 imes10^{16}$	キャリャ濃度 n (cm ⁻³)・

-95-

諭 5 斑 痰 Cd S Θ ジ 嘢 -阑 加 бV 9 Θ N Ŧ た 禸 \sim Ð -7 ず $\widehat{}$ 爕 変 淅 冱 3 围 20 F 9 1 \mathfrak{r} ť, 冟 凝 阙 3 泡 0 H 盄 坣 ล 2 9-9-5 ēν \mathcal{O} ~ 漢 }; ۶ 廚 \mathcal{C}_{i} * 認 る Cd 25 Od 97 ζΩ J 羐 3 弦 国 4 ۍ√

驚吸皮 du Ŕ ล Θ 墅 澔 1 津 耒 44 Æ P\$ N 闌 3 X 洝 Θ نيمو م 57 × 阅 θ ก ¥ 肉 읫 2 \mathcal{C}^{t} -좌 副 0 λ. (Qd A Ś S 函 * *谟の 膜 厚の* 増 闵 Ð 量が増加 ลิ \mathcal{P} * 至 $\overline{}$ 歐 加 揪 A 3 Θ \sim \subset 3 邂 た 0 闭 Ŷ P\$ ა 亡 ή ა た。 至



 \mathbb{X} <u>.</u>.... CT. -1 Cd S 膜 θ 矽 ¥ 透 副 揪

961-た 1 摤 囵 圅 ล ۶-ر 5 Cd S 凝 θ X 浽 之 盧 2 Θ 弦 歐 揪 Å. Ś 仱 增加 $\overline{}$ 75

Ś Θ ų, Ċ $\dot{\Omega}$ Sr 0

,or Cd Te 痰 账 搟 疲 鎆 寮 θ 衒

쾃

쾃 \cap R. EE 当 山 舟 Ч 5 称 夏 唜 Cd Te 査 Ĥ Å 羖 Ð 痰 鷝 \mathbf{H} 齇 Jel. 133 茟 Ã 3 卥 Å θ 齸 Å ა 浭 Ċ た θ ο Ą 藢 ა 쾟 た R 0 山 3 5 . . ⋪ 舟 澕 寮 菠 圙 or. <u>1</u> 翔 nd: R 慾 \vdash 坳 nt ()14 Q 倖 祾 25

R Cd Te X 蒸 槧 3-----A 义 CT 斑 ∞ AY. 衒 ลิ) - - - 圙 싓! $m \eta$ 承 ł $\hat{\Omega}$ EF ₽ μm Ч 掭 θ 袹 讏 กิ 14 山 ล 浙 20 Ś 闵 꽷 $\overline{}$ 囄 た R 菡 怸 □⊳ لسبو ñ μm V 一 5 θ A 調べた結果 $\mathbf{C}\mathbf{d}$ S 膜上 ลิ

99 ł

0



図 1.58 蒸着基板温度と出力特性

蒸着基板温度560℃の Cd Te 膜も作成したが、 500℃以上の温度 では、膜厚のコントロールが難しく、うまくいかなかったので、480 ℃までの結果を示してある。これより明らかなように、基板温度の 上昇にしたがって Voc, Ise とも増加する。

これは、接合形成時の熱処理による CdS 膜の低抵抗化と蒸着温度 上昇による CdTe 層の低抵抗化によるものと考えられる。

表1.14 に基板温度を変えて作成した Cd Te 膜の横方向の (*ρ*₁₁) 比 抵抗を示す。480℃作成した Cd Te 膜は300℃~400℃ で作成した 膜に比べ、光照射下で2桁ほど大きな光電流を発生させることがで きる。

この現象は、次の2つの効果によるものと考えられる。

1. 蒸着基板温度上昇により Cd Te 膜の stoichiometry よりのずれが

 蒸着基板温度
 暗比抵抗
 明比抵抗

 300℃
 10⁶~10⁷Ω·cm
 10⁵~10⁶Ω·cm

 400℃
 "
 "

 480℃
 "
 10³~10⁴Ω·cm

表 1.14 Cd Te 層の形成温度と横方向 (P11) 比抵抗

明比抵抗… 50 mW/cnt太陽光相当タングステン光照射下で測定

増大し、Cd vacancy (Ea = 0.15 eV)が増加するため。

ii. 300 ℃ ~ 400 ℃ の 基 板 温 度 で 作 成 し た Cd Te 膜 の 結 晶 粒 径 は 約
 0.5 μm で あ る が、480 ℃ で 作 成 し た 膜 は 約 2 μm と 成 長 し て お り
 (前 年 度 報 告)、移動 度 (μp) や ラ イ フ タ イ ム (て p) が 増 大 す る た め。

以上のことにより、蒸着基板温度を上昇させると Cd Te 膜の μT積が増大し、光電流の増加が生じ、 Voe, Ise を増大させることができる。

基 板 温 度 4 3 0 ℃ で Cd S 膜 上 に 蒸 着 し た Cd Te 膜 の X 線 回 折 パター ンを 図 1.59 に 示 す。

この Cd Te 膜は(111) 面に強い配向性を示す cubic (Zinc blende) の Cd Te よりなっている。



図 1.59 Cd S 膜上に蒸着した Cd Te 膜の X 線回折パターン

とのようにして作成した素子の各層での分光透過率を調べたのが 図 1.60 である。

ガラス基板を透過した光が一部 Cd S層で吸収され、 Cd S層を透過 した光の一部が Cd Te 層で吸収され、これが光電効果を生みだす。 図1.60の測定は、試料を光検知器との間に空間がある場合のもので 試料面での散乱光が検知されず、実際の素子では各層の透過率はこ れよりも大きい。

この素子で光起電力特性をだすために利用される光は、500 nm ~820 nm の波長範囲である。



の各層での分光透過率

c. 太陽電池の特性(A素子)

蒸着基板温度と出力特性との検討で明らかなように、基板温度を 上げると出力特性が向上するので、我々は基板温度480℃で素子 (A素子)を作成し、その特性を調べた。 図1.61にその素子の構造 図1.62にエポキシ系樹脂でモールドした場合の外観写真を示す。



図1.61 素子の構造

74 mW/cnt (AM 1.2) 太陽光下で Voc = 0.59 V、Isc = 19.0 mA (15.8 mA/ cnt)、F.F. = 42.0%、 $\eta = 5.3$ % であり、 50 mW/cnt (AM 2.6) 太陽光下 で Voc = 0.57 V、Isc = 14.4 mA (12.0 mA/cnt)、F.F. = 43.9%、 $\eta = 6.0\%$ である。

この素子の直列抵抗は $Rs \simeq 15\Omega$ ・cmで、これが変換効率を規制しており、光エネルギー量による F.F.の変化に影響している。

この素子の分光感度特性を図 1.64 に示す。 Cd S の基礎吸収端 520 nm から Cd Te 基礎吸収端附近 820 nm の範囲でほぼフラットな感度を 有しており、接合界面準位の影響が少なく、ヘテロ接合の窓効果の 影響をよく表わしている。



図 1.64 分光感 度 特 性

次にこの素子の dark 時のダイオード特性を図1.65 に示す。素子の順方向電流が

$$\mathbf{I} = \mathbf{I}_{\mathbf{0}} \left\{ \exp \left(\frac{\mathbf{e} \mathbf{V}}{\mathbf{n} \mathbf{k} \mathbf{T}} \right) - 1 \right\} - \dots (1)$$



図1.65 I - V 特性

の式にしたがって変化すると仮定して、室温(25℃)での この素子の n およ Ioを求めると、次のようになった。

n = 2.30 Io = 1.2×10^{-7} A/cm²

また我々が作成した素子では、 $n = 1.7 \sim 2.3$ であり、 このことより順方向電流は主に空乏層内での Generation-Recombination current により支配されているのがわかる。

d. 接合構造の考察

蒸着基板温度 480 °C で作成した素子の接合構造を調べるため Cd S = 2 μm 、 Cd Te $\simeq 6.5 \mu m$ と厚くした素子について容量 — 電圧特性の 測定を行った。得られた静電容量 (C)の $1/O^2$ を縦軸に、印加電圧(∇) を横軸にプロットした結果を図 1.66 に示す。

 V_{C2} とVとの関係はほぼ直線で近似でき、この素子のp-n接合 は階段形接合 (abrupt junction) であることがわかる。

-103-

$$\mathbf{V}_{A2} = \frac{2 \varepsilon_1 \, \mathbf{V}_{D1}}{\mathbf{q} \mathbf{V}_{D1} \, \varepsilon_1 \, \varepsilon_2 \, \frac{d \nabla_8}{\mathbf{d}} - 2 \, \varepsilon_2} - \frac{2 \varepsilon_2}{\mathbf{d}}$$

 $= O \[f] = A \[0 \] = \frac{d V_{a}}{d C^2} = \frac{Q \[V_{D1} \[V_{a1} \[\varepsilon_1 \[\varepsilon_2 \] N_{a2} \]}{Q \[\varepsilon_1 \[\varepsilon_1 \] S \[\varepsilon_1 \[\varepsilon_2 \]}} \] \\ = \frac{d V_{a1} \[\varepsilon_1 \[\varepsilon_2 \] S \[\varepsilon_1 \]}{S \[\varepsilon_1 \[\varepsilon_1 \] S \[\varepsilon_1 \]}} \]$

° 2 4 7 AO 8'0 = PA

5 & & な き 並 雷 靖 並 (1 点 交 の 5 罅 對、 J 軒 代 き 縣 直 (1 39.1 図



(1.5.4.5.4.表で次対決論距の封執V-Dの合發ロモー研写制

$\overline{A} \oplus A - O 99.1 \overline{A}$





-101-

で表わせる。今、 N_{D1} ≫ N_{A2} であるので $\frac{dC^{-2}}{dV_a} = \frac{2}{q N_{A2} \epsilon_2}$ となり、 Cd Te の比誘電率 $\epsilon_{S2} = 11.0$ N_{D1} = 3.5×10^{16} cm⁻³ (表 1.13 の Hall係 数の測定データより)、直線の傾き $\alpha = 2.5 \times 10^{16}$ F⁻² V⁻¹ より N_{A2} を 求めると、

 $N_{A2} = 5.1 \times 10^{14} cm^{-3} c c c$

上述のキャリア濃度の計算結果より、空乏層のほとんどは Cd Te 層内に拡がっているのがわかる。各層での空乏層の幅は次式で表わ せる。

$$\begin{aligned} (\mathbf{X}_{2} - \mathbf{X}_{0}) &= \left(\begin{array}{c} \frac{2 \, \mathbf{N}_{D1} \, \boldsymbol{\varepsilon}_{1} \, \boldsymbol{\varepsilon}_{2} \, (\mathbf{Vd} - \mathbf{Va})}{q \, \mathbf{N}_{A2} \, (\boldsymbol{\varepsilon}_{1} \, \mathbf{N}_{D1} + \boldsymbol{\varepsilon}_{2} \, \mathbf{N}_{A2})} \right)^{\frac{1}{2}} \dots \qquad (4) \\ (\mathbf{X}_{0} - \mathbf{X}_{1}) &= \left(\begin{array}{c} \frac{2 \, \mathbf{N}_{A2} \, \boldsymbol{\varepsilon}_{1} \, \boldsymbol{\varepsilon}_{2} \, (\mathbf{Vd} - \mathbf{Va})}{q \, \mathbf{N}_{D1} \, (\boldsymbol{\varepsilon}_{1} \, \mathbf{N}_{D1} + \boldsymbol{\varepsilon}_{2} \, \mathbf{N}_{A2})} \right)^{\frac{1}{2}} \dots \qquad (5) \\ (\mathbf{U} \quad \mathbf{X}_{2} - \mathbf{X}_{0} \quad \mathrm{Cd} \, \mathrm{Te} \, (\mathbf{H} \, \mathcal{CO} \, \mathfrak{LZ} \, \mathbf{B} \, \mathbf{h}) \\ \mathbf{X}_{0} - \mathbf{X}_{1} \quad \mathrm{Cd} \, \mathbf{S} \qquad " \end{aligned}$$

 $N_{D1} \ge N_{A2}$ として $X_2 - X_0 = 1.37 \mu m$ 、 $X_0 - X_1 = 0.02 \mu m$ となり、空 乏層はCdTe 側に約1.4 μm 拡がっているのがわかる。

以上の結果よりCdSとCdTeのフェルミ準位を計算すると0.11eV と0.23eVとなる。この計算に用いたCdSの電子の有効資量*mn/mo*およ びCdTeの正孔の有効質量*mp/mo*はそれぞれ0.21と0.30とした。 これらとCdSとCdTeのエネルギーギャップ2.42eV、1.44eVより実験 的に得られたCdS-CdTeヘテロ接合のバンド構造を図1.67に示す。



図1.67 CdS-CdTe ヘテロ接合のバンド構造

-105-

これからわかる様に伝導帯での不連続 dEc = 0.30 eV であり、 Cd S と Cd Te の電子親和力をそれぞれ 4.5 eV と 4.28 eV とすれば¹⁾、これらの差より dEc = 0.22 eV となり、実験で得られた値とほぼ一致する。

このバンド構造では、エネルギースパイクが正の値であるため、 Cd Te 側から Cd S 側へ電子は阻止されることなく流れ、 高効率の太 陽電池が得られる可能性が大きい。これは n-Cd S/p-InP^{2,3)} n-Zn 0.35 Cd 0.65 S/p-Cd Te⁴⁾ などと同様のエネルギーバンド 構造 であ る。

(3) 素子特性の改善

上述の解析を行った素子では、 $Io \sim 10^{-7}$ A/cm 、 $Rs \simeq 15 \Omega$ ·cm と大きいことが、開放端電圧および曲線率を制限している。この素子の変換効率の向上を図るため、直列抵抗、短絡電流の改善を試みた。

a. Cd Te 層の低抵抗化

我々の構造の太陽電池の直列抵抗は、 In2O3 透明電極を含む Cd S 層の広がり抵抗、 Cd Te 層 (ベース)の抵抗および オーミックコンタ クトの抵抗より成っている。表面層の広がり抵抗は主に In2O3 膜の 抵抗分であり、約3Ωである。したがって直列抵抗の大部分は、 Cd Te 層 および電極部によるものであり、 この部分の低抵抗化に取 りくんだ。

イ. 二 蒸発 源 同 時 蒸 着 法 に よ る 不 純 物 の 添 加

Sb、Cu などのアクセプター不純物をチャージした蒸発源と、 Cd Te 粉末をチャージした蒸発源とを同時に加熱し、Cd Te 層への 不純物の添加を試みた。不純物の蒸発量を多くすることにより、 Cd Te 層の比抵抗を $10^{-3} \sim 10^{-4} \Omega \cdot cm$ と下げることができたが、 こ の 膜とで接合を形成した太陽電池では、現在までのところ良好な 特性のものは得られていない。

n. ホットウォール形蒸着装置による不純物の 係加

蒸着基板温度400℃~480℃、ウォール温度450℃~530℃とし、

(j) 不純物の添加していない Cd Te 粉末

(ii) 0.1モル%、 P 添加 Cd Te 粉末

(iii) 1モル%、P添加CdTe粉末

などを蒸発させ、Cd Te 層の低抵抗化を試みたが、Cd Te 膜へのP 添加の効果は認められなかった。

ハ、不純物金属のCdTe表面よりの拡散

接合を形成した Cd Te 層の表面に Te. Au. Cu. Sb. Bi. Ag など の金属を蒸着し熱処理によるこれら金属の Cd Te 層への拡散を試 みたが、現在までのところ次に示す Cu_{2-x} Te の拡散により得られ た素子の特性には及ばない。 Cu_{2-x} Te 層の形成は、 Cu₂ Te 粉末の 蒸着および Cd Te 膜を Cu⁺を含む水溶液へ浸漬することにより行っ た。以下にそれぞれの場合について報告する。

b. 蒸着法により Oug Te 層を形成した素子の特性(B素子)

Cd Te 層へのアクセプター不純物の添加の方法として、Cd Te 層の 表面に Cu_{2-x} Te 層を蒸着で形成し、熱拡散を行うことにより、Cd Te 層の低抵抗化の検討を試み、この方法で作成した素子は良好な変換 効率を示すことがわかったので、以下に報告する。

1~2 μ mの厚のCdS析出膜に基板温度430°C~460°Cの温度範囲 で、約0.2~0.7 μ m/mmの蒸着速度でCdTe層を3~7 μ m蒸着する。 その表面に室温でCu_{2-x}Te層を0.2~0.4 μ m厚蒸着し、不活性ガス雰 囲気中で250°C、20分~30分熱処理することにより不純物を拡散 し、CdTe表面にP⁺Cu₂Te層を形成した後、金属電極をつけて素子 を作成した(Cu_{2-x}Te層のみでも十分電極として働く)。また、基板 温度を低くしたのは、OdTe層を厚くすることにより光吸収量の増 大をはかることと、接合界面での欠陥を減し、Ioの減少をはかるた めである。 次に2µm厚の CdS膜の上に基板温度430℃で20分かけ、 CdTe 層を 6.5µm形成し、その上に 0.2µm厚の Cu_{2-x}Te と Au を蒸着し、 250℃ Ar 雰囲気中で20分熱処理をした素子(B素子)の太陽光に よる出力特性を図 1.68に示す。



図 1.68 B素子の出力特性

70 mW/cn (AM1.5)の太陽光下で Voc = 0.75 V、Isc = 14.0 mA/cn、 F.F. = 58.0%、7 = 8.7%の素子面積 1 cn の素子を得た。 この値は n・Cd S/p・Cd Te ヘテロ接合で、 これまでに報告されている D.Bonnet⁵、 A.L. Fahrenbruch⁴⁾の7 = 4 ~ 6%よりも大きく、良好な接合が得ら れていることを示す。

この素子のdark時のI - V特性を図1.69に示す。これよりIo, nを求めると $Io = 1.3 \times 10^{-9}$ A/cf 、n = 1.7となる。また、バイアス1Vでの順方向、逆方向電流の比を求めると 10^6 倍あり、良好な接合が形式されていることがわかる。

次に代表的な素子の出力特性の温度変化を調べたのが図1.70である。この測定光は50mW/cniの太陽光に相当するタングステンランプ

-108-



図1.69 B素子の I - V 特性



図1.70 代表的なB素子の温度特性

光を照射することにより行った。

温度上昇につれ、 lsc が増大するが、これは Cd Te の禁止帯の幅が 温度上昇により、小さくなり長波長の光まで吸収するようになるため であり、 Vocは 0.23 ~ 0.26 mV/℃の割合で温度が上がると、減少する が、これは接合のリーク電流が増えることによるものと考えられる。 また開放端電圧が 0 になる温度を外挿すると約 300℃であり、 Si の約 180℃より大きく、高温での使用にも適している。

c. 浸漬法により Cu₂ Te 層を形成した素子の特性

浸漬法でn型CdTe 膜表面に、Cu2-xTe を形成して得られる薄膜形 CdTe ヘテロ接合太陽電池については、すでにD.A. Cusano⁶⁾ やE.W Justi⁷⁾らによって報告されているが、変換効率は5%程度と低く、 まだ十分なものが得られていない。

我々は現在検討中の n→CdS 析出 膜 — p・Cd Te 蒸着膜からなる薄膜形へテロ接合素子の Cd Te 層の低抵抗化をはかって、変換効率を向上させるために、浸漬法を検討した。

まず 2 cm 角の In₂O₃ 透明電導膜を被着したガラス基板に連続析出 装置で約 2 μ m の Cd S 析出膜を析出させた後、この Cd S 基板を 430 ℃に加熱しながら、 1.2×1.2 cm の 面積で厚み約 8 μ m の Cd Te を蒸着 した。ついで Cd Te 膜の表面のみに Cu_{2-x} Te 層が形成される様に、 Cd Te 膜の周辺と Cd S 膜の面をタール系のワックスで保護して 80 ℃に加熱した Cu⁺を含む水溶液に浸漬して Cd Te 膜の表面 1 cm の面 積に Cu_{2-x} Te 層を形成した。 浸漬に用いた Cu⁺を含む 水溶液の組成 および濃度は 0.12 N の HCl 100 ml に塩酸ヒドラジン (HCl・NH₂・ NH₂ HCl) 0.1 g と塩化第一銅 (Cu Cl) 0.1 g を加えたもので pH=3 の酸性溶液である。

図 1.71 は浸漬時間を一定(8 sec)にして、 Cu_{2-x} Te を形成した後 の熱処理温度と、 Voc、 Isc との関係をしらべたもので、特性の改善 を得るためには、200℃以上の熱処理が必要で、250℃から280℃ 附近が最適であった。図 1.72 は、浸漬後の熱処理温度を一定(250 ℃)にして、浸漬時間を変えた場合の Voc と Isc の関係を示したもの で、浸漬時間は 8~15 秒程度が適当であることがわかった。

-110-



図1.71 熱処理温度とVoc、Iscの関係



図 1.72 浸漬時間と Voc、 Isc の関係

Cd Te 膜上に形成した Cu2-x Te の挙動をしらべるために、X線回折、 電子線回折および表面状態の観察を行った結果、熱処理しない膜は Cu2-x Te 層が薄いため X線回折のパターンは得られず、電子線回折 写真でのみ Cu2-x Te の回折パターンが認められた。また 200℃で熱 処理すると、電子線回折写真でも Cu2-x Te の存在は認められず、浸 これらの試験結果から、浸漬法でCdTe 膜面に形成したCu_{2-x}Teの 膜厚は数100Å以下の非常に薄いものであり、熱処理によってCu⁺ がCdTe 中に拡散してゆき、CdTe 膜中でアクセプター不純物として ふるまい、低抵抗化に寄与しているものと考えられる。

これらの実験結果をもとに、再現性ある条件で試作した1 cf の受 光面を有する素子の特性は、50 mW/cf 太陽光相当の タングステンラ ンプ照射下で、 Voc = 0.71 V、 Ise = 10.5 mA/cf 、 F. F. = 55.6 %、変換 効率 (7) = 8%であった。図 1.74 は、その出力特性、図 1.75 は、ダ イオード特性を示す。また順方向電流を I = Io exp $\left(\frac{eV}{nkT}\right)$ で仮定す ると Io = 7 × 10⁻¹⁰ A/cf 、 n = 1.4 となり、ダイオード特性も非常に 優れていることがわかった。



図 1.74 出力特性



図1.75 I - V 特性

d. 考

察

Cd Te 層の表面に蒸着あるいは、浸漬法で Cu_{2-x} Te 層を形成し、熱処理をした薄膜太陽電池で変換効率の向上をはかることができたので、この特性改善の原因を考察するため蒸着で Cu_{2-x} Te 層を形成した素子について太陽電池としての特性の評価を行う。

表 1.15 A素子、B素子の出力特性

	V _{oc} (V)	Isc (mA∕cn ²)	F.F.	η (%)	I _O (A/cm ²)	n	測定太陽光
A素子	0.59	15.8	0.42	5. 3	1.2×10 ⁻⁷	2. 3	74 mw/cm²
B 素子	0.75	14.0	0. 5 8	8.7	1.3 × 10 ⁻⁹	1.7	70 mw∕cnੈ

太陽電池の等価回路⁸⁾として図1.76を用いると、I-V特性は次の式で表わせる。

$$I = I_0 \left\{ exp\left(\frac{q(V-IRs)}{n k T}\right) - 1 \right\} + \frac{V-IRs}{Rsh} - IL - \dots - (6)$$



図1.76 太陽電池の等価回路

1. Rs、Rsh、Rdの評価

直列抵抗 (Rs)を見積るためにダイオードの順方向特性の高電流 領域での IF = Ioexp $\left(\frac{qV_F}{nkT}\right)$ よりのずれを用いて求めると、次のように なった。

	RLS	RDS
A 素 子	14Ω.cn ²	39Ω·cnੈ
B 素 子	10Ω°cnt	$1 4 \Omega_r \cdot cm^2$

RLs:表1.15 に示した光照射条件下

RDS : dark時

直列抵抗が暗時と光照射時で変化するのは、光吸収のほとんどが 起る Cd Te 層の比抵抗が高く、 photoconductive であるためと考えられ る。このことが光照射時 free carrier が増え、接合の障壁が下がり、 Ioが多少増大することおよび暗時と光照射時のV-I 曲線が交叉す ることの原因となっていると考えられる。

シャント抵抗(Rsh)を見積るため、ダイオードの逆方向特性のオーミック領域より求めると次のようになった。

次に等価ダイオードのダイナミックインピーダンス (Rd)⁹⁾を求めた。短絡条件下では、

$$Rd = \frac{dV_F}{dI_F} |_{V_F = 0} = \frac{nkT}{q I_0} で表わされる。$$

-115-

表 1.15のA素子、B素子の Io,nを用いて Rd を計算すると次のようになる。

以上のようにB素子では、Rs が減少し、Rsh が増大しているのがわ かる。

ロ. 短絡電流と光生成電流

(6) 式で短絡条件での電流関係式を求めると、

$$I_{L} = \frac{Rd Rs + Rs Rsh + RshRd}{Rd Rsh} I_{sc} -----(7)$$

となる。これに前述の各抵抗分を代入すると、A素子、B素子とも IL = 1.00₀ Isc

となり、測定された短絡電流は光生成電流に等しいことがわかる。 ハ 開放端電圧

Voc≫nkT/q であるので(6)式を用い Vocを求めると、

と表わせる。

Voc/Rsh と IL ≃ Isc との比較を前述の数値を用いて行うと、Voc/ Rsh ≪ IL となり(8)式の第 2 項は無視できるので太陽電池の Voc は (8) 式のカッコ内の第 1 項に依存している。

B素子の IoはA素子よりも2桁小さく、これが開放端電圧の増大 をもたらしている。接合を流れる電流は空乏層内での発生―再結合 電流により主に支配されているので、飽和電流は次式¹⁰⁾で表わせる。

$$I_{0} = \frac{e n_{i} W}{2 \tau_{0}} - \dots - (9)$$

$$\begin{pmatrix} n_{i} : 真性 + + \eta T 数 \\ W : 空乏層の巾 \\ \tau_{0} : 少数 + + \eta T の寿命 \end{pmatrix}$$

-116-
零バイアス時のA素子、B素子の空乏層の幅は、それぞれ1.4 μm 2.4 μmであり、Ioの減少は、小数キャリアの寿命が増大したこと によるものと考えられる。その原因として Cd Te 層の形成温度を低 くしたことによる接合界面での欠陥の減少および蒸着速度を変え たことによる結晶性の改善などが考えられるが、定性的な議論の 域をでない。

また、 p・Cd Te − p⁺・Cu_{2-x} Te 層での光起電圧 0.02~0.03Vの寄与 も Voc 増大の一端を担っている。

太陽電池の出力特性の曲線因子は定性的には $\frac{dI}{dV}\Big|_{I=0}$ が大きいほど、また $\frac{dI}{dV}\Big|_{V=0}$ が小さいほど大きいといえる。

(6) 式より 開放 端条件では、

$\frac{\mathrm{d}\mathbf{I}}{\mathrm{d}\mathbf{V}}$	$-\Big _{I=0} = \frac{1}{Rs+1}$	A-1		 (10)
A	$=\frac{\mathbf{I}_{0}\mathbf{q}}{\mathbf{n}\mathbf{k}\mathbf{T}}$ exp	$\frac{q Voc}{n kT} +$	$\frac{1}{Rsh}$	 (11)

となる。

A素子、B素子について叫式の右辺第1項を計算すると、

 $\left(\begin{array}{ccc} A 秦子 & 4.41 \times 10^{-2} \ \Omega^{-1} \cdot cm^{-2} \\ B 素子 & 8.57 \times 10^{-1} \ \Omega^{-1} \cdot cm^{-2} \\ \end{array} \right)$ となる。

 $1/R_{sh}$ に比べこれらは大きく、Aは右辺第1項に依存する。そこ でA素子、B素子の1/Aを求めると、それぞれ 22.7 Ω ・cnt、1.2 Ω ・cntとなる。

 $\frac{dI}{dV}\Big|_{I=0}$ は、A素子ではダイオードのn、Io、Rs に、B素子では Rs に依存することになる。

一方、短絡条件では、

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{I}}{\mathrm{d}\mathbf{V}}\Big|_{\mathbf{V}=\mathbf{0}} = \frac{1}{\mathrm{R}s + \mathrm{B}^{-1}}$$
(12)

$$B = \frac{I_0 q}{n kT} \exp \left(-\frac{q I_{sc} Rs}{n kT}\right) + \frac{1}{Rsh} - \dots$$
 (13)

-117-

が得られる。

い 式の右辺第1項は10⁻⁸~10⁻⁹ $\Omega^{-1} \cdot cm^{-2}$ で 1_{Nsh} より小さく、また Rsh ≫ Rs であるので、い 式は $\frac{dI}{dV}\Big|_{V=0} \simeq \frac{1}{Rsh}$ となり、A・B素子とも Rsh にのみ依存する。

したがって $\frac{d\mathbf{I}}{d\mathbf{V}}\Big|_{\mathbf{I}=0}$ 、 $\frac{d\mathbf{I}}{d\mathbf{V}}\Big|_{\mathbf{V}=0}$ をA素子、B素子について求める

	$\left \frac{\mathrm{d}\mathbf{I}}{\mathrm{d}\mathbf{V}} \right _{\mathbf{I}=0} \left(\Omega^{-1} \cdot cm^{-2} \right)$	$\frac{\mathrm{d}\mathbf{I}}{\mathrm{d}\mathbf{V}}\Big _{\mathbf{V}=0} \left(\Omega^{-1} \cdot cm^{-2}\right)$	F. F. (%)
A素子	2. 7 × 10 ⁻²	5. 0×10^{-6}	42.0
B素子	9. 1×10^{-2}	$2.5 imes 10^{-8}$	58.0

となる。

以上の結果よりB素子のF.F.の改善は、Rsの減少およびRsh の増大によるものである。Rsの減少は、CdS表面層の膜厚の増加、 CdTe層へのCu⁺の拡散およびCdTe表面P⁺層の形成によるもので あり、Rshの増大は、接合界面での欠陥の減少によるものと考え られる。

ホ. 収集効率

太陽電池より取り出す光電流を増加させるためには、収集効率を増加させる必要がある。

A素子、B素子についてHe-Ne レーザーを用い633 nm での収 集効率の測定を行った結果、A素子81.7%、B素子79.3%であっ た。これと分光感度特性とよりA、B素子の収集効率のスペクト ル分布を計算した結果が図1.77である。

A素子は短波長側での収集効率が大きく、B素子は長波長側で やや増大している。これはA素子ではCdS層が1.3 μmとB素子に 比べ薄いため、CdTe層への光透過量が増大することと、CdTe 層も1.5 μmと薄いため接合より離れたところで発生したキャリアでも取 出せることによるものであり、B素子の長波長側での増大は、CdTe

-118-



図 1.77 収集効率の波長依存性

層の厚みの増加によるものと考えられる。

津 癉 Cal Î)の太陽光スペクトッを用いて、これ 図 1.77の収集効率のデ R ጎ ა た結果は次の ᡨ᠇ 1 でん 1 1 G+ r e V P·Meen^{II)} 0 らの素子 ล が住 ۶-6 бV じる光電流の AM2 (74 mW/

A 素子 IL(AM2) = 13.1 mA/cft

B 素子 IL(AM2) = 12.3 m A/cd

Ŕ 124 θ Ч **....** 1 ۶ ر \sim 闵记 Ś Od Sก \$ $\overline{}$ $\widehat{}$ ° 0 て理想的なモ Cd Te の基礎吸 ディ ren 光 20 1 光 電流の計算 860 nm 3 ዮኛተ Θ 山 闵 S 瀼 欧 \sim 犐

 $I_L(ideal) = 19.6 mA/cm^2$

PS4 94 в 浽 75 業 灾 洝 Ð 4 \vdash 4 ล d' ۶-1 F Ś 4 5 交 1 d' 1 踧 ٣ Ľ ゆば 围 66, (Y Ľ, 3 ØØ Ś θ \mathfrak{r} % 0 鲥 θ 子の拡 素子の全収集 62.8 % 要减 $\widehat{}$ ette を追 ° S 囪 * 1 揪 14 资 P% 闵 体 <u>===</u> 巚 赵 SV 囪 ۶-4 4 \$ 揪 er v est. P\$t \cap 犚 Cd Te 泊 14 枽 R ÷ 倖

-119-

へ.効 率

太陽電池の効率は表面 CdS層の不純物濃度や透過率、ベースCd Te層の不純物濃度、少数キャリアの拡散長、膜厚、接合を流れる 電流の輸送機構などが絡みあってきまる。

そこで現在得られているB素子の特性を用いて、どの程度の特性 向上が可能かの考察を行った。

B 素子の特性

 $V_{oc} = 0.75 V$, $I_{sc} = 14.0 \ mA/cm^2$, F. F. = 58.0 %, $\eta = 8.7 \%$ $I_{o} = 1 \times 10^{-9} A/cm^2$, n = 1.7, $R_s = 10 \Omega \cdot cm^2$

i. 直列抵抗の減少

この特性で素子の直列抵抗が現在の構造で In2O3 電極を含む 表面層の抵抗分 3 Ω・cm まで減少させることができたと仮定する。 (6) 式で Rsh = ∞ として、この式より計算すると 7 = 10.6%、 F.F. = 70% と向上させることが出来る。

ii 光電流の増大

前述のごとく、この素子の全収集効率は約63%と評価できるが、これを約73%まで増大させることができ IL = 16.0 mA/cm になったと仮定すると、 $\eta = 12.1\%$ 、F.F. $\simeq 70\%$ と改善することが出来る。

以上の様に現在の素子の特性を多少改善することにより、変換効率10%以上の素子の実現の可能性もある。

iii. CdS-CdTe ヘテロ接合太陽電池の理論効率

地上で達成しうる理論効率を知るため、 P. Moon の AM1¹²⁾ (103.4 mW/cn¹)太陽光スペクトルと次に示す定数を用い計算を行った。

Cd S	Cd Te
Eg $2.42 eV$ ND $10^{18} cm^{-3}$	Eg 1.44 eV NA 2×10 ¹⁶ cm ⁻³
mn/mo 0.11	mp/mo 0.30
	Es 11.0
	$\tau_o = 10^{-8} \sec$

CdSとCdTeのバンドギャップ間で吸収される光量子がすべ て光電流(IL)の発生に寄与した(収集効率1)とすると、IL= 22.6 mA/ えとなる。またヘテロ接合の電流は空乏層内での発生 一再結合電流により支配されているとすると飽和電流(I₀)は(9)式 で表わされる。これを求めるため、上述の数値を用い n_i 、Wを 計算すると、それぞれ 1.6×10⁶ cm⁻³、W=0.26 μ mとなり、これよ り I₀ = 3.2×10⁻¹⁰ A/cm が求まる。開放端電圧(Voc)は Voe = $\frac{2kT}{e}$ $e_0(IL/I_0+1)$ にしたがうとして、Voc = 0.93V となる。

(6)式でRsh = ∞、Rs = 0 と仮定した I - V曲線より最大出力点
を求め、変換効率を計算した。以上の結果をまとめると、表 1.
16 になる。

Voc (V)	Isc (mA/cm ²)	$\nabla p(V)$	Ip(mA∕cm ²)	F. F.	η (%)
0.93	22.6	0.79	21.0	0.79	16.1

表 1.16 Cd S-Cd Te ヘテロ接合太陽電池の理論効率

87 mW/cf の太陽エネルギーで計算した A.L. Fahrenbruch⁴⁾の 変換効率と合わせ Cd S-Cd Te ヘテロ接合太陽電池の地上での最 大変換効率は16~17%と考えられ、我々の素子の変換効率の向 上の可能性が大きいことを示している。

(4) 大面積素子の試作

素子面積1 cniの太陽電池で変換効率 η = 7~8% のものを再現性よく 作成できることがわかった。安価な太陽電池を開発するためには、大

S \$ 偨 弃 -N 荧 鄂 꽤 巖 R 行 J. 5 0

菮 鄂 踂 躨 ₩ 弃

 \odot 硘 謟 驯 躨

魁 ∄ **J**ana di A 00 റ് 9 回 旨 臝 Ж N للمسمل \square لمسمو 0 母間 悽 ال

 (\mathbf{v}) 围 文 躙 阕

圜 える 風雨驟 騶 ** 弃 -2 廔 Ť

ω 嶣 慾 光 涵 迓 躙 ٷ

犐 쪯 t, \subset -5 ら P\$ \mathbf{v} сл 0 浽 仚 Θ 4 2 3 荣 ა 80 1 邻 Θ た mW∕cnł 葁 Į, 踂 V . 瑷 $\boldsymbol{\lambda}$ F 医治 $\overleftarrow{}$ 5 条 * \$ 4 弃 F 劉 1 \mathcal{J}^{ν} ť, 7 光 R ť, Θ ñ 盐 運 躙 甶 27 ll⊬ 濲 舕 \subset Å θ . 2 ა 米 1 ¥ 弃 噩 た 8 皮 AH 0 7 ý 斑 . \mathbb{X} N 茂 К 〕 ÷ ¢, D 4 7 1 庖 6 꽤 X ₩ Ω ล 光 蒅 讀 4 ω θ 窳 Θ 賀寮 \mathcal{S} 連続照 阕 罴 έ 犵 4 U s R K S. Θ PH 弁 党 0 歐 Ť -7 റ് 7 の働 豌 not \sim 2 , ลิ 廔 Ť 奏 赤 9-1

邳

 $\underline{m}_{\underline{n}}^{\underline{n}}$

ลิ

9-1

e v

変

嵏

衒

俐

θ

変

2

R

읫

 \subset

た

0

èл

郃

罤

 γ



X -# Θ 噺 JU L F h Ř 9 躙 瀤 涨 弃 Θ 墨 dp P\$ 실 Jal 0

 \sim σι 0 Ш.

変 嵚 效 揪 Θ 変 à F . 廔 नि 凶 趐 ล × nt õ 47

Å ล 変 7 -3 () \sim 4 Ċ \hat{A} ev 0

4 殻 嵐 资 A 王 稧 E õ e v

n · Cd S 1 , d Od Te θ \mathbf{F} ñ Cu_{2-x} Tej R^t 芴 皮 -Ś 围 ลิ 蔋 D⊳ Θ 躨 処理 1984

-123

500℃~600℃で約20~60分行い、その後 Cu2-x Te 層を形成した素子 は、接合の熱処理をしていないものとほとんど出力特性に変化なく、 接合自体は安定であることに示しているので、この素子の劣化は主に P^t Cu2-x Te 層を含む、 p·Cd Te 側の電極部に起っているものと考えら れ、現在解析を行っている。

1.4.3 まとめ

前年度試作した連続析出装置を用いて、2 cm 角 および 5 cm 角のガラス 基板への Cd S 析出膜の析出条件の検討を行い、連続析出法で約 1.5 μm、 バッチ法では4 回析出で約 2 μm の均質な Cd S 析出膜が 2 cm 角ガラス基 板で 172 枚、5 cm 角で 80 枚同時に析出できる条件を確立した。

接合形成法の研究は、本年度は連続析出装置により析出させた CdS 析 出虞と p・Cd Te 蒸着 虞との ヘテロ 接合の検討を行い、変換効率を向上させ るためには、 Cd Te 層 および電極の低抵抗化と、 Cd Te 層と電極とのコン タクトの改善が必要であることから、 Cd Te 層の膜厚の増大、 Cd Te 層へ の アクセプタ不純物の熱拡散などを試みた。その結果、 Cd Te 層の膜厚 を 7 μm まで増大し、 Cd Te 層上に Cu₂ Te 層を蒸着法で被着し、 250℃で 熱処理することによって、 Cd Te 層の抵抗が下がるとともに、 Cd Te 表面層に P⁺ 層ができ、コンタクト抵抗を減少させることができることがわかった。 このようにして 2 cm 角 ガラス基板を用いて試作した受光面積 1 cm の太陽 電池で 70 mW/cm 太陽光下で変換効率 8.7%のものが得られた。 また同様 の効果を得るために、 Cu₂ Te 層を水溶液置換法で形成した素子でも、効 率 8.0%のものが得られた。

さらに5 cm角ガラス基板を用いて、受光面積約13 cm の太陽電池素子を 試作し、50 mW/cm 太陽光相当タングステン光下で効率6%のものを得た。 本方式の太陽電池素子の寿命を確認するために種々の条件で寿命試験を 続行中であるが、変換効率の劣化は500時間までの初期に大きく、以後 は比較的小さいこと。また劣化は主に Cu_{2-x} Te 層を含む Cd Te 側の電極 部で起っていることなどがわかってきた。

-124-

現時点では本方式の太陽電池は CdS、 Cd Te ともに薄膜を用いているに もかかわらず、高い変換効率が得られており、再現性もよいので、寿命 の点さえ問題がなければ、太陽電池の低コスト化の一方式として有望な ものと考えられるが、透明導電性膜、 Cd Te 膜および電極金属 などを真 空蒸着法によって形成しなければならないので、量産性の点で前記のス クリーン印刷・焼結方式と比較すると、少し不利となることから、来年 度はスクリーン印刷・焼結方式一本に絞ることにし、本方式の研究は本 年度末をもって中止することになった。

1.4.4 引用文献

- A. G. Milnes and D. L. Feucht, "Heterojunction and Metal Semiconductor junction (Academic Press, New York, 1972)
- J. L. Shay, S. Wagner, K. J. Backmann and E. Buehler : J. Appl. Phys. 47 (1976) 614.
- 3) A. Yoshikawa and Y. Sakai : Solid-State Electron. 20 (1977) 133.
- 4) A. L. Fahrenbruch et al. : Appl. phys. Lett. <u>25</u> (1974) 605.
- 5) D. Bonnet and H. Rabenhorst : Record 9th IEEE photovoltaic Specialists Conference (1972) 129.
- 6) D. A. Cusano : Solid-State Electron. <u>6</u> (1963) 217.
- E. W. Justi, G. Schneider and J. Seredynski : Energy Conversion <u>13</u> (1973) 53.
- 8) M. B. Prince : J. Appl. phys. 26 (1955) 534.
- 9) 蕨迫他:信学技報 76(1976)11.
- 10) C. T. Sah, P. N. Noyce and W. Shockley : Proc. IRE <u>45</u> (1957) 1228.
- 11) P. Moon : J. Franklin Inst. 230 (1940) 580.
- 12) P. Moon : Dover Publication Inc. (1936)

1.5 気相成長法

1.5.1 まえがき

II – N族半導体を用いた太陽電池として、既に Cu_{2-x}S-CdS接合、 Cu_{2-x}Te-CaTe 接合を用いた素子が研究されてきた。その結果、薄膜 形素子¹⁾、焼結形素子²⁾で変換効率 5~8 %の高性能素子が得られてい るが、実用化に至っていない。その最大の問題点は素子の劣化にある。 一般に Cu⁺、Ag⁺、Na⁺等の [族陽イオンは イオン伝導を起し易い。 従って、その劣化の原因は光電流によって、または光起電圧によって誘 起された Cu⁺イオンのマイグレーションにあると考えられている。³⁾よ って、より安定で高性能な太陽電池の開発を目的として、Cu イオンを含 まず、そして、 p形、n 形部ともに II – N 族半導体 からなるCdS-CdTe 接合に注目した。 D. Bonnet⁴⁾らは気相成長法で作られた CdTe 膜上に CdSを真空蒸着することにより、CdS-CdTe接合を形成し、効率5% の素子を得た。A.L. Fahrenbruch⁹らは CdS 単結晶上に気相成長法 (close spaced method)で CdTe を成長させ、単結晶形で約4%の効率 の素子を得た。

我われは将来の薄膜形 CdS-CdTe 太陽電池のための 技術的な基礎を 確立する目的で気相成長法による研究を行って来た。 CdTe 結晶上に低 抵抗 CdS 膜を成長させることにより、太陽光下(AM 1.2、68 mw/cm)で変 換効率 10.5%の太陽電池が得られることを前年度に報告した。本年度は この素子の半導体的、結晶学的な解析と寿命特性について測定・検討を 行った。

X線ラウエ回折の結果、CdSの(0001)面がCdTeの(111)面上に エピタキシャルに成長していることが確認された。 $^{6)}$ 光起電力(短絡電 流)のスペクトルレスポンスは波長 0.51~0.86 μ mの間でみられ、特に 波長 0.58~0.81 μ mの間で収集効率は一定であった。またレーザー光 (0.63 μ m)を用いて絶対収集効率を測定し、86%の値を得た。この結果 から光励起キャリアーのCdS-CdTe界面での損失が少ないことが分る。 現状の効率と理論効率を比較・検討し、更に高性能化のためのボイント を明らかにした。寿命テストにおいて、表面に保護膜をコートしない素 子でも室温放置テスト、室温 80% 湿度中放置テスト のいずれにおいて も劣化が見られなかった。従って、 CdS-CdTe 接合素子は少なくとも、 Cu_{2-x}S-CdS、または Cu_{2-x}Te-CdTe 接合素子より安定であると考え られる。気相成長法による膜形素子は低抵抗 p 形 CdTe 膜を得ることが 難しく、十分な結果が得られるまでに至らなかった。今後、適当な基板 材料の選択および p 形ドービング材、ドービング方法の開発が必要であ る。以上の実験事実から、未だいくつかの解決しなければならない問題 を残してはいるが、 CdS-CdTe 接合は 高性能かつ安定な II – II 族太陽 電池として有望であると考えられる。

1.5.2 接合形成



図 1.80 素子の断面図

素子の断面を図 1.80に示す。基板はリンをドープした p 形 C d T e 結 晶である。基板の正孔濃度、ホール移動度、抵抗率は夫々 4 × t d¹⁶ cm⁻³、 33 cm / V・S、4.8 Ω cm である。基板の片面をラッピング、エッチングし た後 C d S 層を図 1.8 1 に示すような装置を用いて、基板上に析出させ た。これは H2-C d S 系気相成長技術の一種である。



図 1.81 CdS気相成長装置

よく知られた近接法(close spaced method)と図1.81 に示す方法と の違いはソースと基板の間の距離にある。近接法では、その距離は数mm 以下であるが、図1.81ではその距離は約20 cmである。図1.81の方 法ではソースと基板の広い空間にドーピング用不純物ソースを挿入する ことが可能であり、また近接法に比較して基板の温度を低くすることが できる。図1.81(a)はCdS析出前に行うCdTe 面のサーマルエッチングプ ロセスの場合の炉心管の位置を示す。

CdS膜をCdTe基板上にエピタキシャルに成長させるために、このサーマルエッチングプロセスが必要である。このプロセスは 600℃で 3分間

に付け、エポキシ樹脂にモールドして素子を完成した。

1.5.3 CdS膜の低抵抗化処理

この素子では表面 CdS 膜をワイドギャップ窓材として使用している。 従って、素子の高性能化のためには CdS 膜は低抵抗でかつ 高透過率 を有 するものでなければならない。ここでは特に低抵抗化処理に関する実験の 結果を報告する。 CdS 中にドナー不純物である In をドープすると伝導度 が増大することおよび CdS を H₂ガス中で熱処理すると 伝導度が増大する ことは既に知られている。 In 蒸気を含む H₂雰囲気中で熱処理 することによ って CdS 膜の比抵抗を更に低下 (~10⁻² Ω·cm)することが 可能になったので この結果を報告する。

まず、CdS 蒸発源温度、基板温度を夫々 890℃ および 450℃の条件で ガラス板上にアンドープ CdS 膜を厚さ約 20 μ m に析出させた。この膜の比 抵抗は 1.5×10³Ω·cm であった。この膜を 430℃、20分間熱処理 をした時 の抵抗の変化を、In ソース温度の関数としてプロットした結果を図 1.84 に示す。 300℃以下のソース温度(In の蒸気圧が非常に低い)では、膜の 抵抗は In ソースの温度によらず、 3~4 Ω·cm である。この値は初期抵抗 の約 400 分の 1 である。 300℃より高温 側では比抵抗はソース温度の 上昇 とともに急酸に抵下する。 600℃処理で CdS 膜の比抵抗、キャリアー濃度、 ホール移動度は夫々、 0.01 Ω·cm、6.7×10¹⁸ cm⁻³、93 cm/V・s となった。 こ れらの実験結果から H₂雰囲気中での処理によって、膜の比抵抗が1.5×10³ Ω·cm から 3~4 Ω·cm に低下し、更に In 蒸気を含む H₂雰囲気中での 処理 により、 10⁻³ Ω·cm のオーダーまで低下するものと考えられる。よって、 In 蒸気を含む水素雰囲気中での処理は CdS の抵抗を下げるために非常に 有効である。



図 1.8 4 In 蒸気を含む水素雰囲気中での処理によるCdS 膜の比抵抗の低下

1.5.4 キャリアーの拡散長の測定

光電変換の機構において、少数キャリアーの拡散長は基本的な物理量 である。 XMA を用いて接合近傍における 電子線励起起電流(EBIC)の分布 を測定することによって CdTe 中の少数キャリアーの拡散を求めた。この 方法は拡散長を測定するための最も直接的な方法である。表面 n 層中での 正孔の拡散長を正確に測定するために、この実験では接合の位置が1.5.2 で述べた素子より深い(~3µm)素子を用いた。図1.85はEBICの対数



図1.85 電子線励起起電流の分布と少数キャリアーの拡散長の測定

を接合からの距離の関数としてブロットしたものである。接合の両側の直線部分の傾斜から少数キャリアーの拡散長(Ln、Lp)を求め、 夫々 0.7、1.0 μmの値を得た。 Lp の値が Ln 値より大きいが、これは 拡散 n 層 中に存在 する内部電場のためと考えられる。これらの値は、 GaAsの拡散長に比べ て ½である。高性能化のためには基板 C dTe の高純度化および、正確に制

-133-

御された拡散のプロセスが必要である。

1.5.5 C - V 特 性

素子の接合容量(C)の電圧(V)依存性を図 1.8 6 に示す。 C^{-3} と V の 間にリニアーな関係があり接合は直線傾斜形 接 合 て あることが分る。 $C^{-3} - V$ 特性の傾きから接合近傍での不純物の濃度勾配(G)を計算するこ とができる。その結果 G = 5.8 × 10²⁰ cm⁻⁴が得られ、また V = 0 での容量か ら空乏層の幅(W)を求め 0.7 μ mの値を得た。前に示したように CdS中のキ ャリアーの濃度は 10¹⁸ cm⁻³以上であるから空乏層は主に CdTe 中に広がって いると考えられる。空乏層のエッジでの不純物濃度(N)は N = G · $\frac{W}{2}$ の関 係から 1.9 × 10¹⁶ cm⁻³ となり、この値は基板のホール係数の測定から得られ た値 4 × 10¹⁶ cm⁻³ より小さい。これは CdS 析出中に CdTe の不純物濃度 が 若干減少することによると考えられる。また図 1.8 6 の直線部分の延長と



図1.86 接合容量とバイアス電圧の関係

-134 -

V軸との交点は 1.9 V である。 この値は C d T e のバンドギャップから推定される拡散電位より大きい。従って接合は単純な p - n 接合ではなく、その間に i 層が存在する p-i-n 直線傾斜形 p-i-n 構造であると考えられる。この構造の接合の C - V 特性は、理論的に次のように表わされる。)

$$\frac{1}{C^{s}} = \frac{1}{\varepsilon^{2} Q G A^{s}} \left[V_{D} + \frac{Q G}{1 2 \varepsilon} W_{i}^{s} - V \right]$$
(1)

そこで ε は CdTeの誘電率で 11 $\varepsilon_{0, \Lambda}$ Aは接合面積で 0.57cm、VDは拡散電位、 Wiは i 層の厚さである。 C⁻³ - V 特性の電圧軸との交点の電圧 (Vint)は (1)式で C⁻³ = 0 とおいて、その時の Vの値から得られる。

$$V i n t = V_D + \frac{GQ}{12\varepsilon} W_i^3$$
⁽²⁾

図 1.8 6 から V_{int} = 1.9 V であり、また強い光を照射した時の飽和開放電圧 から V_D = 0.8 2V を得た。これらの値を(2)式に代入して W_i = 0.51 μ m となった。この値は A・Fahrenbruch G^{5} の素子における i 層の厚さ 2 μ m よりか なり薄い。我々の製作した素子の直列抵抗 (RS)が比較的小さい(~2.5 Ω)のはこの薄い i 層によるものと考えられる。

1.5.6 光起電力特性

図 1.87は、逆バイアス電圧をパラメータとした収集効率の波長依存 性を示す。レスポンスの長波長端(~0.86 µm) および短波長端(~0.51 µm) は夫々、CdTe、CdSの吸収端の波長とよく一致している。特に波長0.58 ~0.81 µm の領域では収集効率は大体一定である。また He-Ne レーザー光 を照射して波長 0.63 µm での絶対収集効率を測定すると 0.86% であった。 この値は表面での反射損失を補正すると 0.95% になる。逆方向バイアス電 圧を印加すると収集効率は少し増加しているが、レスポンスの長波長およ び短波長端の波長はバイアスによらず一定である。 p-n 接合の昇面にかな り厚い i 層またはバンドにスパイクがある時には、レスポンスの長波長端 にバイアス依存性が見られることが報告されている。⁸⁾ これは接合の深部



図 1.87 バイアス電圧をパラメータとした収集効率のスペクトルレスポンス

で光励起されたキャリアーも印加電圧による電場が強くなると光電流に寄 与できるようになるためである。これらの実験からこの素子では、 i 層が 薄くまたバンドにスパイクがないと考えられる。

これらの実験結果に基く接合のバンド構造を図 1.8 8 に示す。n・CdS、 p・CdTe のフェルミエネルギー 0.0 3e V、0.16e V の値は CdS および p・ CdTe のキャリアー濃度の測定値から計算した。伝導帯、価電子帯の不連 続エネルギー $\triangle Ec$ 、 $\triangle Ev$ は前に求めた VDおよび CdS、CdTeのバンドギャ ップの値から計算し、、夫々 0.43eV、1.41eV となった。 また、 $\triangle Ec$ 、 $\triangle Ev は CdS$ 、CdTeの電子親和力なよびバンドギャップから計算され夫々



CdS

CdTe

図 1.88 CdS-CdTe 接合のバンド構造

0.22 eV、1.2 1 eV となる。すると V_D = 1.18 eV の値が得られる。実験的に 得られた V_D の値(0.82 eV)は計算値 1.18 eV より 0.36 eV 低い。これは接合 部での不純物、欠陥界面準位によると考えられるが、この低い拡散電位 (V_D)が、素子の起電力(0.68 eV)が理論値⁵⁾(0.96V)より低い原因であ ると考えられる。

表 1. 1 7 は太陽 光照射 (AM 1.2、68 mW/cn²) および ソーラーシュミレ - ター光照射 (AMO、140 mW/cn²)での開放電圧 Voc、短絡電流 (Isc)、 効率 (η)、曲線率 (C、F)を示している。素子の面積は約 10%の面積を占 める電極を含めて 5.7 cn²である。太陽光とソーラーシュミレーター光 によ

-137-

る効率の差は照射光の強さ、スペクトルの差によるものと考えられる。

照射光	V o c (V)	Isc (mA∕cm²)	n (%)	C.F (%)
太陽光(AM、1.2)	0.67	2 0. 1	1 0.5	59.2
疑 似 太陽光 (AM,O)	0.69	2 3.7	6. 0	57 .5

表1.17 太陽電池の諸定数

1.5.7 寿 命 特 性

素子の実用化のためには、その安定性が、特性と共に重要な因子であ る。 II – NI族太陽電池のうちで、 Cu_{2-x}S-CdS、Cu_{2-x}Te-CdTe接合素 子が詳しく調べられ薄膜形で 6~8 %の高効率の素子が製作された。しか しながら、これらの素子は湿度中テスト、光照射テスト、順方向バイアス テストにおいて、かなりその特性が劣化した。特に順方向バイアステスト では、わずか数分間に I – V 特性が整流性からオーミック特性に変化した。 これらの劣化の原因は発生起電力によって誘起された Cu イオンのマイグレ ーションによるものと考えられている。ここで製作した CdS-CdTe 素子は イオン伝導を起し易い Cu の 化合物を使っていないこと、 および接合が高 温でドライなプロセスで製作されること等の理由で高い安定性を示すと考 えられる。

図 1.89は、室温放置および 80% 湿度中放置におけるモールドなしの素子の寿命特性を示す。そこで Pmo は出力電力の初期値であり、Pm は寿命テスト後の出力電力である。

図 1.90 は約 40mA/cm の 順方向電流を流した時の順方向 バイアス寿命 特性である。モールドなしでも素子自身、外気・湿気に対して耐え得る性 質を持ち、また、順方向バイアステストでも安定な特性が見られる。よって、

-138-

CdS-CdTe 接合素子は少くともCu_{2-x}S-CdS、Cu_{2-x}Te 素子 より安定 であると考えられる。



図 1.89 寿命特性(室温放置、80%湿度中放置)



図 1.90 寿命特性(順方向バイアステスト 順方向電流 40mA/cm²)

1.5.8 考 察

XMAによる接合位置の決定および、 C-V 特性から空乏層の厚みの 測定を通して、素子の接合は図 1.9 1 に示すような構造になっていると考え



図 1.91 接合構造の模式図

られる。この構造では、光起電力は CdTe 中の深さ約 0.5 μ m の位置に存在 する接合によって発生する 実験的に得られた少数キャリアーの拡散長、 CdTe の吸収係数 K=4×10⁴ cm⁻¹ 10) (λ = 0.8 μ m)を使って、CdS-CdTe 界 面での再結合定数 (α = ^{TS}/Lp)をパラメーターとして収集効率を計算した。 空乏層中には大きな電場が存在するため、ここで励起されたキャリアーの 収集効率は 100% であると仮定した。

図 1.91の領域 |、 I、IIで励起されたキャリアーによる 接合電流は、 T・S・Moss¹⁾の計算に従って次のように表わされる。

$$J_{sc}^{I} = q N \left[\frac{\alpha + K L_{p}}{\cosh L_{p} + \alpha \sin h t} - K L_{p} e^{-kt} - e^{-kt} \tanh(\alpha' + \frac{t}{L_{p}}) \right] \times \frac{K L_{p}}{K^{2} L_{p}^{2} - 1}$$

- $\mathbf{J}_{sc}^{\mathbf{fl}} = \mathbf{q} \mathbf{N} \left\{ \mathbf{e}^{-\mathbf{k}t} \cdot \mathbf{e}^{-\mathbf{k}t'} \right\}$
- ${}^{J}\,{}_{sc}{}^{I\!I} = \; {}_{q}\,{}^{N}\,{}_{e}^{-kt'} \;\cdot \frac{{}^{K\!L}_{n}}{{}^{K\!L}_{n}{}^{+1}}$
- そこで $\alpha = \frac{\tau S}{L_p} = \tan h \alpha'$ 、 S: CdS-CdTe 界面での再結合速度 $\tau : n \cdot CdTe 中 \tau の \pi - \nu の ライフタイム L_p: \pi - \nu の拡散長$ L_n:電子の拡散長 K:吸収係数(=4×10⁴ cm⁻¹)

N:入射光子束(1/cm^{*}・sec)

従って収集効率(Q)は次のように表わされる。

$$Q = \frac{J_{sc}^{I} + J_{sc}^{II} + J_{sc}^{II}}{q N} = Q^{I} + Q^{II} + Q^{II}$$

上式に各値を代入し、収集効率を界面再結合定数の関数として求めたもの を図 1.92に示す。絶対収集効率約95%が得られたという事実は、界面 再結合損失が非常に少ないことを意味する。つまり図 1.92で95%の値 は $\alpha = \simeq 0.2$ に相当する。 S = $\frac{\alpha L p}{\tau}$ の関係から $L_p = 10^4 cm$ 、 $\tau = 10^8$ 秒

-141-

として界面再結合速度を求めると 2×10 ℃m⁻¹となる。以上のように実験的 に高い収集効率が得られているので今後、性能改善のためには Vocの増大 が必要である。 Vocの実験値 0.69V は理論的に計算された値 0.96V よりか



図 1.92 収集効率と表面再結合の関係

なり小さい。 Voc と逆方向飽和電流(Io)の間には次のような関係がある。

$$V \circ c = \frac{n k T}{q} \ell n \left(\frac{I_{\delta c}}{I_{0}} + 1 \right)$$

I - V特性の測定から $I_0 = 5 \times 10^{-9} \text{ A/cm}$ 、n = 1.9であった。 I_0 、nの値を上式に代入して、Voc = 0.75Vが得られるが、この値も理論値よりかなり

低い。よって Voc は大きな Io値によって制限されていると考えられる。 だから Ioの発生機構を検討し、その値を減少させるための新しいプロセス の開発が必要である。今までに得られた経験から Ioの減少は Cd Te 結晶の 電気的性質 および Cd S膜の成長法の改善によって達成されると考えられる。

1.5.9 まとめ

 H_2-CdS 気相成長法によって、 $p-CdTe \ p = \Lambda - LcCdS \ e = L^2 + \mu cdS$ 気相成長法によって、CdS-CdTe太陽電池を製作した。 CdS の (0001) 面がCdTeの(111) 面上にエビタキシャルに成長してい ることがX線ラウエ回折によって確認された。接合は $n \cdot CdS-(n \pm cdt)$ i) · CdTe-p·CdTeの構造からなり、高性能素子ではその接合の深さ(n または i · CdTe層の厚さ) は 0.5 μ m であった。C-V 特性の 測定から p-i-n 直線傾斜形接合であり、 i 層の厚さは 0.5 μ m であることが分った。 XMA で EBIC の分布を測定し、少数キャリアーの拡散長 $L_n=0.7\mu m$ 、 $L_p=$ 1.0 μ mの値を得た。

光レスポンスは波長 0.51~0.86µmの領域でみられ波長 0.58~0.81µm の間では収集効率は一様であった。 He-Neレーザーを用いて、 絶対収集効 率を測定し、 86%の値を得た。これらの高い収集効率の値はCdS-CdTe 界面でのキャリアーの界面再結合損失が少ないことを示唆している。

太陽光照射(AM1.2)及びソーラーシュミレーター光照射(AMO)によ る効率 測定の結果、 夫々 10.5% および 6.0%の値を得た。これらの値は I ー N 族太陽電池の中では最も高い水準にある。この素子に於てワイドギャッ ブ窓材としての低抵抗 CdS 膜が、 Rsの低下および界面再結合損失の減少 に十分寄与しているものと考えられる。低抵抗 CdS 膜は In 蒸気を含むH2 中でアニールすることによって、光透過率の減少を押え、比抵抗を7.2×10⁻³ Ω・cm まで下げることができた。 Voc の実験値 0.69V は理論値 0.96Vよりか なり低く、逆方向飽和電流によって制限されているためである。Voc の向 上のためには Ioの発生機構を検討し、その値を減少させるための新しいプ ロセスの開発が必要である。

寿命特性の測定の結果、樹脂モールドを施していない素子でも、室温 放置、湿気中放置において安定である。また、順方向バイアステストでも 劣化が見られなかった。従ってCdTe-CdS接合はCu_{2-x}S-CdS、 Cu_{2-x}Te-CdTe 接合にかわって安定な』-W族太陽電池となり得ると考 えられる。

1.5.10 引用文献

- 1) F.A. Shirland: Advanced Energy Conversion 6 (1966) 201.
- 2) D.A. Cusano: Solid-State Electronics 6 (1963)
- J. Besson, T. Ngugen Duy, A. Gauthier, W. Palz, C. Martin and
 J. Vedel: Proc. Photovoltaic Conference., 1975 p. 468.
- D. Bonnet and H. Rabenhorst: Proc. 9th IEEE Photovoltaic
 Specialist Conference 1972 p. 129.
- A. L. Fahrenbruch, V. Vasilchenko, F. Buch, K. Mitchell and R. H. Bube: Appl. Phys. Letters <u>25</u>(1974) 605.
- K. Yamaguchi, H. Matsumoto, N. Nakayama and S. Ikegami: Japan
 J. Appl. Phys. <u>15</u>(1976) 1575.
- 7) C. van. Opdorp: Solid State Electronics <u>11(1968)</u> 397.
- S. Wagner, J. L. Shay, P. Migliorato and H. M. Kasper: Appl. Phys. Letters <u>25</u>(1974) 434.
- 9) D. T. Bernatowicz and H.W. Brandhorst: Proc. 8th IEEE Photovoltaic Specialist Conference 1970 p. 24.
- C. Konak, J. Dillinger and V. Prosser: I-M Semiconducting Compounds 1967 International Conf. p. 850.
- 11) T. S. Moss: Solid State Electronics 2(1961) 222.

-144 -

1.6 蒸 着 法

1.6.1 まえがき

気相成長法による安価で高効率なCdTe系薄膜太陽電池(CdTeホモ、 CdTe系へテロ接合)の実現を目標として前年度迄は

i. CdTe バルク結晶を用いた不純物の熱拡散法によるホモ接合形成技術の確立、並びに太陽電池素子の試作

ii. CdTe、およびZnTeバルク基板上へのCdTeエピタキシャル 層形成 によるホモ、およびヘテロ接合素子の試作検討

を行い、最終目標となるべき薄膜相互間の接合を得る為の基礎的検討を実施してきた。

これらの結果、 CdTe 系へテロ接合、或は CdTe ホモ接合の場合、前 者では接合部分での拡散層がキャリアーの拡散長に比して厚く、後者では 試料表面の "荒れ"等の問題から低温成長を行う必要があり、その為キャ リアー濃度が不十分で直列抵抗損失が大きく、効率としては 3 ~ 4 % にと どまり、特に薄膜相互間の接合形成を考慮した場合、これらの熱拡散法を 基調とした上記問題点の制御は極めて困難であることが明らかとなってき た。

従って本年度においては熱拡散法によらないで直接的な接合形成を目標として、現在特に有望な素材の一つと考えられているCdTe-CdS系素 着薄膜による素子検討を行った。

1. 6. 2 CdS-CdTe 系薄膜太陽電池の予備検討

蒸着法によるCdS-CdTe系薄膜-薄膜太陽電池の可能性の予備的検 討を目的として燐ドーブp形CdTe単結晶上へのCdS蒸着薄膜の育成、ヘ テロ接合形成条件と太陽電池としての特性検討、更には各種基板上への CdS、CdTe蒸着薄膜の育成実験を通じて素子構造の検討を行った。これ らの結果、初期的な段階ではあるがCdS蒸着薄膜とp-CdTe結晶の間で のヘテロ接合の形成確認と共に作製条件の違いによる太陽電池としての特

-145-

性変化、並びに最終的な目標である薄膜-薄膜系素子構成への基礎的資料を得た。

(1) p-CdTe 単結晶上へのCdS蒸着

燐ドーブした p-CdTe 基板上への CdS の蒸着は図 1.93に示したよう を装置で、 BN ルツボ中にセットされた CdS 粉末(99.999%)の抵抗加 熱により行い(蒸着真空度 $5 \times 10^{-5} \sim 5 \times 10^{-6}$ Torr)、図 1.94に示した ように CdS 側は In ハンダ、 CdTe 側は AuCl₃を用いた Au メッキ により 電極を取出し、ヘテロ構造の素子試作を行った。



図 1.93 ベルジャー内蒸着装置概略図

表 1.18にp-CdTe基板上へのCdS蒸着条件と太陽電池特性の一例 を示す。同表中、熱処理【、】はいずれもA1試料を用いて熱処理を行った結果である。

表1.18 CdSの蒸着条件、および試作素子の特性

素	子名	基 板 温 度 (℃)	ソース 温 度 (℃)	膜 厚 (um)	蒸着速度 (& min)	Rs (Ωcm²)	Jo (A/cm ²)	A 值	J scc	Voev (V)	(f. f.)	η (%)
<u> </u>			1									
A	1	350	600	1. 5	200	2.5	1.5×10 ⁻⁷	1.69	8.64	0.498	0.535	3.0
A	2	400	620	1.6	300	_	-		6.85	0.460	0,527	1. 7
熱処理 基板温度 600℃にて(N ₂ +H ₂)ガ ス中35分熱処理			4.8	1.2×10 ⁹	1. 7 0	2.38	0.622	0.381	0.72			
L									*			
熱	処理 基板温度を 600℃ に 保ち、500℃ の温度の所に In を置き(Net				54	60×10 ⁻⁸	203	512	በፍፈፍ	0377	1 /	
	I	H ₂)ガス中 40分 熱処理				0.4	0.0 ^ 10	2.00	0.12	0.000	0.077]. 4

但し、Rs:シリーズ抵抗、Jo:ダイオード飽和電流密度、A:ダイオード定数 Jsee:短絡電流密度、Voev:開放端電圧、f.f.:矩形率、η:変換効率 Ro、Jo、Aは後述の電流 - 電圧(I-V)測定から、Jsee以下の値は 78mW/cmlの太陽光入射時の素子特性測定からの結果である。

a.電流-電圧(I-V)特性
 ダイオード素子のI-V特性は

$$I = Io. \left(exp \left\{ \frac{q (V - I \cdot R_s)}{kT} \right\} - 1 \right)$$
 (1-1)

但し、q:電荷素量、k:ボルッマン定数、T:絶対温度、

Io:飽和電流

て与えられ、表1.18のRs、Jo、Aは上式と図1.95に示した試料 A-1、および熱処理」、IのI-V特性の測定結果から導かれた。 表1.18および図1.95の結果から明らかなように試料の熱処理はダ イオード飽和電流、Jo、および開放端電圧、Vocvの改善をもたら しているのに反し、逆方向I-V特性では著るしい劣化が観測された

-147-

(未処理のA-1試料の逆方向特性は極めて良好で微弱電流の為、測定不能)又、ダイオード定数A~2より電流機構はrecombination
 current が主たるものとなっている。





-148-

b. 容量-電圧(C-V)特性

素子A-1のC-V特性の測定結果を図1.96に示す。同図から明 らかなように逆バイアス印加時の容量の測定値を¹/C²-Vでプロット した場合、印加電圧が-1ボルト附近を境にして直線の傾きに 多少の変 化がみられるもののほぼ直線上に測定点がのっていることからCdS-CdTeにおける接合は明らかに階段形接合を形成していることが結論 される。



図1.96 A-1素子のC-V特性

c . 分光感度特性

図 1.97 は地上における太陽光のスペクトル分布と素子A-1の分 光感度の相対的な特性分布を示したもので、太陽光スペクトルとの一 致は十分でなく、特に短波長への感度特性の改善が効率向上への大き

-149-



 -150^{-1}



図 1.98 As grown および熱処理素子の太陽電池特性

(2) 素子構造と基板の検討

蒸着薄膜によるCdS-CdTe太陽電池の構成法としては金属基板等の 上にCdTe蒸着、次いでCdS蒸着を行ったFront Wall Type(図1.99 a)の素子と透明基板上にまずCdS蒸着を行い、その上にCdTe蒸着膜 を形成するBack Wall Type(図1.99 b)が考えられ、夫々のタイプに 関する初期的検討の為、まず各種基板上へのCdS、CdTe 薄膜形成の検 討を行った。

-151-





(a) Front Wall Type

図 1.99 素子構成の概略

a . Front Wall Type

基板として Mo板、Au蒸着した Mo板、石英ガラス、カリガラスを用い、 基板温度150℃~500℃、ソース温度600~800℃、蒸着時間30~60分 の間の各種条件で CdTe 蒸着膜の試作検討を行った。その結果、

(b)

イ. Mo、Au 蒸着 Mo 基板 の 場合

全ての条件下で蒸着薄膜の形成は極めて困難であり、基板温度を 変化させた場合でも数 100Å以上の膜形成は出来なかった。

ロ.石英ガラス、カリガラス基板の場合

基板温度が低い場合(~150℃)、表面光沢のある滑らかな膜形成が みられるが、結晶粒径は1µm以下と小さい。一方、基板温度を高く すると(~450℃)結晶粒径は10~20µm程度迄成長するが、いずれ の場合にも膜の基板への付着力は弱く実用性に乏しい。

b. Back Wall Type

Back Wall Type の素子では太陽光入射は基板側より行われる為、透明基板が必要であり、その為、カリガラス、石英ガラス、ネサガラス (In2O3)を基板としてCdS 蒸着を行った。基板温度を300~550℃、 ソース温度を550~800℃、蒸着時間 60~120分の 各種条件下での検 討結果は、

イ.カリガラス、石英ガラスの場合

蒸着初期の段階では基板上で局所的に付着が進み結晶性は不良で あり蒸着の進行と共に全体に膜形成はみられるに至るが不均一な膜 成長である。

ロ、ネサガラス(In₂O₃)の場合

可視光の透過特性も比較的良好で均一な膜形成が可能である。一般的に基板温度が低い場合は橙黄色で基板温度が高い場合は黄色が強くなる傾向にあるが、これらについては後述するように CdS の stoichiometry に依存しているものと考えられる。

以上の結果から蒸着薄膜による CdS-CdTe ヘテロ接合太陽電池 の 構成に際してはネサガラス基板を用いた Back Wall Typeの素子 が最 も可能性が大きく、且つ素子の電極形成、或は素子の表面コート等の 点からも有利であろうと考えられる。

1. 6. 3 CdS、および CdTe 蒸着膜の特性

前項 1.6.2(2)で予備的検討を行った結果から蒸着薄膜による太陽電池 として Back Wall Type の素子構成を基本的な形態とし、ここでは主として ネサガラス上へのCdS、およびCdS上へのCdTeの蒸着膜形成 とそれらの 膜特性の把握を目的とした実験検討を実施した。

(1) CdS蒸着膜

a.膜表面

ネサガラス基板上へ真空度 10⁻⁶ Torr., ソース温度 600~750 ℃、 蒸着時間 60分の条件下で基板温度をパラメータとした CdS 蒸着膜の 金属顕微鏡写真を図 1.100 に示す。これらの場合、いずれも基板温度 に殆ど依存することなく結晶粒径は 1 µm 程度で、基板温度を更に上昇 させ 500 ℃としても顕著な変化はみられなかった。一方、ネサ膜自体 の電気抵抗は 450 ℃以下では殆ど変化しないが、 500 ℃では数倍上昇 し最終的にはシリーズ抵抗の増加をもたらす為、高温での蒸着は好ま しくないものと考えられる。

小変なゆやるめてわゆい間 長知のへ 放基 ス そ れ じ た む ま 本、合語 い 担 の 題 励 基 い神。いなく見われ位ので 颛邓现,>乡大的簿出幻璘 第四週7」は31期の7全で 且,九己长达健悲の殘邪功 **2011**31果依悉干蔵21載法 見勤习的始全,やかし示き 剂関O 掛 静 员 逝 一 嬳 刹 巩 砌
 の艱計病の動合い2011図 。ちへ用き動宝順る1 ひて、モスー (* F)の 見難

し宝団をも1.0 動るわせい晶 法单刀的创近**均**另後杀狼凤 、 カアノ 熱 3 用 飯 の た (2

(mu) Y, 具 数 0.1 **6'**0 8.0 ζ.0 9.0 1.1 **2**.0 OL 8.5 020 26464 8.0~ 450 8.1 230 5.0~ 002 5.0 520 11 mη δ.δ 2007 26444 吸汉**係数,**α(cm⁻¹) c⁰¹ 톟觀 寠鄙劝法 劝基 £01

-1)、台駅のご。たで行き画柄のアリリ後茶取ゆるしせれき本趣風 光土宜頭おでっこ、為るを耐精习的義一方のもの厚覯の々離大し壊計

104

実際の5 会長協立的学光の観SP3 、645 ちょうめ 2 協力 6 の 関帯性

 $(\mathbf{b} \cdot \boldsymbol{n}) \mathbf{q} \mathbf{x} \mathbf{s} (\mathbf{A} - \mathbf{t}) \mathbf{o} \mathbf{I} = \mathbf{I}$ (1-2) (1-2)

。オ ~ 行 多 情 剣 の 判 条 媒 計 類 箭 蒸 オ そ 习 的 学 光 , ~ 行

3 副 第 の 送 添 功 迎 ア ○ 用 多 左 次 ○ ☆ 宝 郎 ○ 封 帮 監 丞 ○ 勤 2 b 3 蕎 素 封 尋 学 光 ○ 艱 蕾 蒸 . ♂

20112

を示しているにすぎない。

以上の結果は反射係数の仮定、或は多重反射項の無視等の面からみ て或る程度近似的なものにすぎないが、少なくとも比較的高い基板温 度(400℃近傍)で蒸着を行った方が低温の場合よりも良好な光学特 性が得られている。

c.X 線 回 折

CdS蒸着膜のX線回折の結果、蒸着時の基板温度(200~500℃)に よる結晶構造、もしくは配向面の顕著な相異は認められず、いずれも hexagonal構造で配向面における最大強度ピークは(002)面、もしく は(103)面でそれ以外の面信号は微弱であった。これらの配向面の現 われ方は基板温度、ソース温度、蒸着速度、真空度等に依存すること なく、この決定要因について現在明確な解答が得られていない。 d.膜の低抵抗化

太陽電池の構成に際してはシリーズ抵抗の低下が重要を要素の1つ であり、その為 pure CdS、および不純物としてInを用いた、CdSと In との同時蒸着膜について各種の条件下で実験を行ったが、膜の作製 条件に対する抵抗値の依存性は殆ど認められず、ソース材料に依存し て抵抗値がほぼ規制され、且つ同一条件、同一ソースによる膜でも1 桁程度のバラッキがみられた。一般的には pure CdSをソースとした 膜では比抵抗としては 50~500Ω・cm程度であったが、In-doped CdS 膜では 5~50Ω・cmと 1 桁程度の抵抗低下は比較的容易であり、特殊な 場合では 0.01~0.1Ω・cmの極めて低抵抗の蒸着膜もみられ、十分実用に 耐え得るものと思われる。

(2) CdTe蒸着膜

a.膜表面

当初、図 1.93に示したような方式でCdTe蒸着膜の試作を行っていたが、この場合、恐らく蒸着時の初期汚染に起因するものと思われる蒸着膜中での pin holeの発生がしばしばみられ(図 1.103)、太陽電


図 1.106 基板温度と透過率

図 1.107 基板の相違による透過率の差

c.X 線 回 折

CdTe蒸着膜のX線回折測定から cubic構造を確認すると共に回折 信号強度のピーク値はガラス基板上のCdTe膜では(111)面に、 CdS蒸着膜上のCdTeでは(220)面に現れ、基板による配向性の相 違が認められた。

ー方、ネサガラス上への CdS 蒸着膜は前述の如く(002)面が最も 一般的であり、これに CdTe 蒸着膜の(220)面配列バターンを重ねて 描いた結果が図 1.108 である。同図および表 1.19 の格子定数から得 られる CdS-CdTe 間の格子の不整合率は縦方向で 10.7%、横方向で 9.6%となり、現状では CdS-CdTe ヘテロ接合特性に及ぼす影響は余 り明らかでないが、究極的には膜形成時における不整合に起因する諸 問題の把握が必要と思われる。

表1.19 CdS、CdTeの格子定数

	a一軸	.c 一軸
CdS(hexagonal)	4.316Å	6.7 1 3Å
CdTe(cubic)	6.477Å	



図 1.108 CdS蒸着膜上の CdTe 蒸着膜

d. 膜の低抵抗化

p形CdTeで比較的浅いアクセプターレベルを形成する不純物としてはP、Au、Sb、Li等があり、ここではP、Au、P+Au、Sb 等を用いて、

I. CdTe ソース中に不純物を混合し同時蒸着

ii. CdTe ソースと不純物ソースを分離し、不純物蒸気圧の制御下
 における2元蒸着

により、 CdS 膜基板上への CdTe 膜形成を行ったがいずれの場合においても膜比抵抗の顕著な低下は認められず、 g~1 MΩ · cmであった。 一方、ガラス基板上で基板温度 150℃~200℃の比較的低温で且つ P-雰囲気中における CdTe 蒸着では比抵抗 30~250 Ω · cm と低い結 果が得られたが、このような条件下での CdS 膜上への CdTe 蒸着では CdS-CdTe ヘテロ接合特性を示さず、且つ各種後処理においても 良 好な結果を得ることが出来なかった。以上の結果からみて CdTe 蒸着 膜自体の低抵抗化は極めて困難であり、太陽電池の構成に際しては例 えば膜厚制御等による外因的な面からの低抵抗化が必要である。

1. 6. 4 CdS-CdTe 蒸着薄膜太陽電池

以上述べてきた各種の予備実験、或は蒸着条件、膜特性等を考慮して ここではCdS-CdTe蒸着薄膜太陽電池素子の試作とその特性検討、および 素子作製上の各種問題点の抽出を行った。

(1) 素子の作製

前述した夫々の膜特性として比較的良好な条件下、即ち主として基板 温度 400℃ 近傍とし、数 100Å/min の蒸着速度となるようなソース温度 設定下で CdS-CdTe 薄膜太陽電池の試作検討を大別して 次の 2 つの蒸 着形式で、図 1.99(b)のような Back Wall Type の素子試作を行った。

i. CdS 膜とCdTe 膜の分離蒸着

ii . CdS 膜とCdTe 膜の 連続 蒸着

表 1.20 CdS-CdTe薄膜素子の各種特性値

S (cm²)	Jscc (mA/cm²)	V o c v (V)	J o (A∕cm²)	A	Rs $(\Omega \cdot cm^2)$	f.f.	η (%)
0.20	6.75	0.48	7.0×10 ⁻⁹	1. 4 2	4 0	0.52	2.2

(注) 7 6.6 mW/cm の太陽光での測定

S:素子面積、Jscc:短絡電流密度、Vocv:開放端電圧

Jo:飽和電流密度、A:ダイオード定数、Rs:シリーズ抵抗

f.f.: 短形率、 η : 変換効率

1.20の数値に対して10%以内に収まっている。

In-doped CdS薄膜を用いた場合には、 pure CdSの場合の開放端電 圧が 0.3~0.5 V (ロット間のバラッキ) であるのに対して、 0.42~0.5 3 V と多 少の 増加はみられるものの 短絡電流密度、 および変換効率に関しては顕 著な向上はなく、 シリーズ抵抗の低下による効率改善といった立場から みた場合、蒸着 CdTe 膜の抵抗が主な要因の 1 つであることが推測され る。

次に各種試作素子の全般的な分光特性をみると、大別して図1.111の ような傾向を示し[※] いずれの場合も短波長側での感度特性の低下が著し く、同図④に示した太陽光スペクトル分布と比較した場合、エネルギー 強度の大きい短波長領域での太陽光の利用率を著しく低下させ、変換効 率低下の一因となっている。これらの結果は恐らく窓材として用いてい る蒸着 CdS 膜に依存しているものと考えられ、後述の CdS 膜の再検討も 含めて蒸着 CdS 膜自体の可否といった面からの 詳細な検討が必要 と思 われる。

-163 -

※ 大まかな傾向としてはCdTeの蒸着速度が1000Å/min.以上で は図1.112の①、②、1000Å/min.以下では③になる。





図 1.112 分光感度特性の傾向

1. 6.5 CdS 蒸着膜の再検討

前述の如く CdS-CdTe 蒸着 薄膜太陽 電池における変換効率 η は2 %程度で、例えば化学析出法、或はスクリーン印刷法等による CdS 膜を用いた CdS-CdTe 素子 (η =6~8%)に比して極めて低い値であり、この原因の明確化を目的として蒸着 CdS 膜の再検討を行った。

(1) 作製法に基づく膜特性の差異

CdSの化学析出膜、気相成長膜および各種条件下で育成した蒸着膜に ついての特性比較を行った結果を表 1.21 に示す。同表に関する限り、膜 の配向面、比抵抗等に差異がみられるもののこれらの点からの蒸着膜の 基本的な欠陥は余り明確ではない。一方、化学析出 CdS 膜と蒸着 CdS 膜を用いて両者共に全く同様のブロセスでCdTe 蒸着後、CdS-CdTe

				気相成長膜※1	化学析出膜 ※ 2	蒸 着 膜	
基			板	ガラス	ネサガラス	ネサガラス	
基	板	溫	度	470℃	100℃	300~550℃各種	
膜			厚	2 1 µm	2 , µ m	1~4 µm各種	
結		粒	径	1 3∼1 5µm	2 µm	1∼2µm	
比	抵		抗	0.05Ω • cm (In-dope)	$\sim 1 \ 0^4 \ \Omega \cdot cm^{\approx 3}$ (non·dope)	$5 \sim 5 \ 0 \ \Omega \cdot cm$ (In-dope) $5 \ 0 \sim 5 \ 0 \ 0 \ \Omega \cdot cm$ (non-dope)	
透 ())	遐 皮長 0.6	~1(率)µm)		41~51%	58~65% (膜厚1.8µm) 30~55% (膜厚3.6µm)	
X 緩	同折t	op p	eak	(1,0,3,)	(1, 0, 0)	(0, 0, 2)	
パタ	マーン2	nd j	peak	(0,0,2)	(0, 0, 2)	(1, 0, 3)	

表 1.21 Cd S 膜の特性比較一

※1 無線研究所における試作膜

※2 中央研究所における試作膜

※ 3 In 雰囲気中の処理により低抵抗化(~10Ω·cm)可能

薄膜太陽電池を構成した場合、表1.22にみられるように変換効率で6.86 多と0.92%と大きな差異がみられ、CdS蒸着膜自体に変換効率の向上を

	S (cm²)	$\frac{I s c c}{(mA/cm^2)}$	Vocv (V)	(f, f)	η (%)
C d S 蒸着膜	1. 0	2.6 5	0.44	0.39	0.92
CdS化学析出膜	1. 0	1 0.2	0.66	0.51	6.86

表 1.22 蒸着 Cd S 及び化学析出 Cd S 膜による素子特性

注 CdS膜上へのCdTe蒸着、素子試作、特性測定 は中研に於いて実施されたもので、CdS蒸着膜 のみ技研において作製。 妨げる原因が内在しているものと推測される。

(2) EDAX による CdS 蒸着膜の組成検討

EDAX(Energy Dispersive Analysis of X ray)は 被測定 試料に 照射 された X 線によって励起された電子 が示す元素固有の 2 次 X 線のエネル ギー分布測定により含有元素(量)を決定するもので、今問題としてい る "S" および "Cd"の固有 2 次 X 線は表 1.23に示したようなエネルギ ーを持っている。

 測定は "S"に対応する(2300 ±100) eVのエネルギーを持つ2
 次 X線が 100,000 カウントに 達する
 量を基準値として、この量に対応
 した(3140±100) eV、および
 (3300±300) eVの範囲における

"Cd"の2次X線量をカウントしてCdSの組成を求めた(図1.113)。

この際、 CdS自体の エネルギー

表 1.23 "S"及び"Cd"の固有 2次X線

元素	エネルギー(e v)	名称	比率
	2307	Kα _{1.2}	100
S	2322	K.a 1	50
	2465	Kβ	7
	3133	La 1	104
Cd	3316	LBI	42
	3528	Lß2	2 5

分布の標準としては図 1.114 に示した単結晶 CdSを用いて蒸着膜の組織 評価を行った。 "S" に対応するエネルギー範囲で 2次 X線が

図 1.115(a) および(b)は 夫々CdS
単結晶とCdS 粉末 (蒸着用ソース) および CdS 単結晶とCdS 蒸調
着膜の EDAX 測定結果を示すもので
図中点(dot)で示されているカーメンジンは単結晶 CdSに、棒線(bar)
で示されているのは CdS 粉末
(図 1.115a)蒸着CdS膜(図1.115
b)に夫々対応している。
これらの測定結果を一覧表にまと

"S"に対応するエネルギー範囲で2次X線が 100,000 カウントになるように定める。



図 1.113 CdSの2次X線のエネルギー分布、 及び組成評価に用いたエネルギー範囲 めたのが表 1.24 で、同表は CdS 中の"S"からの 2次X線信号のカウン ト数を 100,000 とし、それに対応した CdS 粉末 および CdS蒸着 膜中の "Cd"からの信号カウント数を単結晶中の"Cd"からの信号カウント数 に対する比率で表示したものである。 なお CdS 化学析出膜の場合はCdS 粉末の場合と殆ど同一の結果であった。

以上の結果から明らかなようにCdS単結晶とCdS粉末、化学析出CdS 膜の場合は"S"および"Cd"の含有量はほぼ良好な一致を示しているが、

信号源	S	C	C d	
試 エネルギー	2 3 0 0 ± 1 0 0 (eV)	3140±100 (eV)	3300±300 (eV)	
しゃる東洋省	100,018	7 0,545 (カウント)	1 3 5,9 4 1 (カウント)	
	(カウント)	100%	100%	
	100,000 (カウント)	68,273 (カウント)	131,857 (カウント)	
(UdS化字析出膜)		97%	97%	
CAS茶差暗	100,043 (カウント) -	57,847 (カウント)	110,112 (カウント)	
しょの後言家		82%	81%	

表1.24 CdS単結晶、CdS粉末、CdS蒸着膜のエネルギー別 2次X線量と単結晶に対する比率

CdS単結晶或はCdS粉末(蒸着用ソース)、化学析出CdS膜と蒸着膜を比較 した場合、"CD"含有量に著しい不一致がみられ、蒸着膜においては、"S-rich CdS膜"になっているものと考えられる。

以上の結果からみてCdS-CdTe蒸着薄膜太陽電池の低い変換効率は恐らくCdS蒸着膜にその大きな原因があると思われ、stoichiometric 蒸着CdS膜の実現を目的として各種条件下での膜試作とEDAXによる検討を行った。表1.25にそれらの結果を示したが、同表の結果、低温基板上

1.6.6 まとめ

蒸着法による高効率、低コストCdS-CdTe薄膜太陽電池を目的として 各種の実験検討を行ってきたが、以下ではそれらの検討結果を簡単に示し まとめとする。

(1) 蒸着膜素子の予備検討

a. CdTe単結晶上へのCdS蒸着膜の育成とヘテロ接合形成の可能性 を検討し、階段型接合の形成を確認した。

b、CdTe、CdS共に蒸着薄膜とする為の予備的検討として基板の適性素子構造に関する基礎的実験の結果、基板に対する蒸着膜の付着力、結晶性、電極等の面から"ネサガラスーCdS蒸着膜 - CdTe 蒸着膜" から成る Back Wall Type 構造を採用した。

(2) Back Wall Type 蒸着薄膜素子

a. 各種の条件下で作製した素子の特性はいずれも 550~600 nm以下 の短波長側の入力に対して極端を効率低下が見られ、試作素子の代表 的を特性値として Iscc~6.8mA/cm²、Vocv~0.48V、(f.f.)~0.52、 $\eta \sim 2.2\%$ 程度にとどまった。

b.低効率の原因を明確にする為、化学析出CdS膜を用いた素子との 比較検討の結果、蒸着CdS膜に主たる原因があるものと結論された。

(3) 蒸着 CdS 膜の 再検討

a. EDAX(Energy Dispersive Analysis of X-ray)による各種CdS 膜の組成検討の結果、蒸着CdS膜では組成の著るしいズレが観測された。

b. stoichiome tric な 蒸着 CdS 膜の実現を目指して各種の実験検討 を行ったが現在十分な解決をみるに至っていない。

(4) 結 論

化学析出 CdS 膜、焼結 CdS 膜を用いた CdS-CdTe 太陽電池 の変換効率は 6~8%得られているのに反し蒸着 CdS膜を用いた場合2%程度にとどまり、両者の差異は恐らく stoichiometric を CdS 膜の形成に起因

するものと考えられるに至った。 現状の蒸着技術ではこのstoichiometry の完全な制御、並びに膜の特性上のバラッキ等の面からの安定性にまだ 幾多の問題があり、CdS-CdTe系薄膜太陽電池の作製手法としての蒸着法 は多くの技術的困難を内蔵しているように思われる。 太陽電池素子構成法の研究

2.1 概 要

太陽電池の構造は安価で、かつ、使用時ならびに火災などの不慮の事故 に際して、Cd、Te等の溶出や飛散を防止でき、しかも回収や補修が容易 な構造にする必要がある。さらに、実用的な観点から大面積素子(4cm×4 cm)の試作を行っているが大面積化に伴う素子のシリーズ抵抗の増加によ る性能低下の問題も発生している。これらの諸問題点を想定して素子構成 法の検討を行った。

2.2 まえがき

50年度においては CdS 太陽電池の寿命および使用時の公害 問題 を考慮して、10~20年を周期として回収または補修を想定した 構造を提案し実験を行った。また、樹脂硬化時のストレスや使用時の劣化に伴うパッケージの破損による Cd 溶出の問題も無視し得ないことが分った。

しかしながら、太陽電池素子構成法の最も大きな変化は本研究の主流が CdS-Cu2系のFront-Wall 形から、CdS膜を窓材とした薄膜形CdTe 太 陽電池のBack-Wall 形に変った点である。この場合にはガラス基板が保護 ケースの役割も果しているという長所はあるが、ガラス基板上に形成され たCdSは窓材として使用されるため素子の大面積化に伴うシリーズ抵抗の 増加により性能が低下するという現象が附随してくる。

本年度はとれらの問題点を考慮して太陽電池素子構成法を検討した。

2.3 実験および結果

50年度から持越された問題点に加えて、太陽電池のコスト試算の結果 によれば樹脂は高価であるため、太陽電池の構成材料としてアクリルケー スの使用やモールド用樹脂を多量に使用することは困難であり、基板なら びに容器の主材料としてガラスを使用した方が有利であることが分った。 太陽電池は屋外曝露状態で使用するため、昼夜ならびに四季の変化に伴

う温度サイクルにさらされることになるから、 ガラス基板と太陽電池層お よびモールド樹脂間の熱膨張係数の差によって太陽電池層にストレスが加 わるため、ひびやはがれ現象が発生し易い。これを防止する目的で図2.1 に示すように同一熱膨張係数をもった2枚のガラス板(このうち1枚は太 陽電池層を付けた基板ガラス)の間に太陽電池層をよび厚さ 50~100µm 程度の樹脂層を挾んだサンドイッチ構造の素子を試作した。との構造は樹 脂硬化時のストレスによる太陽電池層やパッケージの破損を防止する目的 も含まれている。

図 2.1(A) に示すように金属層をプリント印刷したガラス板に穴をあけ、 そこからリード線を引き出したのちハンダ封止する。この構造を採用する ことにより、 C d S、 C d T e 膜 か らな る 太 陽 電 池 層 は ガ ラ ス 板 で 務 わ れ る こ とになり、耐湿性、耐候性および機械的強度のすぐれた太陽電池をより安 価に作成することが可能である。

また、実用的な観点から大面積素子(4cm×4cm)の試作を行っているが、 大面積化に伴う素子のシリーズ抵抗の増加による性能低下を防止する目的 で図 2.1 (B) に示すように太陽電池層を 4 ケの細胞素子に分割し、細胞素子 間のCdS層の露出部分に図のような補助電極を付けることにより、素子の シリーズ抵抗を実効的に下げる構造を採用している。



(A) 素子の模式断面図

-174 -

• .



図2.1 改良した太陽電池素子の構造

細胞素子に分割した際、全受光面積に対する有効光発電層の面積比率を 高めるために、図2.2で示すような構造を検討した。図中のガラス基板の 周縁部分に図のような傾斜を付けておき、この上にCdSベーストをスクリー ン印刷して焼き付けることにより、図のようにCdS膜の外縁がガラス基板 の斜面にまわり込んだ状態でCdS焼結膜が形成される。次に、このCdS膜 の外縁部分から図のように電極を引き出すことによって、図2.1(B)の外周 電極による面積損失が防止され、この結果、有効面積率を90%以上まで 高めることが可能である。



図 2.2 有効面積率を高めた構造の素子の断面図

また、公害対策の項で述べるように低融点ガラスは火災時に CdTe の飛散を防止する効果があるので、図 2.1 または図 2.2 の構造の一部を低融点ガラスで置き替えることを検討中である。

3. 劣化機構の解明と対策の検討

3.1 概 要

前年度までは主として焼結形 CdS-Cu2S太陽電池を対象として研究を行ってきた。その結果、従来の製法でつくった CdS-Cu2S 接合を長時間水中 に浸漬し、その後さらに電気化学的処理をするという新しい後処理工程を 採用することによって安定な太陽電池が得られることを明らかにした。

本年度は前記の後処理工程を採用した焼結形 CdS-Cu2S太陽電池の寿命試験を前年度にひきつづいて行なうと共に、新らしくスクリーン印刷方式によってつくった焼結薄膜形 CdTe 太陽電池についてもその安定性を検討した。焼結形 CdS-Cu2S 太陽電池についてはタングステン光照射加速寿命試験 1 ケ月の平均劣化率は 2 % であった。又 50mW/cm2の光照射時の最適負荷を出力端に接続し、太陽電池を屋外に暴露しておいた場合の 1 年の平均劣 化率は 2 % であり、実用化にかなり期待のもてることが明らかとなった。

一方、焼結形 CdTe 太陽 電池についてはまず CdS-Cu₂Te 系の検討を行 なった。この系の太陽 電池の接合部は CdTe 膜内に存在している。したが って Cu₂Te 層の主な役割はアクセブター源であり、二次的に電極としても 役立っていると考えられる。 Cu₂Te 層の変質が直接には接合の劣化に結び つかないため、劣化対策は比較的容易と考えられる。 タングステン光照射 加速寿命試験 2 ケ月後の効率の劣化率は 7 多程度である。この系の太陽電 池の効率は 8 多と高く、劣化も比較的小さいので有望であるが、さらに安 定な太陽電池を得る目的で、 CdTe 中の拡散係数が Cu より小さいと 考え られる Sb およびその化合物を Cu₂Te の代りにスクリーン印刷方式で形成 させた CdS-CdTe-Sb 系についても検討を進めた。この系の太陽電池の効 率は現状では 3 多と低いが上記の加速寿命試験では 2 ケ月で 3 多の劣化率 を示すにすぎず安定であることが分った。これより CdTe 系素子について の劣化対策の樹立も可能と考えられる。

-177-

3.2 まえがき

4 9 年度においては、焼結形 CdS-Cu2S 太陽 電池を対象にして劣化機構 の解明を進め、「焼結形 CdS-Cu2S 太陽電池においては、光照射・出力端 短絡時にもっとも 劣化が顕著であり、この劣化は光電流に伴ない、 p 層 (Cu2S)内をCu1オンが移動し、 p 層の組成が変化することによって起こ ること。および電極構造を工夫することによって p 層内横方向の Cu1オ ンの移動はおさえることができるが、 p 層内たて方向、即ち CdS 焼結体の 粒界にそって形成された p 層を流れる光電流による劣化は防ぐことができ ないということ」を明らかにした。

50年度においては、ひきつづき焼結形 CdS-Cu2S太陽電池の劣化機構 の解明と対策を検討し「高変換効率でしかも安定な CdS-Cu2S 太陽 電池 を得るための一つの重要な要因は p 層内の粒界に形成される硫化銅を内部 まで均一に Cu2S 相にすることであり、従来の製法でつくった 裸の太陽電池 を長時間水中に浸漬し、その後も う一度電気化学的処理するという新らし い後処理工程を採用することによって、上記の条件を満足する太陽電池が 得られること」を見出した。

本年度は50年度に開発された後処理工程を採用した焼結形 CdS-Cu₂S 太陽電池の寿命試験を前年度にひきつづいて行なうと共に、値段の安い太 陽電池として期待されている焼結薄膜形 CdTe 太陽電池についてもその安 定性を検討した。

3.3 焼結形 CdS-Cu₂S 太陽 電池の寿命特性

3.3.1 実験結果

水洗-電気化学的処理を2回繰返した太陽電池をエポキシ樹脂(主剤: 硬化剤=1:0.5の配合比で混合したもの)に埋込み、タングステン光照射 (太陽光50mW/cm 相当)45℃の加速寿命試験および屋外放置寿命試験を 行なった。

加速寿命試験については出力端短絡、開放および最適負荷をかけた状

態で、又屋外放置寿命試験については出力端短絡および最適負荷(50mW/m) の光に対して)をかけた状態で変換効率の変化を測定した。

図 3.1の結果はそれぞれ 3 ケの太陽電池の平均した値である。期間は 1年4ヶ月経過しているが、屋外放置で最適負荷をかけた場合の平均劣化 率は2%/年であり、安定であることが分る。タングステン光照射端子短絡の 場合、最初3ヶ月間の劣化は比較的早く進行するが、長時間たては劣化は 幾分ゆるやかになる。最初3ヶ月の平均劣化率は2%/月であり、屋外放 置で最適負荷をかけた場合と比較して加速倍率10倍程度と言うことができる。



(b) タングステン光照射端子開放

-179-



図 3.1 水洗-電気化学的処理を繰返した太陽電池の寿命特性

3.3.2 まとめ

従来の製法で作った裸の太陽電池を長時間水中に浸漬し、その後もう 一度電気化学処理するという新らしい後処理工程を2回繰返した太陽電池を エポキン樹脂に埋込み長期寿命特性を測定したととろ、屋外最適負荷状態で 平均劣化率2%/年と安定であることが分った。

3.4 焼結薄膜形 CdTe 太陽電池の寿命特性

3.4.1 実 験

1. 2. 3 - (2)で作成した焼結薄膜形 CdTe 太陽電池素子の接合構造を 解析した結果、接合は n・CdTe - p・CdTe のホモ接合であり、Cu2Te 層 の主な役割はアクセプター源であり、 2次的に電極としての役割も果して いると考えられる。この点が従来の CdS-Cu2S 系へテロ接合型 太陽電池と 異なる点であり、 Cu2Te 層の変質が直接には接合の劣化に結びつかないた め、劣化対策は比較的容易と考えられ、短期間寿命テストの結果もこれを 示唆するデータが出始めている。

しかしながら、CdTe中におけるCuの拡散係数は可成り大きいので、 さらに安定な素子を得る目的で拡散係数がCuよりも小さいと考えられる Sbおよびその化合物層をCdTe 膜上に形成させたのちN2中で熱拡散させ た素子の寿命特性についても検討しはじめた。

現在、これらの素子について 50mW/cmt太陽光相当タングステン光照射・ 短絡状態で加速寿命テストを行っている。

以下、寿命テストの結果について述べる。

図 3.2 (A)は In 0.15% 添加 C d T e 焼 結 膜を使用した素子の寿命特性を示す。 図中(a),(b),(c)のグラフはそれぞれ、 Cu C ℓ 熱水溶液(90°±5℃)中への浸漬 時間を 3 sec, 6 sec, 6 + 5 + 5 + 5 sec にした場合の寿命特性を示す。 各 グラフとも素子数 2 ケの平均値を示す。 この図から、 55日後の出力電力 比は(a) 0.69,(b) 0.77,(c) 0.93 となっており Cu₂T e 層の形成条件によって寿命 特性に可成りの差が生ずることが分る。 図 3.2 (B)は non-dope CdTe 焼結膜を使用した素子の寿命特性を示す。 図中(a),(b)はそれぞれ CuCℓ熱水溶液(90°±5℃)中への浸漬時間を5sec, 5+3+3+3sec にした場合の寿命特性を示す。(a)は素子数4ケの平均値、 (b)は素子数2ケの平均値を示す。この図から、23日経過後の出力電力比 は(a) 0.69、(b) 1.02となっている。

図 3.2(A)、(B)の結果から、多重浸漬法によりCu2Te層を厚くすることが寿命特性向上に顕著な効果があることがわかる。



(B) タングステン光照射端子短絡

図 3.2 焼結薄膜形CdTe太陽電池の寿命特性

CdTe膜にSb2Tesを拡散して得た素子についても同上寿命テストを開始しはじめた。この系の素子の変換効率は現在3%程度と低いが1.2.3 で述べたように500℃前後の高温処理を経ているのでより安定な素子が得られるものと期待している。

3.4.2 まとめ

i. 接合構造は n^+ CdS-n・CdTe-p・CdTe(Cu₂Te, Sb₂Te₃)から なっていて、 Cu₂Te, Sb₂Te₃はアクセプター源+電極の役割を果している。 図 3.2(A), (B)で示すようにCu₂Te 層を厚くした素子の寿命特性は 可成り良 好であることから、電極としての Cu₂Te 層の厚さを光電流の通電に耐える 厚さにすれば、少なくとも光発電時の劣化は防止できると考えられる。

■・同上素子の耐熱寿命特性については今後の課題であるが、アクセ ブター源となり得る物質でCdTe中への拡散係数がCuよりも小さいと考 えられる物質、例えばSb2Te3などの使用がその特性の向上に役立つと思わ れる。 4. 公害対策の確立

4.1 概 要

Cd は人体に有害であると言われている。したがってCd を含んでいる I-VI族化合物半導体を太陽電池素材として使用する場合には、製造、 使 用時における公害防止対策を確立しておく必要がある。 49 年度には製造 時における公害防止対策を、又50年度には太陽電池使用中に雨などがか かることによって生じるCd 溶出の防止対策を検討し、それぞれ公害を防ぐ 見透しを得ることができた。

本年度においては火災など不測の事故が発生した場合の使用時の公害 対策について検討を加えた。一般の火災の場合、温度は700℃~900℃にま で上昇すると言われている。そこでCdS-CdTe 焼結膜をアルミナ基板上に つけ空気中で900℃まで加熱した場合の重量変化を熱天びんによって測定 し、この測定値からどれだけのCd等の化合物が蒸発したかを推定した。さ らにCdS-CdTe 焼結膜の表面を低融点ガラスで覆い、加熱時にCd等の特 定化学物質を低融点ガラスにとけこませ、蒸発を防止することを試みた。 その結果、CdS-CdTe 焼結膜を空気中で加熱した場合、SO2やTeO2が生 じ蒸発するが、CdS-CdTe 焼結膜上に低融点ガラスをかぶせることによ って、これらの物質の蒸発をおさえることができることが分った。

4.2 まえがき

49年度においては CdS太陽電池を量産した場合の工程を想定し、各製造工程において各種公害防止基準が達成しうるか否かを検討した結果、現在までに確立されている Cd 公害防止技術を組合わせることにより、各種公害防止基準を充分みたしつつ量産できるとの見透しを得た。

50年度においては、CdS系太陽電池の使用時における公害対策の一環 として、CdS-Cu₂S系接合を樹脂中にモールドした太陽電池完成素子や CdS焼結体からのCd溶出試験を行った。この結果、完成素子のケーシング やリード引き出し部に注意すれば、完成素子からのCdの溶出はほとんど問 題にならないことが明らかとなった。

本年度は、火災、地震など不測の事故が発生した場合の製造時および使 用時の公害対策について検討を加えた。 Cd などの特定化学物質を含む太陽 電池の使用中に地震が発生した場合はパネルが崩壊するのみであるから、 直ちに公害の発生には至らないが、その後の雨水による流出を防ぐため速 かに回収する必要がある。製造工程での地震対策で特に重要なのは、クロ ーズドシステムをとっている工程での洗澱槽などの水槽の破壊による特定 化学物質含有溶液の流出で、これを防ぐには耐震構造の二重防護壁などを 設置すると良いと考えられる。

太陽電池の使用中の事故で重大なのは火災である。火災発生時には、家庭の屋上などに設置した太陽電池が加熱され、特定化学物質が蒸発飛散する可能性がある。これに対する対策として、 Cd などがガラス化しやすい性質を利用して、半導体材料の表面を低融点ガラスで覆い、加熱時に特定化学物質を低融点ガラスにとけこませ、蒸発飛散を防止することが考えられる。ここでは半導体材料として CdS-CdTe 焼結膜を選び、これを加熱した場合の重量変化からどれだけの Cd 等特定化学物質が蒸発したかを推定した。 さらに CdS-CdTe 焼 結膜の表面を低融点ガラスで覆い、特定化学物質の蒸発をかさえることを試みた。

4.3 火災の際の温度

まず一般の火災に於て、温度が何度位まで上昇するのかを「建築防災計画指針」(監修 建設省住宅局建築指導課)にて調べた。 それによると色々な物が燃える時の温度は 700℃~900℃であり、最高 950℃まで上昇する ことがあると記されている。

4. 4 空気中で CdS-CdTe 焼結膜を加熱した場合の重量変化

アルミナ基板上にCdS およびCdTe 焼結膜をそれぞれ約20 µmの厚さにつけ空気中で加熱した場合の重量変化を島津サーマノバランスにより測定した。昇温スピ

- ドは 400℃/hr、最終加熱温度および時間は火災の場合を想定して 900 ℃で 2 時間保持した。

図 4.1(a)はその結果であり、約600℃から重量がふえはじめ、800℃で 30%近く増加する。その後重量は減少しはじめ900℃で2時間保持すると 最初の重量にまで戻り、蒸発が起っていることが分る。

一方、酸化鉛、酸化硼素、酸化硅素および酸化亜鉛からなる低融点ガラ ス(約500℃でとける。低融点ガラスだけを900℃で2時間加熱しても重 量変化はない)をCdS-CdTe 焼結膜上にかぶせた場合は、図4.1(b)に示す ように約800℃から重量が増加しはじめ900℃で30%近く増加するが、そ の後900℃で2時間保持しても殆ど重量変化せず、蒸発は起っていない。





図 4.1 空気中で CdS-CdTe 焼結膜を加熱した場合の重量変化

又並ガラス(ソーダ石灰ガラス、軟化温度 700℃)を低融点ガラスのかわ りに CdS-CdTe 焼結膜上にかぶせた場合は図4.1(c)に示すように、何もか ぶせない場合とあまり変らず 800℃近くまでは重量は増加するがその後減 少しはじめる。したがって並ガラスでは蒸発をおさえる効果がないことが 分る。

4.5 窒素中でCdS-CdTe 焼結膜を加熱した場合の重量変化

火災の場合、常に酸化性の雰囲気中で太陽電池が加熱されるとは限らない。樹脂等が不完全燃焼して還元雰囲気となる場合も多い。ここでは酸素の存在しない雰囲気中でCdS-CdTe 焼結膜が加熱されるとどうなる かを 調べるため、窒素雰囲気中で加熱した場合のCdS-CdTe 焼結膜の重量変 化を測定した。

実験方法は加熱雰囲気が空気から窒素に変っただけで、あとは4.4と全 く同じである。図4.2(a)はその結果であり、窒素雰囲気中では重量増加は なく、約800℃から直線的に減少しはじめる。

一方、低融点ガラスをCdS-CdTe 焼結膜上にかぶせた場合は、図4.2

(b) に示すように、重量減少は900℃迄は起らないが、900℃で2時間加熱 すると約30%減少し、空気中で加熱した場合程の顕著な効果はない。しか し一般の火災では温度は900℃以下である。したがって低融点ガラスをか ぶせることによりCdSやCdTeの蒸発の開始を900℃迄抑えることができ るということは、これらの物質の蒸発を少なくするのに大きな威力を発揮 するものと思われる。



図 4.2 窒素中でCdS-CdTe 焼結膜を加熱した場合の重量変化

遂 差 9 7

と素館力 ●TbD ひ 1 ま 2 b D 、 5 る f 焼成 き 題 誘 誘 ● Tb D - 2 b D 予中 炭空 か の 数 0 か

。5 专创页门新口灯

	$C d T e + \frac{5}{2}O_{2} = C d O + T e O_{2} \uparrow$	%S 9 Þ	域量 重
	$C d T e + \frac{5}{2}O_2 = C d O + T e O_2$	% 0.0 %	重重視
$\left \right\rangle$	$C d S + \frac{2}{3}O_2 = C d O + S O_2^{\uparrow}$	8111	逝 量 重
	$C q Z + 5O^{s} = C q ZO^{4}$	\$ 2.5 \$	重量博

したがって 800℃近辺までは Cd SO, CdO, TeO,等の化合物ができて、 重量は増加するが、 800℃を越えるとこれらの化合物が分解又は蒸発をは じめ重量が減少するものと考えられる。⁽⁾



-681-



。るもえゆまスそれ点螭迅刀土末俄s09T ()

小変量重の合影式」
燒朮で中灵空る末份。OoT ひょ 4 Ob O 6 4 図

-06I-

以上の結果より空気中で CdS-CdTe 焼結膜を加熱した場合、低融点ガ ラスをかぶせると重量減少がないのは(図4.1(b))、 CdS や CdTe がO2 反応して生じた CdSO4 や TeO2 がガラスのネットワーク中に組み込まれて、 分解や蒸発がおさえられたことによると思われる。

窒素中で加熱した場合の重量減少はCdSやCdTeの昇華によるものであ る。これらの化合物は酸化物でないのでガラスのネットワーク中に組み込 まれにくいため²⁾ 低融点ガラスをかぶせても空気中で加熱した場合 程の 顕著を効果はあらわれなかったものと思われる。しかし低融点ガラスをか ぶせるとCdSやCdTeの昇華は900C迄起らないし、又例え昇華しても実 際の火災の場合は空気中に出ていくのであるから、酸素とふれて酸化物と なり低融点ガラスにとけこむことは充分考えられる。したがって、この場 合にも低融点ガラスをかぶせるのは有効だと考えられる。

4.7 まとめ

CdS-CdTe 焼結膜を用いた太陽電池を使用中に火災が発生した場合の 公害対策を検討した。その結果、CdS-CdTe 焼結膜上に低融点ガラスをか ぶせることにより、火災の際の公害発生を少なくできることが明らかとなっ た。初年度以降検討してきた製造時の公害防止対策に加え、使用時および 事故(特に火災)発生時の対策を総合的に考慮しつつ素子構成法の研究を 今後進める必要がある。

4.8 引用文献

1) Chizhikov: "Cadmium" (Pergamon Press, 1966).

2) "ガラス工学ハンドブック"(朝倉書店, 1963)。

-191 -

■ 今後の研究開発計画

本年度までの研究結果にもとづき、今後以下の3つの主題につき研究開発を 進める計画である。

1. Ⅱ - Ⅵ 族化合物半導体製造法および接合形成法の研究

本年度までの研究の結果、スクリーン印刷方式による焼結薄膜形 CdTe 太陽電池について重点的に研究を進めることになった。この太陽電池の主要構造は

ガラス基板/CdS焼結膜(電極兼窓材)/CdTe焼結膜(接合形成部)/電極 となっているが、太陽電池各部の次のような諸点について検討・改善を加え 最適製造条件の確立をはかる。

1 ガラス基板:透光性、CdSとの反応、熱膨脹、強度、面積

 ii. CdS焼結膜:スクリーン印刷用ペーストの調合(原料、粒度、融剤、結
 着剤)、印刷条件、焼成条件(温度、時間、雰囲気)、透 光性、比抵抗、一素子面積。

Ⅲ CdTe 焼結膜:ペーストの調合、印刷条件、焼成条件、比抵抗。

iv. 接合形成:接合形成法、添加物、処理条件。

V. 電 極:材料、塗布法、塗布条件。

2. 劣化対策の確立

今後試作される焼結薄膜形 Cd Te 太陽電池の劣化テストを行い、この種太陽 電池の信頼性についての実態を把握するとともに、 テストの結果に応じて 対策を検討し、製造法の改善を進める。また Cd S-Cu₂ S系太陽電池の劣化テ ストの結果を評価して、 Cd Te 系太陽電池の劣化対策に反映させる。

3. 太陽電池素子構成法の研究

劣化、公害防止の観点から、特にパッケージング法に検討を加え、最適構 成法の確立を図る。 以上に述べた半導体製造法、接合形成法、劣化対策、素子構成法についての研究開発がある程度進んだ段階で、本研究の最終的目標である光 発電システムについての検討を開始する必要がある。

本報告書の内容を公表する際はあらかじめ

工業技術院の許可を受けて下さい